

*User's Guide***AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列原理图、设计指南和审阅检查清单****摘要**

本用户指南包括定制电路板设计人员在使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP、AM62A3、AM62A7、AM62A3-Q1、AM62A7-Q1、AM62A1-Q1、AM62D-Q1、AM62P 以及 AM62P-Q1 处理器系列时应当遵循的定制电路板、原理图设计指南、处理器外设电路、实施建议以及原理图审查检查清单。本用户指南包括与处理器电源、时钟、IO 配置、处理器外设以及将处理器外设连接到连接（外部）器件相关的信息。每节末尾都包含原理图审查检查清单，提供了该节中所述外设的完整审查要点列表。建议定制电路板设计人员使用提供的审查检查清单（要点）审查定制电路板原理图设计实现，并验证检查清单是否遵循了建议或指南。

此外，还提供了以下项的链接（[TI.com](#) 产品页面）：处理器产品页面、处理器相关配套资料、E2E 上发布的与处理器和处理器外设相关的常见问题解答，以及定制电路板设计期间常用的参考文档。建议定制电路板设计人员在定制电路板设计过程中参考这些链接，以更大限度地减少设计错误、优化设计工作、减少电路板制造迭代并优化项目时间安排。

**内容**

<b>1 简介</b> .....	<b>3</b>
1.1 用户指南使用指南.....	3
1.2 处理器的处理器系列列表.....	4
1.3 原理图设计指南和原理图审查检查清单更新.....	5
<b>2 相关配套资料</b> .....	<b>5</b>
2.1 定制电路板原理图设计期间常用参考配套资料的链接.....	5
2.2 处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）.....	5
2.3 处理器系列用户指南（原理图设计指南与原理图审查检查清单）.....	6
<b>3 处理器特定信息</b> .....	<b>6</b>
3.1 选择处理器 OPN（可订购器件型号）.....	7
3.2 处理器特定数据表用例和用户指南编辑所引用的版本.....	7
3.3 外设实例命名约定 — 数据表和 TRM.....	8
3.4 不使用时的处理器外设和 IO 连接.....	8
3.5 按处理器 OPN 的订购和质量信息.....	8
3.6 选择所需处理器 GPN（通用器件型号）和 OPN（订购器件型号）的检查清单.....	8
<b>4 处理器电源架构</b> .....	<b>9</b>
4.1 生成处理器特定和外设（所连接器件）电源导轨.....	9
4.2 处理器电源导轨电源控制、时序和电源过载保护.....	13
<b>5 一般建议</b> .....	<b>14</b>
5.1 处理器性能评估模块（SK - 入门套件）.....	14
5.2 处理器特定 SK 与数据表.....	14
5.3 处理器特定 SDK.....	17
5.4 开始定制电路板设计之前的一般设计建议（需了解）.....	18
<b>6 针对电源、时钟、复位、引导和调试的处理器特定建议</b> .....	<b>21</b>
6.1 通用（处理器启动）连接.....	21
6.2 使用 JTAG 和 EMU 进行定制电路板调试.....	32
<b>7 处理器外设的电源、接口和连接</b> .....	<b>33</b>
7.1 支持的处理器内核和 MCU 内核.....	33
7.2 IO 组的 IO 电源的电源连接.....	33
7.3 存储器接口（DDRSS (DDR4/LPDDR4)、MMCS (eMMC/SD 卡/SDIO)、OSPI/QSPI 和 GPMC）.....	34

## 目录

7.4 外部通信接口 ( 以太网 (CPSW3G0)、USB2.0、PRUSS、UART 和 MCAN ) .....	47
7.5 板载同步通信接口 ( MCSPI、MCASP 和 I2C ) .....	54
7.6 用户接口 ( CSIRX0、DPI、OLDDIO、DSI ) 、GPIO 和硬件诊断.....	58
7.7 SK 特定电路实现 ( 重复使用 ) .....	65
7.8 在定制电路板启动期间执行电路板级测试.....	65
<b>8 定制电路板原理图设计的自我审查.....</b>	<b>68</b>
<b>9 定制电路板布局注释 ( 在原理图部分附近添加 ) 和通用指南.....</b>	<b>68</b>
9.1 布局布线注意事项.....	69
<b>10 定制电路板设计仿真.....</b>	<b>69</b>
10.1 DDR-MARGIN-FW.....	69
<b>11 其他参考内容.....</b>	<b>70</b>
11.1 涵盖 AM64x、AM243x、AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62Lx 处理器系列的常见问题解答.....	70
11.2 常见问题解答 - 处理器产品系列和 Sitara 处理器系列.....	70
11.3 原理图审查 ( 内部自检 ) 与原理图审查需求 ( 供应商 ) .....	71
11.4 处理器连接器件检查清单.....	71
<b>12 用户指南内容和使用情况摘要.....</b>	<b>71</b>
<b>13 参考资料.....</b>	<b>71</b>
13.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP.....	71
13.2 AM62A7、AM62A3、AM62A7-Q1、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1.....	72
13.3 AM62D-Q1.....	72
13.4 AM62P、AM62P-Q1.....	73
13.5 AM62L.....	73
13.6 所有处理器系列通用.....	73
13.7 可用常见问题解答主列表 - 按处理器系列.....	74
13.8 可用常见问题解答主列表 - Sitara 处理器系列.....	74
13.9 常见问题解答 , 包括相关软件.....	74
13.10 有关连接器件的常见问题解答.....	74
<b>14 术语.....</b>	<b>74</b>
<b>15 修订历史记录.....</b>	<b>77</b>

## 商标

WEBENCH® is a registered trademark of Texas Instruments.

USB Type-C® is a registered trademark of USB Implementers Forum.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 1 简介

### 1.1 用户指南使用指南

AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP)、AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列特定、原理图设计指南和原理图审查检查清单包括定制电路板设计人员可在定制电路板原理图设计阶段使用的原理图设计指南。每个部分的末尾都包含原理图审查检查清单，定制电路板设计人员可在设计完成后、布局开始之前使用该检查清单来审查定制电路板原理图。

#### 1.1.1 定制电路板原理图设计指南 — 用户指南中使用的参考文献

用户指南包括原理图设计指南和原理图审查清单，定制板设计人员可以在针对所选处理器和实现的外设（板载或载体（或附加））进行定制板原理图设计时使用，包括内存（DDR、闪存）、电源、通信接口、IO 和其他电路部分。

在用户指南中，对参考处理器表示所选处理器的 OPN，参考所连接器件表示与处理器连接的外部（板载或载体（或附加））外设（基于正在设计的目标终端设备和应用用例）。

#### 1.1.2 处理器系列用户指南

本用户指南涵盖 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP)、AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

本指南包含原理图设计指南与原理图审查检查清单，可供定制电路板设计过程使用。处理器系列用户指南可帮助定制电路板设计人员了解从一个处理器系列迁移到另一个处理器系列或从一个处理器封装迁移到另一个封装时的实现差异。

#### 1.1.3 原理图设计指南

本用户指南提供了原理图设计指南，可在定制电路板原理图设计阶段，使用这些指南来实现所选处理器支持的处理器和外设之间的电路连接。除了设计指南之外，还添加了相关常见问题解答的链接（作为每节指南的一部分）。常见问题解答（添加了链接）提供有关特定外设或接口主题的附加信息，包括有关实现/用例的说明和详细信息，以及从客户互动中学习。

建议定制电路板设计人员遵循原理图设计指南，以更大限度地减少可能影响电路板功能和性能的设计错误，并优化定制电路板设计/构建/测试工作。

#### 1.1.4 原理图审阅检查清单

在用户指南每个部分的末尾以及子部分，添加了原理图审查检查清单，可供定制电路板设计人员用于审查涵盖特定外设的定制电路板原理图。本用户指南中介绍的一般建议、处理器电源和处理器外设部分和子部分在末尾都包含检查清单。原理图审查检查清单分为一般、原理图审查和附加。定制电路板设计人员可以使用原理图审查检查清单对定制电路板原理图设计进行自我审查。自我审查可最大限度地减少可能导致功能或性能相关问题的原理图错误，同时减少正式审查（内部或外部）期间的审查工作。原理图审查可更大限度地减少定制电路板启动或性能测试期间所需的工作量，从而提高电路板设计质量并遵守计划的时间线。

有关可用检查清单和格式的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV\)/AM335x](#)  
设计建议/定制电路板硬件设计 — 原理图审阅检查清单

##### 1.1.4.1 定制电路板原理图设计实现检查清单小节说明

原理图实现审查检查清单包括 3 个小节：

## 常规：

概述一节以要点方式列出（汇总）了电路实现，这些实现需要（应当）支持检查清单一节（设计指南一节）上方所述外设一节的功能。该节还包括在将该节联系或连接到另一节来实现所需的外设或模块功能（无需电路实现）时要考虑的注意事项。建议在继续进行原理图审查之前，先审查并关闭所提供的实现检查清单。

## 原理图审查：

原理图审查一节以要点方式列出（总结）了定制电路板设计人员为了支持功能需要（应当）向电路一节添加的电路实现，包括实现外设或模块时应遵循的值、连接和其他实现。建议将定制电路板原理图设计实现方案与原理图检查清单进行比较，以确保在开始布局之前实现遵循设计指南。

## 其他：

在考虑优化电路设计之前，“其他”一节以要点方式列出（详细介绍）了实现和用例说明，定制电路板设计人员可以使用这些说明以及“原理图审查”一节来了解电路实现理由（需要实现）。

### 备注

有关原理图审查检查清单，请参阅处理器特定用户指南。

## 1.1.5 原理图自我审查期间用户指南使用的常见问题解答参考

以下常见问题解答包括定制电路板设计人员使用可用的处理器特定配套资料进行自我审查的指南：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 定制电路板原理图自我审查](#)

## 1.2 处理器的处理器系列列表

本用户指南适用于以下列出的所有处理器。所选处理器的所有相关文档可在 [TI.com](#) 的产品页面上找到。建议访问下面列出的产品页面链接来查看相关的产品页面。

### 1.2.1 AM62x 处理器系列

请参阅以下产品页面上的订购和质量一节，了解有关 OPN 的信息：

#### AM62x [ALW]

- [AM625](#)
- [AM623](#)

#### AM62x [AMC]

- [AM620-Q1](#)
- [AM625-Q1](#)

#### AM62x [AMK]

- [AM625SIP](#)

### 1.2.2 AM62Ax [AMB、ANF] 处理器系列

请参阅以下产品页面上的订购和质量一节，了解有关 OPN 的信息：

- [AM62A7](#)
- [AM62A7-Q1](#)
- [AM62A3](#)
- [AM62A3-Q1](#)
- [AM62A1-Q1](#)

### 1.2.3 AM62D-Q1 [ANF] 处理器系列

请参阅以下产品页面上的订购和质量一节，了解有关 OPN 的信息：

- [AM62D-Q1](#)

### 1.2.4 AM62Px [AMH] 处理器系列

请参阅以下产品页面上的订购和质量一节，了解有关 OPN 的信息：

- [AM62P](#)
- [AM62P-Q1](#)

### 1.3 原理图设计指南和原理图审查检查清单更新

作为持续改进配套资料的一部分，在原理图设计指南和原理图审查检查清单用户指南中针对当前 TI.com 上发布的修订版本（基于客户反馈，学习内容，添加/增强部分，错误或改进）进行了更改或新增章节，并在下次文档修订期间进行更新。

以下常见问题解答列出了在 TI.com 上（发布修订版用户指南之前），定制电路板设计人员在进行定制电路板原理设计期间需要遵循的更改：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计 — 硬件设计注意事项和原理图设计指南配套资料更新](#)

建议查看常见问题解答，以了解在定制电路板设计的所有阶段可能会频繁进行的更新。

## 2 相关配套资料

### 2.1 定制电路板原理图设计期间常用参考配套资料的链接

TI.com 上的处理器特定产品页面提供了许多与所选处理器（系列）相关的文档。建议定制电路板设计人员在开始定制电路板设计之前，阅读相关配套资料（列于以下常见问题解答）。

#### 2.1.1 AM62x 处理器系列

以下常见问题解答汇总了一些在开始进行定制电路板设计时可以参考的关键配套资料：

[常见问题解答] [AM625 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

[常见问题解答] [AM623 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

[常见问题解答] [AM620-Q1/AM625-Q1 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

[常见问题解答] [AM625SIP 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

#### 2.1.2 AM62Ax 处理器系列

以下常见问题解答汇总了一些在开始进行定制电路板设计时可以参考的关键配套资料：

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A7-Q1 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

[常见问题解答] [AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

#### 2.1.3 AM62D-Q1 处理器系列

以下常见问题解答汇总了在开始进行定制电路板设计时可以参考的一些关键配套资料：

[常见问题解答] [AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

#### 2.1.4 AM62Px 处理器系列

以下常见问题解答汇总了在开始进行定制电路板设计时可以参考的一些关键配套资料：

[常见问题解答] [AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 入门配套资料](#)

### 2.2 处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）

在定制电路板设计阶段，建议阅读、查阅、遵循以下章节中链接的处理器特定定制电路板硬件设计注意事项用户指南中的适用建议：

### 2.2.1 AM62x 处理器系列

[使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 和 AM625SIP 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项](#)

### 2.2.2 AM62Ax 与 AM62D-Q1 处理器系列

[使用 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项](#)

### 2.2.3 AM62Px 处理器系列

[使用 AM62P、AM62P-Q1 处理器系列的定制电路板设计的硬件设计注意事项](#)

---

#### 备注

建议始终参阅 [TI.com](#) 上提供的更新版本。

---

#### 备注

我们推出了最新的 AM62L 处理器系列，客户在考虑支持多种低功耗模式（包括仅 RTC 模式）的成本优化型定制电路板设计时，可以考虑采用该系列。

[使用 AM62L \(AM62L32、AM62L31\) 处理器系列的定制电路板设计的硬件设计注意事项](#)

---

## 2.3 处理器系列用户指南 ( 原理图设计指南与原理图审查检查清单 )

按系列划分的原理图设计指南和原理图审查检查清单用户指南包含原理图审查检查清单（以及设计指南），可根据定制电路板设计中使用的处理器（处理器系列）参考（使用）。

### 2.3.1 AM62x 处理器系列

[AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列的原理图设计指南和原理图审查检查清单](#)

### 2.3.2 AM62Ax 与 AM62D-Q1 处理器系列

[AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列的原理图设计指南和原理图审查检查清单](#)

### 2.3.3 AM62Px 处理器系列

[AM62P、AM62P-Q1 处理器系列的原理图设计指南和原理图审查检查清单](#)

---

#### 备注

建议始终参阅 [TI.com](#) 上提供的更新版本。

---

#### 备注

客户在考虑支持多种低功耗模式（包括仅 RTC 模式）的成本优化型定制电路板设计时，可以考虑最新的 AM62L 处理器系列。

[AM62L \(AM62L32、AM62L31\) 处理器系列的原理图设计指南和原理图审查检查清单](#)

---

## 3 处理器特定信息

---

#### 备注

在定制电路板设计（基于所使用的处理器系列）期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南 \( 定制电路板设计硬件设计注意事项 \)](#)

[处理器系列用户指南 \( 原理图设计指南与原理图审查检查清单 \)](#)

---

### 3.1 选择处理器 OPN ( 可订购器件型号 )

根据所需特性选择处理器 OPN 是定制电路板设计过程中的一个关键且重要的环节。如要简要了解处理器系列 ( AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px ) 架构以及根据所需功能和特性、封装 ( ALW ( AM625、AM623 ) 、 AMC ( AM620-Q1、AM625-Q1 ) 、 AMK ( AM625SIP ) 、 AMB ( AM62Ax ) 、 ANF ( AM62Ax ) 、 ANF ( AM62D-Q1 ) 、 AMH ( AM62Px ) ) 和速度等级选择所需处理器 OPN ( 定制电路板上使用的处理器 ) , 请参阅处理器特定数据表的功能方框图、器件比较、器件命名规则、器件速度等级和封装信息各节。

建议使用所选的处理器 OPN 更新原理图。

有关处理器系列支持的 ( 可用 ) 封装的信息 , 请参阅以下常见问题解答 :

[[常见问题解答](#)] **AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A/AM62D-Q1/AM62P/AM62L** 定制电路板硬件设计 - 可用器件封装

### 3.2 处理器特定数据表用例和用户指南编辑所引用的版本

处理器特定的数据表包括 :

1. 引脚属性 ( 焊球编号 , 引脚到多路复用功能的映射 ) 。
2. 信号说明。
3. 引脚连接要求。
4. 适用处理器外设的电气特性、时序和开关特性以及计时示意图。
5. 处理器电源导轨的建议工作条件。
6. 处理器电源导轨的序列 ( 加电和断电 ) 。
7. 最大工作条件和建议工作条件。
8. 处理器内部结构的详细说明。
9. 应用、实现和布局。
10. 包括器件命名规则 ( 器件命名约定 ) 、工具和软件的器件和文档支持。
11. 修订历史记录。
12. 机械、封装和可订购信息。

( 用户指南编辑过程中 ) 引用的处理器特定数据表及其修订编号 :

#### **AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 处理器系列**

SPRSP58B - 2022 年 6 月 - 2023 年 6 月修订 ( AM62x Sitara 处理器数据表 ( 修订版 B ) )

#### **AM625SIP 处理器系列**

SPRSP98A - 2023 年 11 月 - 2024 年 6 月修订 ( AM625SIP - AM6254 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 Sitara 处理器数据表 ( 修订版 A ) )

#### **AM62Ax 处理器系列**

SPRSP77D - 2023 年 3 月 - 2025 年 6 月修订 ( AM62Ax Sitara 处理器数据表 ( 修订版 D ) )

#### **AM62D-Q1 处理器系列**

SPRSPB5A - 2024 年 12 月 - 2025 年 5 月修订 ( AM62Dx Sitara 处理器数据表 ( 修订版 A ) )

#### **AM62P 和 AM62P-Q1 处理器系列**

SPRSP89B - 2023 年 12 月 - 2025 年 8 月修订 ( AM62Px Sitara 处理器数据表 ( 修订版 B ) )

有关更多信息 , 请参阅以下常见问题解答 :

[[常见问题解答](#)] **AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x** 设计建议 / 定制电路板硬件设计 - 当前数据表的修订版、更新、修订版备份和使用说明

### 3.3 外设实例命名约定 — 数据表和 TRM

对于外设命名和可用的外设实例数量、处理器特定 TRM 往往是通用的，而处理器特定数据表是特定的（包括支持的实例数量）。有关支持的外设和外设实例，建议始终参阅处理器特定数据表。

在处理器特定数据表的信号命名中，即使存在单个外设实例，也会为外设名称分配后缀编号。后缀以 **0** 开头。

对于通用平台以太网交换机 3 端口千兆位 (CPSW3G0) 端口名称，端口 **0** 是交换机的内部（通信端口编程接口 (CPPI) 主机）端口。

### 3.4 不使用时的处理器外设和 IO 连接

在定制电路板设计期间，可能不使用一些处理器外设（不使用）。在不使用时，处理器外设（包括具有专用功能的外设）具有特定连接要求。有关不使用时连接外设的信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。连接要求一节包括连接电源导轨和接口信号的建议。

支持替代功能的配置（多路复用）的处理器 GPIO（与外设、SDIO 或 LVCMOS 缓冲器类型进行多路复用）在不使用时可保持未连接状态（如果未指定连接要求）。外设和 IO 的焊盘配置可以是复位状态。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 数据表引脚属性及引脚连接相关问题](#)

### 3.5 按处理器 OPN 的订购和质量信息

有关所选处理器的订购和质量的信息，请访问以下链接：

**AM62x 处理器系列：**

[AM625 - 订购和质量](#)

[AM623 - 订购和质量](#)

[AM620-Q1 - 订购和质量](#)

[AM625-Q1 - 订购和质量](#)

[AM625SIP - 订购和质量](#)

**AM62Ax 处理器系列：**

[AM62A7 - 订购和质量](#)

[AM62A7-Q1 - 订购和质量](#)

[AM62A3 - 订购和质量](#)

[AM62A3-Q1 - 订购和质量](#)

[AM62A1-Q1-订购和质量](#)

**AM62D-Q1 处理器系列：**

[AM62D-Q1-订购和质量](#)

**AM62Px 处理器系列：**

[AM62P - 订购和质量](#)

[AM62P-Q1 - 订购和质量](#)

### 3.6 选择所需处理器 GPN（通用器件型号）和 OPN（订购器件型号）的检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

## 4 处理器电源架构

### 备注

在定制电路板设计（基于所使用的处理器系列）期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）](#)

[处理器系列用户指南（原理图设计指南与原理图审查检查清单）](#)

有关 TI 电源管理产品组合的概述，请参阅 [TI 电源管理](#) 页面。

[WEBENCH® 电路设计器工具](#) 提供一个可视界面，可用于创建定制的电源架构。

### 4.1 生成处理器特定和外设（所连接器件）电源导轨

可使用集成式（使用 PMIC、分立式直流/直流转换器、分立式 LDO）或分立式（使用直流/直流转换器、分立式 LDO）电源架构生成所选处理器和所连接器件所需的电源导轨。

PMIC（集成式电源架构）专为特定处理器或处理器系列而设计。使用 PMIC 可简化电源架构（电源导轨）设计。PMIC 生成常用（使用的）处理器和所连接器件电源。PMIC 在内部管理上电时序、断电时序、电源转换率控制、可选残余电压（电压衰减）检测，并满足处理器特定电源（PDN）要求。其他分立式直流/直流转换器和分立式 LDO 可用于根据用例生成所需的其他板载电源（根据用例）。

使用分立式电源架构可让您在选择电源器件和电源架构设计时具有灵活性。由于定制电路板设计人员负责选择分立式直流/直流转换器和 LDO（提供所需负载电流）、直流/直流转换器和 LDO（可进行调整或配置以生成所需电源电压）、直流/直流转换器和 LDO（可支持所需负载电流瞬态）、控制、电源转换率并支持配置所需的电源时序），因此设计工作量可能会增加。

处理器电源轨指定了压摆率要求。对于电源导轨（生成或开关），建议遵循处理器特定数据表的电源转换率要求一节。

以下各节总结了可用于使用 PMIC 或分立式电源架构实现板载电源的电源转换器产品系列（直流/直流转换器和 LDO）和相关配套资料：

#### 4.1.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列电源架构

##### 4.1.1.1 基于电源管理 IC (PMIC) 电源架构

推荐用于集成式电源架构的 PMIC 包括 [TPS65219](#)。这种经过空间、性能和 BOM（物料清单）优化的电源架构可以设计为使用 PMIC 为处理器和所连接器件供电。

TPS65219 PMIC 系列支持 3（三）个降压输出和 4（四）个 LDO 输出（基于处理器内核的电源导轨和内存（DDR）类型）配置（PMIC 版本、固定输出（NVM 编程），可编程）。建议根据所选的处理器配置和所连接器件选择所需的 PMIC 配置（版本）。要选择所需的 PMIC OPN，请参阅 [TPS65219](#) 产品页面。为定制电路板设计人员提供了 PMIC 原理图和布局检查清单，可在定制电路板原理图设计期间使用。

有关可用 OPN 和建议连接的输出电压配置的应用手册和信息，请参阅以下链接：

[使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电](#)

[使用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电](#)

请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 设计建议/定制电路板硬件设计 — PMIC TPS65219 和 PDN 的常见问题](#)

请参阅 TPS65219 OPN 特定技术参考手册（例如：[TPS6521901 技术参考手册](#)），了解有关 NVM（输出电压和 IO）配置的信息。

根据应用和定制电路板设计架构，可选择 PMIC OPN。每个 OPN 都有特定的 NVM 配置（输出电压）。有关所选 OPN、NVM 配置 TRM 和完整寄存器映射，请参阅 [TPS65219](#) 产品页面的 PMIC 数据表。

此外，请参阅以下应用手册：

[使用 TPS65219 PMIC 为 AM62 处理器供电相对于分立式电源设计的优势](#)

有关残余电压和检测的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与残余电压、检测和电源衰减相关的疑问](#)

#### 4.1.1.1.1 TPS65219x 基于 PMIC 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 4.1.1.1.2 其他参考内容

有关信息，请参阅处理器特定数据表的以下章节。

- 器件连接和布局基本准则
- 电源
- 电源设计

#### 4.1.1.2 基于分立式电源器件 ( DC/DC、LDO ) 的电源架构

要生成处理器和所连接器件电源导轨，可以考虑使用分立式电源架构。

电源架构可以基于分立式[直流/直流转换器](#)和 LDO。

有关器件选择和电源架构实现的信息，请参阅 [AM62x 的分立式电源解决方案](#)应用手册。

当实现定制 ( TI 或非 TI ) 分立式电源架构时，请在所有电源斜升后注意电源尺寸 ( 额定电流 ) 、电源时序、电源转换率控制和 MCU\_PORz 输入 L->H 延迟 ( 保持时间 ) ( 用于振荡器启动和稳定 ) 要求。建议根据处理器特定数据表验证是否遵循了上述要求。

在电源导轨断电 ( 关闭 ) 期间，建议 MCU\_PORz 输入在电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。建议分立式电源架构设计为能够在任何电源导轨降至建议工作条件下定义的最小值以下时，在启动新的上电序列之前关闭所有电源导轨并监控电源导轨衰减到 300mV 以下。

建议在上电期间将 MCU\_PORz 输入 ( 必需 ) 保持为低电平 ( 有效 ) ，直到所有处理器电源斜升并有效 ( 稳定 ) 加最短延迟 9.5ms ( 处理器特定数据表中称为 9500000ns ) ，以便内部振荡器启动并稳定 ( 使用外部晶体加内部振荡器时，请参阅处理器特定数据表 ) 或 MCU\_PORz 输入保持低电平 ( 有效 ) ，直到所有处理器电源上升并有效，并且外部振荡器时钟输出稳定 ( 当使用外部 LVCMS 数字时钟源 ( 振荡器 ) 时 ) ，加上最小延迟 1.2 μs ( 在处理器特定数据表中称为 1200ns ) ( 请参阅处理器特定数据手册 ) 。

建议考虑[最大额定电流](#)应用手册来确定电源尺寸。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与分立式电源架构相关的疑问](#)

#### 4.1.1.2.1 分立式直流/直流

建议考虑分立式直流/直流，例如 [TPS62826](#) 或 [LM61460-Q1](#) 或类似开关电源器件。

有关可用的分立式直流/直流 ( 降压 ) 开关器件的概述，请参阅[交流/直流和直流/直流转换器 \( 集成 FET \)](#)页面。

此外，请参阅以下文档和视频库：

[TI 降压开关直流/直流转换器快速参考指南应用手册](#)

[电源设计培训资源 - 视频库](#)

#### 4.1.1.2.2 分立式 LDO

建议考虑使用分立式 LDO 器件，例如 [TPS74518](#)、[TLV7103318](#)、[TLV75518](#) 或类似 LDO。

要了解可用的分立式 LDO，请参阅 TI [线性和低压降 \(LDO\) 稳压器](#)页面。

另请参阅以下应用手册：

[低压降稳压器快速参考指南](#)

[LDO 线性稳压器设计指南](#)

[TI LDO 应用手册的主题索引](#)

#### 4.1.1.2.3 基于分立式电源器件 (DC/DC、LDO) 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 4.1.2 AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列电源架构

#### 4.1.2.1 基于电源管理 IC (PMIC) 电源架构

推荐用于集成式电源架构的 PMIC 包括 [TPS6593-Q1](#)。这种经过空间、性能和 BOM ( 物料清单 ) 优化的电源架构可以设计为使用 PMIC 为处理器和所连接器件供电。

有关实现，请参阅[入门套件 SK-AM62A-LP](#) 原理图。

有关更多信息，请参阅 [AM62A 的 TPS65931211-Q1 PMIC 用户指南](#)用户指南。

或者，集成式电源架构可以基于 [TPS65224-Q1](#) 等 PMIC。

有关实现，请参阅 [AUDIO-AM62D-EVM](#) 原理图。

有关更多信息，请参阅 [使用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 PMIC 的 Sitara AM62A/P/D\(-Q1\) 电源设计](#)应用简介。

---

#### 备注

对于汽车功能安全用例，建议将处理器的 MCU\_I2C0 接口连接到 PMIC (TPS65224/TPS65222) I2C1 接口。

---

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1/AM62D-Q1](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 - PMIC [TPS6593](#) 的常见问题

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 - PMIC [TPS65224-Q1](#) 的常见疑问

[常见问题解答] [TMUX1308-Q1 : EN 和控制输入端接 - AM62P、AM62A 用例](#)

有关残余电压和检测的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与残余电压、检测和电源衰减相关的疑问

#### 4.1.2.1.1 TPS6593x 基于 PMIC 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 4.1.2.1.2 TPS65224x 基于 PMIC 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 4.1.2.2 基于分立式电源器件 (DC/DC、LDO) 的电源架构

要生成处理器和所连接器件电源导轨，可以考虑使用分立式电源架构。

电源架构可以基于分立式直流/直流转换器和 LDO。

有关可用或推荐分立式电源架构的信息，请参阅 [TI.com](#) 上的处理器特定 ([AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1](#) 和 [AM62D-Q1](#)) 产品页面。

处理器特定产品页面提供了有关可用电源架构的最新信息。

当实现定制 (TI 或非 TI) 分立式电源架构时，请在所有电源斜升后注意电源尺寸 (额定电流)、电源时序、电源转换率控制和 MCU\_PORz 输入 L->H 延迟 (保持时间) (用于振荡器启动和稳定) 要求。建议根据处理器特定数据表验证是否遵循了上述要求。

在电源导轨断电 (关闭) 期间，建议 MCU\_PORz 输入在电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。建议分立式电源架构设计为能够在任何电源导轨降至建议工作条件中定义的最小值以下时，在启动新的上电序列之前关闭所有电源导轨并监控电源导轨衰减到 300mV 以下。

建议在上电期间将 MCU\_PORz 输入 (必需) 保持为低电平 (有效)，直到所有处理器电源斜升并有效 (稳定) 加最短延迟 9.5ms (处理器特定数据表中称为 9500000ns)，以便内部振荡器启动并稳定 (使用外部晶体加内部振荡器时，请参阅处理器特定数据表) 或 MCU\_PORz 输入保持低电平 (有效)，直到所有处理器电源上升并有效，并且外部振荡器时钟输出稳定 (当使用外部 LVCMOS 数字时钟源 (振荡器) 时)，加上最小延迟 1.2 μs (在处理器特定数据表中称为 1200ns) (请参阅处理器特定数据手册)。

建议考虑最大额定电流应用手册来确定电源尺寸。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与分立式电源架构相关的疑问

#### 4.1.2.2.1 基于分立式电源器件 (DC/DC、LDO) 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 4.1.3 AM62P 和 AM62P-Q1 处理器系列电源架构

#### 4.1.3.1 基于电源管理 IC (PMIC) 电源架构

推荐用于集成式电源架构的 PMIC 包括 [TPS65224-Q1](#)。这种经过空间、性能和 BOM (物料清单) 优化的电源架构可以设计为使用 PMIC 为处理器和所连接器件供电。

PMIC 为 AM62P、AM62P-Q1 处理器和所连接器件生成常用 (所需) 电源导轨。根据用例添加了 PMIC OPN (NVM 配置)。PMIC 的 nRSTOUT0 输出在电源斜升 + 建议的 MCU\_PORz 复位输入延迟时间后变为高电平。

#### 备注

对于汽车功能安全用例，建议将处理器的 MCU\_I2C0 接口连接到 PMIC (TPS65224/TPS65222) I2C1 接口。

有关实现基于 PMIC 的电源架构 (无功能安全)，请参阅 [入门套件 SK-AM62P-LP](#) 原理图。

有关更多信息，请参阅 [使用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 PMIC 的 Sitara AM62A/P/D\(-Q1\) 电源设计](#) 应用简介。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 - PMIC TPS65224-Q1 的常见疑问

[常见问题解答] [TMUX1308-Q1 : EN 和控制输入端接 - AM62P、AM62A](#) 用例

有关残余电压和检测的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与残余电压、检测和电源衰减相关的疑问

#### 4.1.3.1.1 TPS65224x 基于 PMIC 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 4.1.3.2 基于分立式电源器件 (DC/DC、LDO) 的电源架构

要生成处理器和所连接器件电源导轨，可以考虑使用分立式电源架构。

电源架构可以基于分立式直流/直流转换器和 LDO。

有关可用或建议的分立式电源架构的信息，请参阅 TI.com 上的处理器特定 ([AM62P](#)、[AM62P-Q1](#)) 产品页面。

处理器特定产品页面提供了有关可用电源架构的最新信息。

当实现定制 (TI 或非 TI) 分立式电源架构时，请在所有电源斜升后注意电源尺寸 (额定电流)、电源时序、电源转换率控制和 MCU\_PORz 输入 L->H 延迟 (保持时间) (用于振荡器启动和稳定) 要求。建议根据处理器特定数据表验证是否遵循了上述要求。

在电源导轨断电 (关闭) 期间，建议 MCU\_PORz 输入在电源开始斜降之前达到有效的逻辑低电平。建议分立式电源架构设计为能够在任何电源导轨降至建议工作条件中定义的最小值以下时，在启动新的上电序列之前关闭所有电源导轨并监控电源导轨衰减到 300mV 以下。

建议在上电期间将 MCU\_PORz 输入 (必需) 保持为低电平 (有效)，直到所有处理器电源斜升并有效 (稳定) 加最短延迟 9.5ms (处理器特定数据表中称为 9500000ns)，以便内部振荡器启动并稳定 (使用外部晶体加内部振荡器时，请参阅处理器特定数据表) 或 MCU\_PORz 输入保持低电平 (有效)，直到所有处理器电源上升并有效，并且外部振荡器时钟输出稳定 (当使用外部 LVCMS 数字时钟源 (振荡器) 时)，加上最小延迟 1.2 μs (在处理器特定数据表中称为 1200ns) (请参阅处理器特定数据手册)。

建议考虑最大额定电流应用手册来确定电源尺寸。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x](#) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与分立式电源架构相关的疑问

#### 4.1.3.2.1 基于分立式电源器件 (DC/DC、LDO) 的电源架构检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 4.2 处理器电源导轨电源控制、时序和电源过载保护

#### 4.2.1 负载开关 (处理器电源导轨电源开关)

负载开关用于对处理器和连接的器件电源导轨进行开关和时序控制。使用负载开关控制 (打开和关闭) 由同一输入电源导轨供电和个基准的特定外设或子系统的电源，而不是使用多个分立式直流/直流转转换器或 LDO 生成电源。在某些应用中，建议遵循建议的上电和下电序列。负载开关简化了实现电源时序控制，以满足上电和下电时序要求。负载开关使能可由 PMIC 或直流/直流转转换器 PG 输出控制，以满足处理器电源时序要求。

考虑 [TPS22965](#)、[TPS22918](#)、[TPS22902](#) 和 [TPS22946](#) 等负载开关。

要了解可用负载开关系列的概述，请参阅 TI [负载开关](#) 页面。

#### 4.2.1.1 负载开关 (处理器电源导轨电源开关) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 4.2.2 电子保险丝 IC (电源开关和保护)

在定制电路板设计上，电子保险丝可用在电源输入端进行保护。电子保险丝电源开关和保护 IC 是集成的电源路径保护器件，用于在故障情况下将电路电流和电压限制在安全电平。电子保险丝为设计提供了许多优势，并且包含通常难以使用分立式元件实现的保护功能。要了解可用的电子保险丝系列，请参阅 TI [电子保险丝和热插拔控制器](#) 页面。

## 5 一般建议

### 备注

在定制电路板设计（基于所使用的处理器系列）期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）](#)

[处理器系列用户指南（原理图设计指南与原理图审查检查清单）](#)

以下各节包括在开始定制设计之前建议遵循的一般建议。本节还包括在使用 SK 配套资料作为参考（包括原理图）以及设计定制电路板原理图期间的一般建议。

请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计—处理器内核、VDD\\_CORE、VDDR\\_CORE、VPP 和其他内核电源的信息](#)

### 5.1 处理器性能评估模块 (SK - 入门套件)

处理器（硬件）性能评估模块和平台（SK）不是参考设计。这些模块和平台并不代表正确或完整的电路板或终端设备功能实现。在一些情况下，SK 在处理器设计完成之前便已进行了部分或完全设计并发布进行制造。设置时间表是为了在首批器件供货后便可使用硬件平台。在处理器启动和基准测试期间会出现新（额外）的处理器要求。SK（硬件评估平台）可能并未考虑到所有这些新要求。因此，TI 希望定制电路板设计人员在设计定制电路板时仔细检查并遵循处理器特定数据表、器件勘误表、硬件设计注意事项用户指南、原理设计指南和 TRM 中定义的所有要求。

处理器（硬件）性能评估平台的设计并未涵盖所有定制电路板或终端设备特定要求，例如 EMI 或 EMC（电磁干扰、电磁兼容性测试，包括辐射敏感性、辐射发射、ESD）、噪声敏感性、热管理等。

有关定制电路板设计人员可以参考的设计更新说明以及 SK 原理图，请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计过程中的设计建议/常见错误-SK 原理图设计更新说明](#)

#### 5.1.1 评估模块（入门套件）检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 5.2 处理器特定 SK 与数据表

在定制电路板设计的设计阶段，如果在处理器评估或定制电路板设计期间处理器特定 SK 和处理器特定数据表之间存在任何差异，建议遵循处理器特定数据表。尽管 SK 设计人员已经尽了很大努力，但 SK 原理图可能有仍然起作用但不完全符合处理器特定数据表规范的错误。

#### 5.2.1 有关元件选择的注意事项

### 备注

提供 SK 原理图中的元件值、封装尺寸和额定电压作为定制电路板设计人员的起点，并不总是经过优化。建议定制电路板设计人员验证值、尺寸和额定电压是否适用于特定的定制电路板实现，并进行所需的更新。

建议查看有关定制电路板设计要求的 SK BOM，并根据处理器特定数据表建议、应用要求、遵循的定制电路板设计方法以及可用（公司特定或通用）的设计或元件选型指南来优化元件。

建议在最终确定元件（值、封装、额定电压和额定功率）之前执行电路实现设计计算、执行板级测试和测量、进行内部设计审查。

### 5.2.1.1 串联电阻

建议根据用例在处理器 IO 接口上配置一个串联电阻器 ( $0\Omega$ )。SK 原理图中使用的串联电阻器值可用作定制电路板设计的起点。建议定制电路板设计人员验证定制电路板上的数值，并且根据需要进行调整（引脚上出现的阶跃函数不接近  $1/2 Vs$ ）。建议根据需要进行仿真以最终确定值。

### 5.2.1.2 并联拉电阻

#### 备注

除非行业标准中定义了拉电阻器要求，否则对于外部拉电阻器没有明确的规则或要求。拉电阻器的行业通用定义是我们可以针对 eMMC 和 SD 卡信号上的外部拉电阻器给出确定建议的主要原因。对于其他外设，建议客户评估连接到定制电路板上每个处理器信号的所连接器件的功能，并运用适当的技术/工程判断来确定是否需要使用外部拉电阻器，以防止在打开所连接器件输入缓冲器时任何输入悬空。设计指南中提供的建议是通用的，客户应在实现之前查看设计要求和所连接器件内部拉电阻器的可用性。确保不提供与内部拉电阻器争用的外部拉电阻器。示例：例如，添加一个与内部拉电阻器（所连接器件内部）争用的外部拉电阻器，这样争用会在信号（输入）上产生  $1/2 Vs$  电势。

建议为连接了布线且未被主动驱动的处理器 IO 或为连接到可悬空的所连接器件输入的 IO 提供并联拉电阻器配置（以防止所连接器件输入在主机软件配置 IO 之前处于悬空状态）。并联拉电阻器的极性和拉电阻器值取决于特定的外设连接建议、处理器性能和可靠性提升建议以及相关接口或标准要求。此外，还提供了上拉电阻器建议。

处理器特定 SK 中使用的拉电阻器值可用作起点，定制电路板设计人员可根据处理器和所连接器件或特定电路板设计要求的建议选择适当的拉电阻器值。建议为没有特定建议的 IO 或接口选择  $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ （允许选择上拉电阻器以实现元件选择和 BOM 的标准化）拉电阻器值。可根据电路板设计选择拉电阻器值，以优化元件的使用或降低电流或提高噪声性能。

当布线连接到处理器引脚（IO 焊盘）且 IO 未被主动驱动（悬空）时，建议使用并联拉电阻器 ( $47k\Omega$ )。在复位期间和复位后，处理器 IO 缓冲器是（TX（输出）和 RX（输入）被禁用，在复位期间和复位后关闭内部拉电阻器（上拉和下拉电阻器）。IO 处于高阻抗状态，实际上相当于会拾取噪声的天线。无并联拉电阻器的情况下，IO 处于高阻抗状态。高阻抗使得噪声可以轻松地将能量耦合到悬空信号布线上，并产生可能超出 IO 建议工作条件的电势。这种电势会在 IO 上产生电气过应力（EOS）。处理器内部的静电放电（ESD）保护电路设计用于在将器件安装到 PCB 上之前处理过程中仅防止器件遭受 ESD。

### 5.2.1.3 驱动强度配置

处理器系列当前不支持配置除额定（默认）值（例如：SDIO 或 LVC MOS 缓冲器的驱动强度）之外的驱动强度（任何其他可用配置）。额定（SDIO 为  $40\Omega$ ，LVC MOS 为  $60\Omega$ ）值是关闭处理器级 STA（静态时序分析）的唯一配置。AM62P、AM62P-Q1 处理器系列实现 eMMC（专用）硬宏 PHY，并且 MMC0 IO 的额定阻抗设置为  $50\Omega$ 。IBIS 模型目前已更新为仅包含已在内部关闭时序的驱动强度。

有关驱动强度配置支持的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SDIO 和 LVC MOS 的 I/O 驱动强度配置

### 5.2.1.4 处理器特定数据表建议

定制电路板设计人员负责实现所需或建议的电路，以确保定制电路板设计符合处理器特定数据表引脚连接要求。示例：I<sup>2</sup>C 开漏电气特性的要求 — 拉至 3.3V 电源时的输入转换率限制要求。

如果没有处理器特定的数据表建议，建议先遵循原理图设计指南或遵循 SK 原理图实现作为起点。

### 5.2.1.5 处理器 IO 保护 — 配置外部 ESD 保护器件

建议为直接连接到外部输入或连接到外部连接器的处理器 IO 提供外部 ESD 保护。内部 ESD 保护不能满足板级 ESD 要求。要了解 ESD 保护器件，请参阅 TI [ESD 保护](#) 页面。

### 5.2.1.6 外设时钟输出串联电阻器

由于时钟也用于重定时，因此建议在处理器时钟输出（对于 MCSPI、MCASP）引脚附近添加时钟输出上的串联电阻器 ( $22\Omega$ )。该串联电阻器还支持可能的反射控制（信号失真）。

对于 MMC0、MMC1、MMC2、OSPI0、GPMC0 接口，使用未绑定的焊盘（内部）进行重定时（环回）。我们不使用通过 PCB 发送到所连接器件的时钟作为捕获时钟。我们将输出时钟分支到器件内部的两条路径。其中时钟发送到两个单独的 IO 单元。一个 IO 单元连接到一个封装焊球，用于为所连接器件提供时钟。另一个 IO 单元未绑定（未连接到任何封装焊球）。用作接收捕获时钟的时钟通过未绑定的 IO 单元发出，并在用作捕获时钟之前环回到器件。我们这样做的目的是让时钟具有与输出到所连接器件的时钟上插入的相同延迟，并且具有与从所连接器件返回的数据上插入的相同延迟。未绑定的 IO 电池焊盘永远不会经历 PCB 信号布线源端产生的电压阶跃。建议使用低值串联电阻器（从  $0\Omega$  开始）来控制可能的信号反射（信号完整性目的）。

### 5.2.1.7 外设时钟输出下拉电阻器

在连接到靠近所连接器件时钟输入的所连接器件的外设时钟输出（eMMC、SDIO、SD 卡、OSPI0、MCSPI、MCASP、GPMC0）处，建议使用下拉电阻器。可选择配置电容器（8 至  $10\text{pF}$ ），并将其配置为不组装。如果观察到与板级信号完整性相关的问题，可以安装电容器。建议使用最短残桩将电容器连接到所连接器件的时钟输入。

### 5.2.1.8 元件选型检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 5.2.2 有关 SK 设计（原理图、电路板）和重复使用的额外信息

### 5.2.2.1 更新了 SK 原理图（添加了设计、审核和 CAD 注解）

在定制电路板设计过程中，作为设计流程的一部分，定制电路板设计人员可以（往往）重复使用 SK 设计（CAD 文件）并进行必要修改。或者，定制电路板设计人员可以重复使用常见电路实现（章节），包括处理器、内存、电源和高速通信接口。由于 SK 设计应纳入其他功能，因此定制电路板设计人员往往会根据定制电路板相关要求优化 SK 原理图设计。在对 SK 原理图进行优化时，会在定制电路板设计中引入误差，这类误差可能会影响定制电路板的功能、性能或可靠性。优化 SK 原理图时，定制电路板设计人员可能有关于 SK 电路实现的疑问。在原理图审查期间和定制电路板调试期间，观察到多个定制电路板设计存在常见设计和优化误差。根据客户疑问、客户建议和内部建议，以及数据表中的引脚连接建议，我们在 SK 原理图的各部分附近添加了全面的设计注解（D-Note）、审查注解（R-Note）和 CAD 注解（CAD-Note），供定制电路板设计人查阅并遵循（以便实现建议以更大限度减少电路板设计误差）。

以下产品概述文档列出了可下载的设计文档：

#### 5.2.2.1.1 AM625 和 AM623 处理器系列

[SK-AM62B 设计包文件夹和文件列表产品概述](#)

[SK-AM62B-P1 设计包内容概述产品概述](#)

#### 5.2.2.1.2 AM620-Q1 和 AM625-Q1 处理器系列

[SK-AM62-LP 设计包内容概述产品概述](#)

#### 5.2.2.1.3 AM625SIP 处理器系列

[SK-AM62-SIP 设计包文件夹和文件列表产品概述](#)

#### 5.2.2.1.4 AM62Ax 处理器系列

[SK-AM62A-LP 设计包文件夹和文件列表产品概述](#)

#### 5.2.2.1.5 AM62D-Q1 处理器系列

以下常见问题解答中列出了可下载的设计文档：

[[常见问题解答](#)] AM62D-Q1 : - 定制电路板硬件设计 - 关于重复使用 AUDIO-AM62D-EVM 原理图的设计和审阅说明

产品概述文档目前正在起草中。查看上述常见问题解答，或者建议经常在 [TI.com](http://TI.com) 上查看供货情况。

### 5.2.2.1.6 AM62Px 处理器系列

#### [SK-AM62P-LP 设计包文件夹和文件列表产品概述](#)

### 5.2.2.2 SK 设计文件重复用于定制电路板设计

根据定制电路板设计期间遵循的设计方法和项目时间表，可以使用 **SK** 设计文件，以此为起点进行所需的更新（根据定制电路板要求而变）。建议在实现之前审查 **SK** 原理图设计。建议根据定制电路板功能和性能要求检查元件选择的尺寸、容差和额定电压。

以下常见问题解答包括 PDF 原理图和与入门套件相关的其他信息：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 - 重复使用 TI SK \(EVM\) 设计文件](#)。

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 - 重复使用 TI SK \(EVM\) 设计文件](#)

[常见问题解答] [AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 重复使用 TI SK \(EVM\) 设计文件](#)

### 5.2.2.2.1 SK 设计文件重复用于定制电路板设计—检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 5.2.3 SK 原理图页面排序 (基于功能、重复使用) 和 SK 电路板布局

对于目前正在发布或正在进行（将在未来发布）的 **SK** 原理图修订，TI 正在以模块化格式排列（排序）原理图页面，以便于重复使用。原理图页面流程从所需的页面开始，包括处理器电源生成、处理器电源和外设连接、所连接器件电路实现。在所需的页面之后添加了可选的调试和监控章节。该排列有助于定制电路板设计人员删除定制电路板设计期间未使用的原理图部分。

**SK** 板设计实现采用一种扁平架构，在同一电路板上集成了处理器和所连接器件。定制电路板设计人员在设计扁平架构定制电路板时可以遵循 **SK** 实现。如果客户电路板架构是 **SOM**（模块上系统）和载板，则电路板布局方法（信号布线要求）、建议可能会发生变化。建议客户验证以下指南，并遵循一般 **SOM** 设计和布局指南，以解决板级信号完整性问题：

1. **SOM** 和载板之间的信号连接（高速差分信号）（包括极性）
2. 选择当高速信号在电路板之间切换时不会影响电路板功能或性能的高速连接器（接触电阻和电感较低）
3. 在连接器上的信号之间提供足够数量的接地焊盘，以屏蔽信号，优化电路板性能（显著减少与信号完整性相关的问题）
4. 提供了内存和其他高速或低速外设的建议或所需终端
5. 已满足 **SOM** 和载板信号之间的失效防护工作要求
6. **SOM** 和载板之间连接的电路实现的完整性
7. **SOM** 和载板信号之间的 IO 电平兼容性
8. 连接到处理器且可悬空的任何处理器 IO 或所连接器件 IO 都提供了并联拉电阻器的配置，并且已验证极性
9. 在开始电路板构建之前已执行了所需的仿真（**SOM** 和载板）

有关高速设计的其他输入，包括基于 **SOM** 的设计，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV\)/ AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 电路板布局 - 通用高速布局指南文档链接](#)

## 5.3 处理器特定 SDK

如果针对新平台进行定制电路板设计或针对平台进行更新，建议使用 [TI.com](http://TI.com) 上软件开发工具的最新版本或修订版。

### AM62x 处理器系列：

请访问以下链接来下载所需的 SDK 版本：

## PROCESSOR-SDK-AM62x

1. **MCU-PLUS-SDK-AM62x** : 适用于 AM62x 的 MCU+ SDK – RTOS、No-RTOS
2. **PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62x** : Processor SDK Linux for AM62x

请参阅 **AM62x 软件构建表** (**AM62x 处理器系列支持功能的构建表**)。

### AM62Ax 处理器系列 :

请参阅以下链接来下载所需的 SDK 版本 :

#### PROCESSOR-SDK-AM62A

1. **PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62A** : Linux SDK , 用于 AM62A 的边缘 AI 应用程序
2. **MCU-PLUS-SDK-AM62A** : 适用于 AM62A 的 MCU+ SDK – RTOS、No-RTOS

请参阅 **AM62A 软件构建表** (**AM62Ax 处理器系列支持功能的构建表**)。

### AM62D-Q1 处理器系列 :

请参阅以下链接来下载所需的 SDK 版本 :

#### AM62D-AWE-SDK—适用于 AM62D 的 AudioWeaver Audio SDK

### AM62Px 处理器系列 :

请参阅以下链接来下载所需的 SDK 版本 :

#### PROCESSOR-SDK-AM62P

1. **MCU-PLUS-SDK-AM62P** : 适用于 AM62P 的 MCU+ SDK – RTOS、No-RTOS
2. **PROCESSOR-SDK-LINUX-AM62P** : Processor SDK Linux for AM62P

请参阅 **AM62P 软件构建表** (**AM62Px 处理器系列支持功能的构建表**)。

如果使用较旧的版本/修订，建议使用版本说明验证兼容性或联系 TI (通过 E2E)。

## 5.4 开始定制电路板设计之前的一般设计建议 (需了解)

### 5.4.1 处理器文档

在定制板设计阶段中，建议参考/使用最新版本的配套资料/文档，示例包括处理器特定数据表、器件勘误表、TRM和其他常用参考电路板设计资料。请定期查看 [TI.com](http://TI.com) 上的处理器特定产品页面，查找最新的可用文档修订版或添加的新文档。

**文档搜索提示**：在文档中搜索 *recommended*、*Required*、*do not*、*note*、*pin connectivity* 等字词。处理器的重要条件通常包含其中一个或多个词语。

**获取更新信息的技巧**：在 [TI.com](http://TI.com) 的处理器产品页面上，有一个**通知按钮**。在此按钮处注册便可启用关于处理器文档更改的自动通知。

[TI.com](http://TI.com) 上提供了处理器特定数据表的最新修订版或其他配套资料。建议在内部存档较旧的修订版以供将来使用。

### 5.4.2 处理器引脚属性 (引脚排列) 验证

验证定制电路板设计中使用的处理器引脚的以下属性：

- 处理器引脚编号标签和命名 (与处理器符号一节关联的引脚编号) 对应于处理器特定数据表的**引脚属性**一节中列出的正确引脚编号。建议在符号内保留处理器特定数据表名称，并根据应用用例更改功能 (网) 名称。
- 连接到处理器电源引脚的电源电压遵循建议工作条件。
- 原理图中显示了处理器的所有引脚 (按功能分组并具有单独的符号块，包括保留的引脚)，以更大程度地减少工具相关错误和功能错误。

- 在复位期间和复位后，许多处理器 IO TX (输出) 和 RX (输入) 缓冲器被禁用，并且内部上拉电阻器 (上拉和下拉电阻器) 被关闭。建议使用外部拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ) 将任何所连接器件保持在有效状态，直到软件初始化 IO、连接了布线并且未主动驱动 IO。当 TP 连接到处理器 IO 时，建议使用并联拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ )。当添加拉电阻器不可行时，建议布线远离高频率信号。
- 为了提高定制电路板性能，可以考虑配置处理器电源导轨 (电压)、电源导轨的电流消耗外部测量以及热点处的板载温度测量。

有关处理器特定数据表引脚属性的相关问题，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计-与 SOC 数据表引脚属性相关的疑问 Excel 格式

#### 5.4.3 器件比较、IOSET 和电压冲突

比较此表中所列特性的可用性是共享 IO 引脚的功能，其中与许多特性相关的 IO 信号会多路复用到有限数量的引脚。建议使用 SysConfig-PinMux 工具为引脚分配信号功能。SysConfig-PinMux 工具将帮助您更好地理解与引脚多路复用相关的限制。

处理器外设使用分组为 IOSET 的 IO 进行时序闭合。IOSET 是特定于某个接口的信号分组，这些信号作为一个集合完成时序闭合。建议任何具有 IOSET 的接口都从同一 IOSET 中选择所有接口信号。某些接口信号可以通过多个 IOSET 共享。SysConfig-PinMux 工具中详细介绍了支持特定外设的 IOSET 引脚的有效组合。

**电压冲突：**

信号按功能 IO 域而不是电源域分组，因此某些外设 IO 配置可能会遇到电压冲突警告。该警告是为了突出显示 IO 的首选电压与配置电压之间的差异，以便定制电路板设计人员可以在实际发生电压冲突时采取必要的措施。该警告在对来自不同电压域的 GPIO 信号进行分组时非常有用，因为当前工具配置仅允许每个外设一个首选电压。任何包含具有不同电压电平的 IO (引脚) 的外设都会显示警告。显示警告的原因是首选电压电平与 IO (引脚) 电压不同 (例如，首选电压为  $3.3\text{V}$ ，而引脚电压为  $1.8\text{V}$ )。只要  $1.8\text{V}$  是所选 IO (引脚) 的预期电压，就可以抑制该警告。冲突指示不是硬件问题或工具错误，而是通知首选电压与配置的 IO (引脚) 电压不同。该警告仅用于突出显示首选工作电压与选定 (配置的) 工作电压之间的冲突。只要您了解冲突的原因，就可以抑制警告。

有关电压冲突的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 SysConfig-PinMux IOSET 和电压冲突相关的疑问

#### 5.4.4 RSVD 预留引脚 (信号)

名为 RSVD 的引脚被预留。建议按照处理器特定数据表中的建议，将 RSVD 引脚保持未连接状态 (无测试点 (TP))。

建议将 RSVD 引脚保持未连接状态 (请勿连接任何 PCB 布线或测试点)。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 — RSVD 引脚的连接建议

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

#### 5.4.5 PADCONFIG 寄存器注意事项

许多处理器 IO (LVCMOS 或 SDIO 缓冲器类型) 支持在同一引脚上多种 (不同) 功能的多路复用。可以从多种支持功能中选择所需 IO 功能。处理器特定数据表的引脚属性表的信号名称列中列出了每个 IO (焊盘) 上可用的功能列表。

使用相关 (关联) 焊盘配置寄存器的 MUXMODE 字段配置所需的功能。PADCFG\_CTRL0\_CFG0\_PADCONFIG0 至 PADCFG\_CTRL0\_CFG0\_PADCONFIG150 寄存器支持 (可用于) 处理器 MAIN 域 IO 模块的信号多路复用，

MCU\_PADCFG\_CTRL0\_CFG0\_PADCONFIG0 至 MCU\_PADCFG\_CTRL0\_CFG0\_PADCONFIG33 寄存器支持（可用于）处理器 MCU 域 IO 模块的信号多路复用。

处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器一节 焊盘配置寄存器功能说明小节中 焊盘配置寄存器位的说明表汇总了位字段说明、支持的配置和 PADCONFIG 寄存器的复位值。建议在配置 PADCONFIG 寄存器时，遵循表末尾列出的注释。建议在与相应 PADCONFIG 寄存器关联的引脚没有提供有效逻辑输入的情况下，切勿设置 RXACTIVE 位。悬空输入可能会损坏处理器 IO 或影响处理器的可靠性。默认设置 ST\_EN 位。建议验证 ST\_EN 位，并在该位值复位为 0 的情况下将该位设置为 1。建议不要修改该位的默认值。处理器特定 TRM 的 焊盘配置寄存器一节的 焊盘配置 PADCONFIG 寄存器小节的 焊盘配置 PADCONFIG 寄存器表中列出了所有 PADCONFIG 寄存器默认配置的汇总。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计 — PADCONFIG 位和 PADCONFIG 寄存器默认值汇总信息

#### 5.4.6 针对失效防护操作的处理器 IO (信号) 隔离

建议为 IO 组的处理器 IO 电源和所连接器件（或者 FPGA、MCU 或处理器）IO 电源供电至同一电源，以确保不存在与失效防护运行相关的违规情况。当处理器与所连接器件或额外处理器连接至不同的电源（由其供电）时，建议进行信号隔离，因为大多数处理器 IO 都不具备失效防护功能。建议通过 FET 总线开关电路连接信号，该电路设计用于当 IO 电源对于作为输入所连接器件无效时隔离两个器件。建议 FET 总线开关和控制逻辑由常开电源供电，并且仅由多个（不同）电源的电源正常信号的“与”函数启用。

#### 5.4.7 引脚连接要求和处理器特定 SK 的参考

处理器特定数据表的信号说明和引脚连接要求两节包括特定于处理器系列的外设、IO 和引脚（功能）的连接建议。

当处理器特定数据表不包含特定连接要求时，可以参考处理器特定 SK。

#### 5.4.8 定制电路板高速接口设计指南

有关 USB2.0 和 CSI-RX 信号连接和布线的建议，请参阅 [高速接口布局指南](#)。建议包含与定制电路板设计期间应遵循的布线要求相关的适当约束或注释。

对于 USB 接口，当定制电路板预计将在恶劣的工业环境中运行时，可以选择添加共模来提高定制电路板的 USB 接口防噪性能。添加共模扼流圈会降低信号振幅并降低 USB 接口性能（速度、数据吞吐量、通信错误）。建议为使用  $0\Omega$  电阻器绕过共模扼流圈添加配置。建议根据应用要求为 USB 接口和 USB 电源添加外部 ESD 保护配置。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 电路板布局 — 通用高速布局指南文档链接

#### 5.4.9 针对 LVC MOS (GPIO) 输出源电流或灌电流的建议

由配置为输出的处理器 IO 拉出的直流电流输出需要保持小于定义的最大  $I_{OH}$  和  $I_{OL}$  值，以实现电气特性表中定义的  $V_{OL}$  最大值和  $V_{OH}$  最小值。处理器特定数据表中定义的输出电流不应用作稳态电流的限值。仅当对信号电容进行充电或放电以将信号从低电平转换为高电平或从高电平转换为低电平时，才会达到数据表中的输出电流限值。信号达到有效逻辑状态后，稳态电流应远低于数据表中的电流限制值。输出可以容许一定水平的稳态电流，以满足典型拉电阻器的过驱需求，但不应持续承受较大稳态电流，如持续驱动 LED 或类似负载所需的电流。建议通过处理器 IO 引脚控制外部 FET 或晶体管开关来驱动 LED 或需持续消耗电流的类似负载。

#### 5.4.10 将慢速斜升信号（输入）或电容器负载（输出）连接到处理器 IO

LVC MOS (SDIO) 输入指定了转换率要求（作为电气规范的一部分）。不建议将慢速斜升输入（信号）直接连接到 LVC MOS (SDIO) 输入。如果所施加的输入（信号）在  $V_{IHSS}$  和  $V_{ILSS}$  之间的电压区域花费更多的时间，那么可能存在与输入缓冲器相关的长期可靠性问题（隐患）。允许（建议）的转换时间小于 1000ns。转换率与频率相关。当信号切换速率不高（非频率制约型限制）时，建议使用 1000ns 的最大转换率。当 IO 在 1.8V 电压下工作时

(例如)，当信号切换速率  $< 100\text{kHz}$  时， $1.8\text{E}+6\text{V/s}$  的非频率制约型限制将变成较大的值。当信号切换速率  $> 100\text{kHz}$  时， $18\text{fV/s}$  ( $f$ =输入信号的切换频率，以 Hz 为单位) 的频率制约型限制会变成较大的值。当施加慢速斜升输入时(当输入为  $1/2\text{Vs}$  时)，击穿电流将从 VDD 通过部分导通的 P 沟道晶体管和部分导通的 N 沟道晶体管流向 VSS。累积的慢速斜升输入会导致 IO 性能、电路板性能或处理器可靠性问题。

不建议将大电容器直接连接到 LVC MOS (SDIO) 输出端。LVC MOS (SDIO) 输出缓冲器不适用于驱动大型容性负载。当 LVC MOS (SDIO) 类型 IO 配置为输出并且电容器连接在输出端时，建议根据处理器特定数据表选择允许的电容器值或添加串联电阻器，以便限制 IO 电流消耗。建议执行仿真以最终确定电容器值。

#### 5.4.11 定制电路板设计期间与处理器和处理器外设设计相关的疑问

在定制电路板设计过程中，可能会出现与处理器和处理器外设相关的问题(有疑问)。建议对有关处理器和处理器外设的疑问发起 E2E 提问，以便器件专家提供支持。建议在 E2E 查询中输入与设计、外设或特定主题等特定章节相关的查询内容，以尽量缩短问题分配和回答延迟。

#### 5.4.12 开始定制电路板设计之前的一般设计建议(需了解)检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 5.4.13 连接器件建议

TI 不会针对定制电路板设计给出连接器件建议。

建议参考处理器特定数据表的 **DDR 电气特性**一节选择 LPDDR4 内存。

与 MMC0 关联的 MMCSD 主机控制器和 PHY 旨在符合处理器特定数据表(和 TRM)中所述的标准。选择 eMMC 时，建议参考处理器特定数据表的“**MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口**”(AM62Px 的 **MMC0 - eMMC**)一节。

定制电路板设计器件，有关 EVM 和 SK 所用关键器件(元件)的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计一入门套件/EVM 型号\(版本\)和关键器件\(元件\)列表](#)

### 6 针对电源、时钟、复位、引导和调试的处理器特定建议

#### 备注

在定制电路板设计(基于所使用的处理器系列)期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南\(定制电路板设计硬件设计注意事项\)](#)

[处理器系列用户指南\(原理图设计指南与原理图审查检查清单\)](#)

#### 6.1 通用(处理器启动)连接

##### 6.1.1 电源

在选择或设计处理器电源架构时，建议考虑以下列出的指南：

- 每个电源导轨的电流(电源)要求因使用的接口和工作环境而异。
- 对于特定用例，处理器电源导轨的电流消耗可以通过功耗估算工具(**PET**)进行估算。
- 如果电源导轨为其他板载连接(外设)器件供电，则考虑这些连接器件的最大电流消耗，以确定电源导轨的尺寸。
- 有关处理器电源导轨的电源尺寸和最大额定电流的信息，请参阅 [AM62x - AM62x 最大额定电流](#)、[AM62Ax - AM62Ax 最大额定电流](#) 和 [AM62Px - 检查处理器\(AM62P/AM62P-Q1\)](#) 产品页面。建议经常查看相关处理器特定产品页面以了解更新文档的可用性。
- 建议验证所选电源架构(包括 PMIC、分立式直流/直流和分立 LDO)的输出额定电流是否满足所选处理器和连接器件的最大额定电流。针对设计或制造差异，建议添加额外的裕度。
- 建议验证电源序列(上电和断电)和电源转换率是否遵循处理器特定数据表。有关建议的电源时序要求，请参阅处理器特定数据表的**电源时序**一节。

有关处理器建议的工作条件(ROC)的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SOC ROC 建议运行条件

以下是选择或设计处理器电源架构时考虑的一些指南：

1. 电源导轨配置为所需的工作电压电平，并且电源输出在处理器 ROC 内。
2. 电源架构遵循处理器特定数据表规定的加电与断电序列。
3. 电源架构符合处理器特定数据表规定的电源导轨的转换率要求。
4. 在释放 MCU\_PORz 输入(置为无效)之前，所有电源都斜升并保持稳定。
5. 处理器电源斜升和 MCU\_PORz 输入高电平之间的延迟遵循处理器特定数据表建议(最小值为 9.5ms)。
6. 建议确保仅在冷复位期间电源电压斜降至 300mV 以下(无残余电压)时使能电源。
7. 所有电源导轨都衰减至 300mV 以下(没有与要求相关的时间或衰减电压容差)，才允许电源导轨在下电上电后斜升。
8. MCU\_PORz 输入转换率最小，以避免内部复位电路干扰(建议通过最小转换率的分立式推挽输出型缓冲器连接 MCU\_PORz 输入)。

有关残余电压和检测的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与残余电压、检测和电源衰减相关的疑问

#### 备注

关于连接电源导轨和名为 RSVD 的处理器信号，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节开头的注释。

#### 6.1.1.1 内核和外设电源

为确保正常运行，建议将所有电源引脚(焊球)连接到处理器特定数据表建议工作条件一节中建议的电源电压。处理器特定数据表的引脚连接要求一节指定了具有列出连接要求的电源引脚。

#### 备注

不支持单独为 MCU 域与 MAIN 域供电。处理器系列不支持(实现)单独的 MCU 与 MAIN 电源域。所有电源引脚(导轨)都需要通电，且建议遵循处理器特定数据表中定义的电源序列。MCU 域与 MAIN 域的概念适用于内部功能与处理器域。

#### 备注

对于 VDD\_CANUART 电源连接，请参阅用户指南的部分 IO(低功耗)模式配置的电源连接一节。

#### 6.1.1.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

建议处理器核心电源 VDD\_CORE 和外设核心电源 VDDA\_CORE\_CSIRX0、VDDA\_CORE\_USB 和 VDDA\_DDR\_PLL0(在 AM62x AMC 和 AM62Ax、AM62D-Q1 AMB、ANF 封装上可用)由同一电源供电，并且可以配置为 0.75V 或 0.85V 工作(根据建议工作条件(ROC)指定的额定工作电压)。当处理器内核和外设内核电源在 0.75V 电压下工作时，建议在 0.85V 电源之前斜升 0.75V 电源。

VDDR\_CORE 的额定工作电压为 0.85V。当 VDD\_CORE 在 0.85V 下运行时，建议将 VDD\_CORE 和 VDDR\_CORE 一起斜升(由同一电源供电)。

建议始终连接 VDDS\_OSC0 和 VDDA MCU 电源。

该处理器系列支持多个模拟电源引脚，这些引脚可为 VDDA MCU、VDDA\_PLLx [对于 AM62x, x=0-2；对于 AM62Ax 和 AM62D-Q1, x=0-4]、VDDA\_1P8\_CSIRX0、VDDA\_1P8\_OLDI0 (AM62x) 和 VDDA\_1P8\_USB 等敏感模拟电路供电。建议使用滤波(铁氧体)电源。

建议将 VDDA\_3P3\_USB 连接到 3.3V 模拟电源，以支持 USB2.0 接口。

更多信息，请参阅处理器特定数据表的建议运行条件部分和电源时序部分。

#### 6.1.1.2 AM62Px 处理器系列

建议使用同一电源为处理器内核电源 VDD\_CORE 与外设内核电源 VDDA\_CORE\_CSI\_DSI、VDDA\_CORE\_DSI\_CLK、VDDA\_CORE\_USB 和 VDDA\_DDR\_PLL0 供电，这些电源可配置为在 0.75V 或 0.85V 电压下工作（根据建议工作条件(ROC)指定的标称工作电压）。当处理器内核和外设内核电源在 0.75V 电压下工作时，建议在 0.85V 电源之前斜升 0.75V 电源。

MMC0、VDD\_MMC0（引脚 1K3，从 SR1.2 重命名为 VDDR\_CORE）和 VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0（引脚 1J1，从 SR1.2 命名为 VDDR\_CORE）的外设内核电源指定在 0.85V 下工作（使用或不使用 MMC0 接口（eMMC）时）。

建议将 VDD\_MMC0 和 VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0（从 SR1.2）连接到与 VDDR\_CORE 相同的电源。进行了电源改动以增强 AM62Px eMMC 接口速度性能。

MMC0 接口的处理器特定数据表的最新版本中有引脚连接要求的更新。建议查看 MMC0 (eMMC) 接口的引脚连接要求，并且 MMC0 电源和信号也遵循相同要求。

如果在当前的定制电路板设计中未使用 MMC0 (eMMC) 接口，VDD\_CORE 配置为 0.75V，每个焊球（VDD\_MMC0 (1K3)、VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0 (1J1)）与 VDD\_CORE 连接到同一电源，建议提供配置来将 VDD\_MMC0、VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0（两个引脚都重命名为 VDDR\_CORE）连接到 0.85V (VDDR\_CORE)，使设计兼容使用来自 SR1.2 的处理器器件修订版本。

VDDR\_CORE 的额定工作电压为 0.85V。当 VDD\_CORE 在 0.85V 下运行时，建议将 VDD\_CORE 和 VDDR\_CORE 一起斜升（由同一电源供电）。

建议始终连接 VDDS\_OSC0 和 VDDA MCU 电源。

该处理器系列支持多个模拟电源引脚，这些引脚可为 VDDA MCU、VDDA\_PLLx [x = 0-4]、VDDA\_1P8\_CSI\_DSI 和 VDDA\_1P8\_OLDIO 等敏感模拟电路供电。建议使用滤波（铁氧体）电源。

建议将 VDDA\_1P8\_USB（滤波）和 VDDA\_3P3\_USB 连接到 3.3V 模拟电源，以支持 USB2.0 接口。

---

#### 备注

已在以下数据表中对 VDD\_MMC0、VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0（两个引脚都重命名为 VDDR\_CORE）进行了以下更新：

---

#### SPRSP89B - 2023 年 12 月 - 2025 年 8 月修订 ( AM62Px Sitara 处理器数据表 ( 修订版 B ) )

---

更多信息，请参阅处理器特定数据表的建议运行条件部分和电源时序部分。

有关 eMMC 存储器接口 HS400 支持的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 支持 HS400 的电源连接和电路板布局建议

#### 6.1.1.3 电源斜升（压摆率）要求和动态电压调节

对于所有处理器电源，建议允许受控的电源斜升（遵循电源转换要求）。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 电源转换率要求 部分。

该处理器（系列）不支持处理器内核、外设内核和外设模拟电源的动态电压调节（更改）。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — SOC 内核(VDD\_CORE)、外设内核和模拟电源的动态电压调节

#### 6.1.1.4 其他信息

有关处理器电源时序要求的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 — 上电和下电的处理器电源时序要求

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

有关使用铁氧体进行处理器电源导轨滤波的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — 针对 SoC 电源轨的铁氧体 ( 电源滤波器 ) 建议

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

#### 6.1.1.5 处理器内核和外设内核电源检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.1.6 外设模拟电源检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.1.2 IO 组的 IO 电源

以下常见问题解答包括有关 CAP\_VDDSn 电容器值的建议以及电容器组装 ( 安装或短路 ) 的影响：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 CAP\_VDDSx CAP\_VDDs 相关的问题

#### 备注

对于 VDDSHV\_CANUART 电源连接，请参阅用户指南的部分 *IO ( 低功耗 ) 模式配置的电源连接*一节。

#### 6.1.1.2.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

该处理器系列支持 9 ( 九个 ) IO 组的双电压 IO 电源 (VDDSHVx [x = 0-6])、IO 组 CANUART (VDDSHV\_CANUART) 的 IO 电源和 IO 组 MCU (VDDSHV\_MCU) 的 IO 电源。每个 IO 组的 IO 电源均连接 ( 对应 ) 至一组固定的 IO。IO 组的每组 IO 电源均可独立连接至固定的 ( VDDSHV4、VDDSHV5、VDDSHV6 支持动态电源切换 ) 3.3V 或 1.8V 电源。IO 组的 IO 电源定义了整组 ( 一组固定 ) IO 的通用工作电压。

指定为 CAP\_VDDSn [n = 0-6]、CAP\_VDDs\_CANUART 和 CAP\_VDDs MCU 的处理器焊盘 ( 引脚 ) 在 IO 组的 IO 电源连接到 3.3V 电源时，将外部电容器连接到内部 IO 组的 IO 电源稳压器 ( 当 IO 组电源的 IO 电源连接到 1.8V 时为可选 )。建议在引脚和 VSS 之间连接一个  $1\ \mu F$  的电容器 ( 详见处理器特定的数据表 )。有关建议的电容器额定电压和允许的电容范围，请参阅处理器特定数据表。当 IO 组的 IO 电源连接到 3.3V 时，稳定状态直流输出 VDDSHVx/2 是在考虑直流偏置效应的情况下选择电容器额定电压时要考虑的电压。

为了最小化 PCB 环路电感，请将电容器放置在 BGA 阵列 PCB 背面。电容器额定电压的选择会影响电容器封装 ( 尺寸 ) 的选择。

建议选择  $ESR < 1\ \Omega$  的电容器，将布线环路电感保持在  $< 2.5nH$ 。

#### 6.1.1.2.2 AM62Px 处理器系列

该处理器系列支持 8 ( 八 ) 个 IO 组的双电压 IO 电源 (VDDSHVx [x = 0-3, 5-6])、IO 组 CANUART (VDDSHV\_CANUART) 的 IO 电源和 IO 组 MCU (VDDSHV\_MCU) 的 IO 电源。每个 IO 组的 IO 电源均连接 ( 对应 ) 至一组固定的 IO。IO 组的每个 IO 电源均可独立连接到固定的 ( VDDSHV5、VDDSHV6 支持动态电源切换 ) 3.3V 或 1.8V 电源。IO 组的 IO 电源定义了整组 ( 一组固定 ) IO 的通用工作电压。

指定为 CAP\_VDDSn [n = 0-3, 5-6]、CAP\_VDDCANUART 和 CAP\_VDDMCU 的处理器焊盘（引脚）在 IO 组的 IO 电源连接到 3.3V 电源时，将外部电容器连接到内部 IO 组的 IO 电源稳压器（当 IO 组电源的 IO 电源连接到 1.8V 时为可选）。建议在引脚和 VSS 之间连接一个  $1\ \mu F$  的电容器（详见处理器特定的数据表）。有关建议的电容器额定电压和允许的电容范围，请参阅处理器特定数据表。当 IO 组的 IO 电源连接到 3.3V 时，稳定状态直流输出 VDDSHVx/2 是在考虑直流偏置效应的情况下选择电容器额定电压时要考虑的电压。

为了最小化 PCB 环路电感，请将电容器放置在 BGA 阵列 PCB 背面。电容器额定电压的选择会影响电容器封装（尺寸）的选择。

建议选择  $ESR < 1\ \Omega$  的电容器，将布线环路电感保持在  $< 2.5\text{nH}$ 。

#### 6.1.1.2.3 其他信息

很多处理器 IO 都没有失效防护功能。有关可用失效防护 IO 的信息，请参阅处理器特定数据表。建议将所连接器件的 IO 电源连接至接入 IO 组相应处理器双电压 IO 电源 (VDDSHVx) 的同一电源，以确保定制电路板设计不会向未供电的任何处理器 IO 施加电位。若在 IO 组的 IO 电源不可用时向没有失效防护功能的 IO 施加外部输入，可能会影响处理器功能、性能和可靠性。

有关处理器和连接器件之间的电源时序的更多要求，包括用于失效防护操作的信号隔离的信息，请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 – SOC \( 处理器 \) 和附加器件 \( 失效防护 \) 之间的电源时序](#)

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

---

#### 备注

建议确保在将输入施加到相关处理器 IO 或外设之前，VDDSHVx 存在有效的电源电压。

建议无论处理器 IO 或外设如何使用，都连接 VDDSHVx 电源和相关的 CAP\_VDDSn ( 连接的 IO 电源为 3.3V 时，可选 1.8V ) 电容器。

---

#### 6.1.1.2.4 IO 组的 IO 电源检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.1.3 VPP 电源 ( 电子保险丝 ROM 编程 )

建议使用用于对处理器电子保险丝进行编程的 VPP ( 电子保险丝 ROM 编程 ) 电源由单独的 LDO 提供 ( 供电 ) 电源，该 LDO 可支持所需的 ( 请参阅处理器特定数据表 ) 负载电流、负载电流瞬态和有源 ( 快速 ) 输出放电。建议仅在电子保险丝编程期间使能 LDO。在电子保险丝编程期间，VPP 工作电压必须在 ROC 范围内。建议采用通过更高输入电压 ( 2.5V 或 3.3V ) 供电的 LDO，通过串联导通晶体管补偿压降，并且在高负载电流瞬态期间保持正确的工作电压。建议在处理器 VPP 引脚附近使用本地大容量电容器来支持 LDO 瞬态响应。

由于高负载电流瞬变以及 VPP 电源导轨要在处理器电压范围 ROC 内的要求，使用负载开关或基于 FET 的开关从偏离 ROC 变化为  $\pm 5\%$  的电源导轨为 VPP 电源导轨供电可能会出现问题。负载开关或基于 FET 的开关拓扑未考虑通过负载开关的压降。如果定制电路板设计人员使用变化较小 ( 相比 ROC ) 的电源，则可以选择负载开关，以便确保电源变化加上通过负载开关的压降不会超过 VPP 的建议工作范围。另一种方法是，可使用外部电源对电子保险丝进行编程。电源要求与板载 LDO 类似，建议使用其中一个处理器 IO 对外部电源 EN ( 使能 ) 计时。使用外部 VPP 电源时，建议在处理器板上靠近 VPP 电源引脚的位置配置大容量电容器和去耦电容器。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：定制电路板硬件设计 – 有关 VPP eFuse 编程电源选择和应用的问题](#)

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

### 6.1.1.3.1 VPP 电源检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 6.1.1.4 部分 IO ( 低功耗 ) 模式配置的电源连接

#### 6.1.1.4.1 部分 IO 模式功能

当处理器上电时（首次上电、冷复位），与部分 IO 功能相关的处理器电路部分被禁用。禁用部分 IO 电路后，MCU\_PORz 输入信号会传播到实现部分 IO 功能的电路。在软件使能部分 IO 功能（电路）并将处理器配置为监测唤醒输入后，MCU\_PORz 输入信号会被阻断，无法传入实现部分 IO 功能的电路。这一机制很有必要，因为当信号启动与其他处理器电源导轨相关的断电序列时，PMIC 会将 MCU\_PORz 输入信号置为有效。

#### 6.1.1.4.2 使用时的部分 IO 低功耗模式

建议将 VDD\_CANUART 和 VDDSHV\_CANUART 连接到常开电源，以支持部分 IO 低功耗模式。

VDD\_CANUART 可在 0.75V 或 0.85V 电压下工作，正常运行期间与 VDD\_CORE 没有电压相关性。只有在加电和断电排序期间才存在电压相关性。

有关部分 IO 低功耗模式实现，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A/AM62D-Q1/AM62P 定制电路板硬件设计 - 部分 IO LPM 支持](#)

#### 6.1.1.4.3 不使用时的部分 IO 低功耗模式

建议将 VDD\_CANUART 与 VDD\_CORE 连接到同一电源，同时将 VDDSHV\_CANUART 连接到任意有效的 IO 电源。

#### 6.1.1.4.4 电源时序的处理器特定数据表参考

建议参考特定处理器数据手册的加电排序、掉电排序和部分 IO 低功耗模式电源时序几节中与部分 IO 低功耗模式相关的注释。

#### 6.1.1.4.5 部分 IO ( 低功耗 ) 模式检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 6.1.1.5 其他信息

对于初始电路板构建，建议放置与内核电源及其他电源导轨一致的  $0\Omega$  电阻（分流器）或跳线。在电路板启动和调试期间隔离电源或测量电流，可使用  $0\Omega$  电阻器（分流器）或跳线。建议添加 TP 进行测量。建议遵循开尔文电流检测连接，将 TP 连接到电阻器或跳线。

通过开尔文检测连接来连接到 INA（仪表放大器）的分流电阻器用于测量 SK 中的电源轨电流。

建议验证添加  $0\Omega$  电阻器（分流）配置对定制电路板性能的影响（测量时使用以毫欧 ( $m\Omega$ ) 为单位的分流器（电阻器）值的压降）。

### 6.1.2 电源轨的电容器

#### 6.1.2.1 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列

建议确保已为包括双电压 IO 组电源导轨 IO 电源在内的所有电源导轨提供了所需数量的去耦电容器和大容量电容器（包括值）。

建议将去耦电容器靠近处理器电源引脚放置。较大的大容量电容器可以放置在更远的位置。

建议使用低 ESL 电容器，并建议在连接电容器时尽可能缩短布线以将安装环路电感保持最低。更多信息，请参阅[Sitara 处理器配电网络：实现与分析](#)应用手册。

作为起点，建议遵循大容量电容器和去耦电容器的 SK 原理图实现。建议执行仿真（PDN 分析）以优化电容器的使用。要实现滤波（铁氧体）电源，请遵循处理器特定 SK。另外，遵循[Sitara 处理器配电网络：实现与分析](#)应用手册。

建议使用馈通（3端子）电容器（在SK-AM62-L、SK-AM62A-LP、AUDIO-AM62D-EVM和SK-AM62P-LP上使用）来优化所用电容器的数量。使用3端子电容器可更大限度地减少环路电感，并可用于优化处理器性能（主要是DDR性能）。

### 6.1.2.2 其他信息

#### 6.1.2.2.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

当不使用任何处理器外设实例（CSI-2[摄像头串行接口2、(CSIRX0)、DDR子系统(DDRSS0)和USB2.0(USB0和USB1)]时，与这些外设相关的电源（外设内核、模拟）有特定的连接要求。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。电源滤波器（铁氧体）和电容器（大容量）可选。

#### 6.1.2.2.2 AM62Px 处理器系列

当不使用任何处理器外设实例CSI-2（摄像头串行接口2，CSIRX0）和DSI（DSITX0显示串行接口）、DDR子系统(DDRSS0)和USB2.0(USB0和USB1)时，与这些外设相关的电源（内核、模拟）有特定的连接要求。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。电源滤波器（铁氧体）和电容器（大容量）可选。

### 6.1.2.3 电源轨电容器检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 6.1.3 处理器时钟（输入/输出）

#### 6.1.3.1 时钟输入

##### 6.1.3.1.1 MCU\_OSC0（高频率）时钟（内部振荡器）或LVC MOS 数字时钟（外部振荡器）

处理器需要MCU\_OSC0 25MHz（强制）基准时钟才能工作。该时钟在内部用于生成处理器工作所需的多个时钟。其他时钟输入取决于特定的终端设备或实现的电路板功能。支持的时钟选项包括外部晶体+内部振荡器或外部1.8V LVC MOS 方波数字时钟源。展频时钟（时钟输入）不是受支持的时钟选项。

如果连接到内部高频率振荡器(MCU\_HFOSC0)的25MHz外部晶体是用于内部处理器工作的时钟源，建议将用于实现振荡器电路的分立式负载电容器放置在靠近MCU\_OSC0\_XI和MCU\_OSC0\_XO引脚的位置。当实现基于晶体的振荡器时，建议在选择负载电容器时，遵循处理器特定数据表的MCU\_OSC0晶体电路要求表。负载电容器电容值包括PCB电容。有关晶体和负载电容器的放置和布线，建议参阅处理器特定数据表的时钟布线指南、振荡器布线一节。时钟布线指南、振荡器布线将添加到下一版AM62x处理器特定数据表中。

1.8V LVC MOS时钟源可用作处理器时钟源。当外部振荡器的时钟输出（通过串联电阻器）连接到XI输入时，建议根据处理器特定数据表中的建议将XO接地。（处理器特定数据表中的图1.8V LVC MOS兼容时钟输入）中所示的逆变器旨在表示LVC MOS输出，其中LVC MOS输出可以是振荡器输出缓冲器或某些时钟分配器件的LVC MOS输出。无需对时钟源进行反相。MCU\_OSC0 LVC MOS数字时钟源要求将添加到下一版AM62x处理器特定数据表中。

有关LVC MOS时钟源的更多信息，包括规范，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计-有关MCU\_OSC0 (WKUP\_OSC) 或 WKUP\_LFOSC0 (LFOSC0) 的LVC MOS数字时钟源的疑问

在XI和XO信号路径上都实现了内部AC耦合电容器，这些路径连接到形成方波的内部比较器。XI引脚上相对于XO引脚的直流稳态条件允许比较器在器件的内部时钟树上产生干扰，从而导致时钟电路执行不可预测的操作。不建议也不允许将DC引脚连接到XI。

有关时钟选择和时钟规范的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计 - 有关晶体选型和时钟规格的问题

有关晶体(MCU\_OSC0)启动时间的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — 有关晶体 (MCU\_OSC0) 启动时间的问题

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

#### 备注

25MHz 是当前唯一支持的晶体频率。有关支持的晶体频率和建议晶体参数的信息，请参阅处理器特定数据表。

处理器特定数据表中包含 25MHz 晶体选型规范。当前数据表未定义 *MCU\_OSC0 LVC MOS 数字时钟源要求*。这些要求可添加到下一版数据表中。目前请参阅 AM62D-Q1 或 AM62Px 数据表的 *MCU\_OSC0 LVC MOS 数字时钟源部分*。AM62x 的要求与之相同。

使用外部时钟 (LVC MOS) 振荡器作为处理器和 EPHY ( EPHy、EPHY ) 的时钟源时，可以使用单个振荡器，也可以使用单独 (个别) 振荡器。如果使用单个振荡器，建议在连接到处理器和 EPHY 之前对时钟输出进行缓冲。

处理器和 EPHY 的单输出缓冲器 (个别 IC) 或具有处理器和 EPHY 的单输入的双路或多路输出缓冲器 (单个 IC) 可用于将振荡器的时钟输出连接到处理器和 EPHY。

对于特定用例 (使用时间敏感网络 (TSN) 的某些工业应用的要求)，建议将具有单输入的两个或更多输出 (根据所使用的 EPHY 数量) 缓冲器用于处理器和 EPHY。

#### 6.1.3.1.2 WKUP\_LFOSC0 (低频率) 时钟 (内部振荡器) 或 LVC MOS 数字时钟 (外部振荡器)

该处理器系列支持低频率 (32.768kHz) WKUP\_LFOSC0。根据用例，32.768kHz 外部晶体 + 内部振荡器可用作时钟源，也可以使用外部 1.8V LVC MOS 方波数字时钟源。

WKUP\_LFOSC0 的用例有限，可以选择。如果未使用 WKUP\_LFOSC0，建议将 WKUP\_LFOSC0\_XI 直接连接到 VSS，并使 WKUP\_LFOSC0\_XO 保持未连接状态。有关连接未使用的 WKUP\_LFOSC0 的有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的未使用 *WKUP\_LFOSC0* 一节。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP : LFOSC 在处理器中的使用

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计-有关 MCU\_OSC0 (WKUP\_OSC) 或 WKUP\_LFOSC0 (LFOSC0) 的 LVC MOS 数字时钟源的疑问

建议将用于实现外部晶体振荡器的分立式元件靠近 WKUP\_LFOSC0\_XI 和 WKUP\_LFOSC0\_XO 引脚放置。对于晶振，建议所选的负载电容处于处理器特定数据表的 *WKUP\_LFOSC0* 晶振电气特性表中指定的范围内。无需将 PCB 电容与负载电容相加。

处理器特定数据表中标记为 *WKUP\_LFOSC0* 晶体实现的图显示了建议的晶体电路。建议量产印刷电路板 (PCB) 设计包含两个可选电阻器 Rbias 和 Rd，因为在与量产晶体电路元件结合使用时，需要使用这些电阻器来确保振荡器正常运行。在许多用例中，DNI 或删除 Rbias 以及 Rd 是  $0\Omega$  电阻器。在使用安装在量产 PCB 上的量产晶体电路元件评估振荡器性能后，可以从量产 PCB 设计中移除这些电阻器选项。

#### 6.1.3.1.3 EXT\_REFCLK1 (MAIN 域的外部时钟输入)

EXT\_REFCLK1 输入通过布线连接至时钟多路复用器，作为计时器模块 (DMTIMER/WDT)、安全子系统中的 DMTIMER (SMS)、MCAN 和 CPTS ( 时间戳模块 ) 的可选时钟源。*EXT\_REFCLK1* 适用于终端设备/应用需要将特定时钟频率馈送到计时器模块的情况。一个示例应用是时间同步。当 *EXT\_REFCLK1* 用作时钟源时，根据外部时钟的可用性，建议在处理器时钟输入引脚附近连接一个下拉电阻器 ( $10k\Omega$ )。

#### 6.1.3.1.4 时钟输入检查清单 - **MCU\_OSC0**

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.3.1.5 时钟输入检查清单 - **WKUP\_LFOSC0**

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.3.2 时钟输出

名为 CLKOUT0 和 WKUP\_CLKOUT0 的处理器 IO ( 引脚 ) 可配置为时钟输出。时钟输出可以用作所连接器件 ( 外部外设 - 例如 : EPHY ) 的时钟源。

WKUP\_CLKOUT0 是高频率振荡器 (HFOSC0) 的缓冲输出，在复位后可用于 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP、AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器。

对于 AM62P、AM62P-Q1 处理器，WKUP\_CLKOUT0 在复位后会被驱动为低电平。

建议将时钟作为点对点连接进行连接。当 CLKOUT0 和 WKUP\_CLKOUT0 用于为多个附加器件供电时，建议对其进行缓冲。

处理器特定数据表中未定义 CLKOUT0 和 WKUP\_CLKOUT0 时钟输出性能，因为有许多可能会影响时钟性能的电路板或终端设备特定依赖项。建议检查实际电路板的性能 ( 时钟输出满足电路板或终端设备特定要求 ) 。

#### 6.1.3.2.1 时钟输出检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.4 处理器复位

处理器复位模块包括冷、热复位输入和冷、热复位状态输出。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x \( ALV、ALX \) 设计建议/定制电路板硬件设计 - 处理器复位输入、复位状态输出和连接建议](#)

#### 6.1.4.1 外部复位输入

该处理器系列支持三个外部复位输入 ( 引脚 )，包括 MCU 和 MAIN 域冷复位输入 (MCU\_PORz)、MCU 和 MAIN 域热复位请求输入 (MCU\_RESETz) 和 MAIN 域热复位请求输入 (RESET\_REQz)。

MCU\_PORz 是外部 MCU 域和 MAIN 域冷复位输入。建议在电源斜升和晶体/振荡器启动和时钟稳定期间将 MCU\_PORz 输入保持在低电平。请遵循处理器特定数据表的加电时序图中建议的 MCU\_PORz 输入时序。

MCU\_PORz 输入可耐受 3.3V 电压且是失效防护输入类型 IO。尽管可以施加 3.3V 输入，但输入阈值遵循 1.8V IO 电平并以 VDDS\_OSC0 为基准。

使用基于 PMIC 的电源架构时，建议通过推挽输出型逻辑门或分立式缓冲器 ( 具有快速上升时间 ) 将 PMIC 的开漏输出型复位信号 (nRSTOUT0) 连接到处理器作为 MCU\_PORz 输入 ( 而不是连接可能干扰内部复位电路的缓慢上升开漏输出 )。如果直接使用 nRSTOUT0，建议调整上拉电阻器以尽可能缩短转换时间 (< 100ns)。

建议提供配置在 MCU\_PORz 输入端连接 22pF 干扰滤波器。建议始终将有效输入连接到 MCU\_PORz。不允许不将有效输入连接到 MCU\_PORz 输入的情况。如果未连接 MCU\_PORz 输入，则处理器在加电期间不会完成复位序列，并可能导致不可预测或随机行为。在处理器内部电路没有进行有效复位时，内部电路可能处于随机 ( ) 状态。

建议提供配置以在 MCU\_PORz 输入端连接滤波 ( 干扰 ) 电容器。电容器值和安装电容器取决于用例。建议选择的电容器值应确保所使用的电容器不会导致 LVCMS 输入违反转换率要求或在内部导致复位出现干扰。

外部热复位输入 MCU\_RESETz 和 RESET\_REQz 可用于执行外部热复位。可以实现外部按钮或复位电路来执行处理器的热复位。一些寄存器在热复位期间保持该状态 ( 例如，引导模式输入捕获寄存器 Devstat )。有关复位和功能的信息，请参阅处理器特定 TRM。

如需连接热复位输入，请按照处理器特定数据表中引脚连接要求一节的说明操作。

冷复位输入 (LVCMS IO) 指定了转换率要求。不允许或不建议将慢速斜升输入连接到 MCU\_PORz 复位输入。慢速斜升复位输入会导致内部复位电路出现干扰。建议使用快速上升时间分立式推挽输出型缓冲器输出作为 MCU\_PORz 输入。

热复位输入 (LVCMS IO) 指定了输入转换率要求。不建议直接在输入端连接电容器 (慢速斜升)。建议使用基于施密特触发的去抖逻辑 (电路)。有关实现去抖逻辑的信息，请遵循处理器特定 SK 原理图。连接按钮以控制 RESET\_REQz 或 MCU\_RESETz 热复位输入时，建议添加外部 ESD 保护配置。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP : MCU\_PORz 输入压摆率

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计 - 处理器复位输入、复位状态输出和连接建议

#### MCU\_RESETz 复位输入和 MCU\_RESETSTATz 复位状态输出使用说明

MCU\_RESETz 输入和 MCU\_RESETSTATz 有特定的用例建议。请参阅公告文章 *i2407-RESET*。如果处理器特定勘误表的 **MCU\_RESETz** 被置位为低电平，**MCU\_RESETSTATz** 不可靠。

##### 6.1.4.2 复位状态输出

处理器系列支持 3 (三) 个复位状态输出 (引脚)，包括主域 POR (冷复位) 状态 (PORz\_OUT) 输出、MCU 域热复位状态 (MCU\_RESETSTATz) 输出和主域热复位状态 (RESETSTATz) 输出。

当复位状态输出 PORz\_OUT、MCU\_RESETSTATz 以及 RESETSTATz 用于驱动所连接器件的复位输入 (/reset) 时，建议为处理器复位状态输出采用下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ )，以便在加电与处理器复位期间将所连接器件复位置为有效 (保持所连接器件处于复位状态)。

---

##### 备注

在所连接器件均不具有内部上拉电阻器的使用情况下，连接在复位状态输出的输出端的外部下拉电阻器将所连接器复位输入保持在低电平。如果任何所连接器件使能了内部上拉电阻器，则复位信号会被拉至  $1/2 \text{Vs}$ 。建议在连接复位状态输出之前验证具体用例。

MAIN 域热复位状态输出 RESETSTATz 可用于复位支持外部复位输入功能 (eMMC、OSPI 或 EPHY) 或 SD 卡电源开关 EN 的板载内存或外设。PORz\_OUT 可用于在复位期间锁存硬件搭接配置 (示例：锁存以太网 PHY 搭接配置或引导模式配置)。

如果不使用复位状态输出，建议将复位状态输出连接到测试点以进行测试或未来增强。可选择提供一个下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ )，并且在使用时可以安装。

---

##### 备注

MCU\_RESETz 输入和 MCU\_RESETSTATz 有特定的用例建议。请参阅公告文章 *i2407-RESET*。如果处理器特定勘误表的 **MCU\_RESETz** 被置位为低电平，**MCU\_RESETSTATz** 不可靠。

##### 6.1.4.3 其他信息

用于配置处理器引导模式的 BOOTMODE[15:00] 输入建议保持在已知状态，以便选择处理器特定 TRM 中定义的合适引导模式配置，直至在 PORz\_OUT 的上升沿期间锁存引导模式配置。

##### 6.1.4.4 处理器复位输入检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.4.5 处理器复位状态输出检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 6.1.5 引导模式的配置（针对处理器）

该处理器系列支持 16 个引导模式输入引脚，定制电路板设计人员可配置这些引脚，以从所需（设计的）内存接口或外设引导。

有关支持的引导模式配置，请参阅以下常见问题解答：

**[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L — 支持的引导模式配置**

在冷复位期间，不为处理器引导模式输入使能内部拉电阻器（上拉或下拉电阻器）。建议连接外部拉电阻器（ $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ）（上拉或下拉电阻器）以配置所需的引导模式。建议不要将任何引导模式输入（包括保留的引脚）保持未连接状态。

在使用 DIP 开关来配置所需引导模式的用例中，建议使用  $1\text{k}\Omega$ （上拉电阻器）和  $47\text{k}\Omega$ （下拉电阻器）的电阻分压器值来提高噪声性能。

当仅使用电阻器（不使用 DIP 开关）配置引导模式时，可以使用标准电阻器（上拉和下拉电阻器可使用相同的值）值。例如，可以使用  $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ，因为安装了上拉或下拉电阻器。建议提供配置，以将上拉或下拉电阻器连接到所有引导模式引脚，包括标记为保留或未使用的引脚。

对于 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列，当前 BOOTMODE14 和 BOOTMODE15 引脚为保留引脚。

保留了 BOOTMODE14 和 BOOTMODE15 引脚。（可选）当  $\text{BOOTMODE15} = 1$  且  $\text{DS\_DM\_RESET\_MASK} = 0$  时，可以配置 AM62P、AM62P-Q1 系列处理器，以实现 POST（硬件上电自检）功能。

建议为具有测试/调试配置功能的引导模式输入（引脚）添加上拉和下拉电阻器配置（包括 USB0 DFU、UART0 引导模式配置的配置），增加设计灵活性和未来增强功能。建议为每个引导模式引脚安装上拉或下拉电阻器。不建议也不允许将引导模式引脚直接接地或连接到 IO 电源导轨，因为 IO 具有在引导后可以配置的备用功能，可能被软件有意或无意地配置为输出。

引导模式输入（引脚）不具有失效防护功能。建议在处理器 IO 电源斜升之前，不要施加任何外部输入。当使用上拉/下拉电阻器而不使用引导模式缓冲器连接引导模式时，建议连接到与处理器 IO 基于的 IO 组的 IO 电源连接的 IO 电源。当使用引导模式缓冲器时，建议连接将处理器 IO 连接到缓冲器的 B 端口电源引脚（处理器侧）的 IO 电源。当连接来自载板的外部输入以配置引导模式输入时，建议在处理器电源斜升后驱动输入，并输入需要在 MCU\_PORz 输入被拉至高电平之前稳定。

根据应用要求，仅当复位状态输出（PORz\_OUT 或可选 RESETSTATz 为低电平）时驱动的缓冲器可用于驱动处理器的引导配置输入。

建议在缓冲器的输出端使用串联电阻器（ $1\text{k}\Omega$ ）（以便限制输出电流，防止在缓冲器 OE 置为无效之前将引导模式引脚配置为输出）。如需实现的更多信息，请参阅处理器特定 SK。

#### 6.1.5.1 处理器引导模式输入隔离缓冲器用例和优化

在 SK 中，引导模式输入 BOOTMODE[15:0] 通过 2 个缓冲器（用于隔离）缓进行配置。当（在 PORz\_OUT 上升沿期间）锁存引导模式输入时，缓冲器可确保 SYSBOOT 拉电阻器（上拉电阻器和/或下拉电阻器）（引导模式配置电阻器）控制信号 IO 电平。引导模式配置电阻器与连接的其他外设隔离（因为引导模式输入引脚具有备用功能），以便其他连接的外设不会与预期的引导模式配置（IO 电平）相冲突。

仅当 PORz\_OUT 为低电平时，才会使能缓冲器。PORz\_OUT 被置为无效（变为高电平）后，缓冲器输出将处于 Hi-Z 状态。

为了优化定制电路板设计（包括 BOM），可以优化或删除引导模式缓冲器（具体取决于用例，定制电路板设计人员进行验证）。建议选择拉电阻器值，使这些电阻器不会影响所连接器件的运行。

#### 6.1.5.2 启动模式配置

如需配置所需处理器引导模式，请参阅处理器特定 TRM 的 初始化一章中的 ROM 代码引导模式表。

### 6.1.5.2.1 USB 引导模式注意事项

USB0 接口支持 DFU ( 器件固件升级 ) 引导。当 USB0 配置为 DFU 引导时，建议不要将固定 3.3V 电源 ( 直接或使用分压器 ) 连接到 USB0\_VBUS 输入。不允许连接等效于 USB0\_VBUS 分压器输入的固定电源。在没有 **USB VBUS 检测分压器/钳位电路** 的情况下连接电源违反失效防护操作。

根据处理器特定数据表中的建议，建议通过 USB 接口连接器连接的主机的 5V 电源 ( 开关式 ) 通过电阻分压器连接到 USB0\_VBUS 输入。如果定制电路板设计中的 VBUS 电势不会 > 5.5V，且连接了板载电源，则可删除齐纳二极管，将两个电阻器 ( 16.5k $\Omega$  和 3.48k $\Omega$  ) 合并为一个 20k $\Omega$  电阻器，用于 **USB VBUS 检测分压器/钳位电路**。

### 6.1.5.3 引导模式实现方法

有关实现引导模式的信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L — 使用隔离缓冲器的引导模式实现

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM64x/AM243x/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L — 无隔离缓冲器的引导模式实现

### 6.1.5.4 其他信息

连接外部输入以配置引导模式输入时，建议在释放处理器 MCU\_PORz ( 冷复位 ) ( L->H ) 之前使引导模式配置输入保持稳定。

使用以太网引导和简化千兆位媒体独立接口 (RGMII) 时，建议使用一个 EPHY，在 EPHY RDx 数据路径上支持 RGMII\_ID，并在 TDx 数据路径上禁用 RGMII\_ID ( 处理器在 TDx 输出上实现固定 RGMII\_ID )。处理器 ROM 不会在连接的 EPHY 上启用或禁用 RGMII\_ID 模式。EPHY 的 RGMII\_ID 是通过引脚绑定设置的。

建议选择一个能够通过引脚绑定设置 RGMII\_ID 的 EPHY。参照处理器特定 SK 使用 TI EPHY 进行实现。有关更多信息，请参阅器件特定勘误表的公告文章 *i2329 MDIO : AM62x 处理器系列器件勘误表的 MDIO 接口损坏 (CPSW 和 PRU-ICSS)*。

### 6.1.5.5 引导模式的配置 ( 针对处理器 ) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 6.2 使用 JTAG 和 EMU 进行定制电路板调试

### 6.2.1 使用时的 JTAG 接口和 EMU 信号

实现 JTAG 接口时，建议使用 TI 建议、定义和支持的 20 引脚连接器 ( 而不是 10 引脚 ARM 连接器 )。10 引脚 JTAG 连接器不包含 TRSTn 信号或 EMU0、EMU1 信号。建议根据处理器特定数据表的 [引脚连接要求](#)一节的说明连接 JTAG ( TDI、TCK、TMS 和 TRSTn ) 和 EMU ( EMU0 和 EMU1 ) 信号。建议将上拉和下拉电阻器 (10k $\Omega$  ) 放置在处理器 JTAG 接口引脚附近。

建议为所有 JTAG 接口以及靠近外部接口连接器的 EMU0 和 EMU1 信号添加外部 ESD 保护。EMU0 和 EMU1 信号支持冷复位 ( MCU\_PORz 输入高电平 ) 后的引导序列和调试。TDO 的上拉电阻器为可选项，取决于所选择的调试程序。或者，建议在 TDO ( 靠近处理器 ) 信号上连接串联电阻 (0 $\Omega$  )，以匹配 JTAG 工具缓冲器阻抗。

有关更多信息，请参阅处理器特定 TRM 的 [片上调试](#)一章。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/ AM64x/ AM243x (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 — JTAG

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 — JTAG 下拉/上拉电阻器

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

### 6.2.2 不使用时的 JTAG 接口和 EMU 信号

如需在不使用 JTAG 接口时连接 JTAG 接口信号和 EMU 信号，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

在定制电路板设计期间，为支持调试早期原型，建议配置一个连接到测试点的最小 JTAG 接口信号（包括 EMU0、EMU1）或配置一个接头封装。JTAG 接口相关元件在电路板的量产版本中可以是 DNI 状态。建议根据引脚连接要求一节提供配置来安装建议的拉电阻器，并在 JTAG 连接器或 TP 附近提供外部 ESD 保护配置。

### 6.2.3 其他信息

当 JTAG 接口连接到不止一个所连接器件时，建议对时钟和 JTAG 接口信号进行缓冲。即使对于单个器件的实现，也建议进行时钟缓冲。有关实现的信息，请参阅处理器特定 SK。

使用跟踪接口时，建议将 TRC\_DATA<sub>n</sub> 信号连接到仿真连接器。所有 TRC\_DATA<sub>n</sub> 信号都与其他信号进行引脚多路复用。建议使用跟踪功能或 GPMC 接口。TRC\_DATA<sub>n</sub> 信号的短连接和偏差匹配连接（电路板引线）用于跟踪功能。跟踪信号基于 VDDSHV3（供电），并且可能具有与其他 JTAG 信号不同的电源电压。更多有关 TRC/EMU 设计和布局的建议，请参阅 [仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。[XDS 目标连接指南](#) 中提供了摘要。

如果使用边界扫描，建议将 EMU0 和 EMU1 引脚连接到 JTAG 连接器。

有关 JTAG 接口的实现，请参阅 [仿真和跟踪接头技术参考手册](#)。

### 6.2.4 使用 JTAG 和 EMU 检查清单进行定制电路板调试

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 7 处理器外设的电源、接口和连接

### 备注

在定制电路板设计（基于所使用的处理器系列）期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）](#)

[处理器系列用户指南（原理图设计指南与原理图审查检查清单）](#)

### 备注

除非行业标准中定义了拉电阻器要求，否则对于外部拉电阻器没有明确的规则或要求。拉电阻器的行业通用定义是我们可以针对 eMMC 和 SD 卡信号上的外部拉电阻器给出确定建议的主要原因。对于其他外设，建议客户评估连接到定制电路板上每个处理器信号的所连接器件的功能，并运用适当的技术/工程判断来确定是否需要使用外部拉电阻器，以防止在打开所连接器件输入缓冲器时任何输入悬空。设计指南中提供的建议是通用的，客户应在实现之前查看设计要求和所连接器件内部拉电阻器的可用性。确保不提供与内部拉电阻器争用的外部拉电阻器。示例：例如，添加一个与内部拉电阻器（所连接器件内部）争用的外部拉电阻器，这样争用会在信号（输入）上产生  $1/2 V_{DD}$  电势。

## 7.1 支持的处理器内核和 MCU 内核

有关支持的处理器内核，建议参阅处理器特定数据表的特性一节。在选择 Arm Cortex-A53 微处理器子系统内核时，可以参阅处理器特定数据表的器件比较一节。

处理器特定数据表的工作性能点 OPP 一节可作为所需器件等级和器件工作性能点定义的参考。

有关更多详细信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px](#) 设计建议/定制电路板硬件设计—处理器内核、PLL、VDD\_CORE、VDDR\_CORE、VPP 和其他内核电源的信息

## 7.2 IO 组的 IO 电源的电源连接

### 7.2.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 IO 电源

处理器系列支持 IO 组的 IO 电源 VDDSHV $x$  [ $x = 0-6$ ]、VDDSHV\_MCU 和 VDDSHV\_CANUART。IO 组的 IO 电源支持连接双电压 (3.3V 或 1.8V, 固定或动态开关) 电源。每个双电压 IO 组的 IO 电源为一组固定的 IO (或外设) 供电。3.3V 或 1.8V 电源电压可连接到任何双电压 IO 组的 IO 电源。

IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型 (LVC MOS、SDIO 或开漏 I2C) 和所连接的外设。

以 MMC0、MMC1 和 MMC2 信号组为基准的 IO 组的 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6 IO 电源旨在支持上电、下电或不依赖于其他处理器电源轨的动态电源电压变化 (切换)。动态电压切换功能可支持 UHS-I SD 卡。

无论何种 IO 使用情况, 建议将有效电源连接到 IO 组的 IO 电源。

根据所选的内存类型 (DDR4 或 LPDDR4), 建议按照 ROC 连接 DDR PHY IO 电源和 DDR 时钟 IO 电源。

对于 AM625SIP, 还需要将 LPDDR4 IO 电源 (VDDS\_MEM\_1P1) 和 LPDDR4 内核电源 (VDDS\_MEM\_1P8) 连接到分配为 LPDDR4 电源引脚的处理器引脚, 以便为集成式 LPDDR4 电源供电。

### 7.2.2 AM62Px IO 电源

处理器系列支持 IO 组的 IO 电源 VDDSHV $x$  [ $x = 0-3, 5-6$ ]、VDDSHV\_MCU 和 VDDSHV\_CANUART。IO 组的 IO 电源支持连接双电压 (3.3V 或 1.8V, 固定或动态开关) 电源。每个双电压 IO 组的 IO 电源为一组固定的 IO (或外设) 供电。3.3V 或 1.8V 电源电压可连接到任何双电压 IO 组的 IO 电源。

IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型 (LVC MOS、SDIO 或开漏 I2C) 和所连接的外设。

IO 电源要求取决于 IO 缓冲器类型 (LVC MOS、SDIO 或开漏 I2C)。

以 MMC1 和 MMC2 信号组为基准的 VDDSHV5 和 VDDSHV6 IO 组的 IO 电源旨在支持加电、断电或动态电源电压变化 (切换), 而不依赖于其他处理器电源导轨。动态电压切换功能可支持 UHS-I SD 卡。

无论何种 IO 使用情况, 建议将有效电源连接到 IO 组的 IO 电源。

根据所选的内存类型 (LPDDR4), 建议按照 ROC 连接 DDR PHY IO 电源和 DDR 时钟 IO 电源。

### 7.2.3 IO 组的 IO 电源的电源连接检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 7.3 存储器接口 (DDRSS (DDR4/LPDDR4)、MMCS (eMMC/SD 卡/SDIO)、OSPI/QSPI 和 GPMC)

### 7.3.1 DDR 子系统 (DDRSS)

请参阅以下常见问题解答:

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV) 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — DDRSS : DDR4/LPDDR4 存储器接口

[常见问题解答] AM625 : DDR4/LPDDR4 性能差异

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问

## AM62x 处理器系列

该处理器系列支持 1 个 DDR 子系统 DDRSS0 实例、并支持连接到 16 位 SDRAM。

DDRSS 接口支持 DDR4 或 LPDDR4 存储器接口。DDR4 或 LPDDR4 存储器的选择取决于应用或客户, 因为每种存储器类型的延迟和突发长度存在差异。

如需更多信息, 请参阅以下应用手册:

[Sitara AM62x 基准测试](#)

有关 DDRSS 与 JEDEC 标准的兼容性的信息，请参阅处理器特定数据表的 *DDR* 电气特性一节。请参阅处理器特定数据表的以下注意事项：

---

### 备注

DDRSS 接口与符合 JESD79-4B 标准的 DDR4 器件和符合 JESD209-4B 标准的 LPDDR4 器件兼容。

---

## AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列

该处理器系列支持 DDR 子系统 DDRSS0 的 1 个实例，并支持连接到 16 位或 32 位 SDRAM。

当前支持的使用 DDR 子系统 (DDRSS0) 的存储器接口是 LPDDR4 存储器接口。

### 7.3.1.1 DDR4 SDRAM ( 双倍数据速率 4 同步动态随机存取存储器 )

#### 7.3.1.1.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 处理器系列

有关实施指南和布线拓扑，请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#)。

##### 7.3.1.1.1.1 存储器接口配置

允许的内存配置为 1 ( 单 ) 个 16 位或 2 ( 两 ) 个 8 位。

1 ( 单 ) 个 8 位内存配置不是允许的或有效的配置。

建议根据所选的内存大小验证 DDRSS 信号存储库组 ( DDR0\_BG0、DDR0\_BG1 ) 的连接，并根据内存选择 ( 单列或双列 ) 验证芯片选择 ( DDR0\_CS0\_n、DDR0\_CS1\_n ) 的连接。请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#)。

##### 7.3.1.1.1.2 布线拓扑和内存终端连接

当使用 1 ( 单 ) 个内存 (DDR4) 器件 ( 1 ( 单 ) 个 16 位 ) 时，建议遵循点对点拓扑 ( 连接 )。

点对点拓扑实现总结：

- 对于差分时钟 DDR0\_CK0, DDR0\_CK0\_n，建议采用如下配置：使用交流终端 2 个 R 串联 ( 值 =  $Z_o$  - 单端阻抗 )，并在两个电阻中间连接一个滤波电容器  $0.01 \mu F$  ( 或内存制造商推荐的值 )，同时连接到 DDR PHY 的 IO 电源 VDDS\_DDR。
- VREFCA (VDDS\_DDR/2) 是用于存储器 (DDR4) 器件的控制、命令和地址输入的基准电压。当不使用 VTT 终端和 VTT 终端 LDO 时，可以使用电阻分压器 ( VDDS\_DDR 和 VSS 之间连接的两个电阻器 (  $1k\Omega$ ,  $\pm 1\%$ , 建议值 ) ) 和一个与电阻器并联的滤波电容器 (  $0.1 \mu F$ , 建议值 ) 从 VDDS\_DDR 推算出 VREFCA。建议在 VREFCA 引脚附近连接额外的去耦电容器 ( 靠近内存 (DDR4) 器件 )。
- 地址和控制信号的外部 VTT 终端是可选项。

当使用 1 个 DDR4 时地址和控制信号使用 VTT 终端时，请使用灌电流或拉电流 DDR 终端稳压器 (LDO) 生成所需的 VTT 电源。

使用 2 ( 两 ) 个内存 (DDR4) 器件 ( 2 ( 两 ) 个 8 位 ) 时，建议遵循飞越式拓扑 ( 连接 )。

飞越式拓扑实现总结：

- 建议为地址、控制和时钟信号使用外部 VTT 终端。
- 建议使用灌电流或拉电流 DDR 终端稳压器 (LDO) 生成 VTT 电源。
- 灌电流或拉电流 DDR 终端稳压器 (LDO) 用于生成基准电压 VREFCA (VDDS\_DDR/2)。
- 建议为基准电压添加去耦电容器。

##### 7.3.1.1.1.3 用于 DDRSS 控制和校准的电阻

建议为 DDR0\_RESET0\_n (DDR\_RESET#) 连接下拉电阻器 ( $10k\Omega$ ) ( 靠近内存 (DDR4) 器件 )。可以选择在下拉电阻器上添加滤波电容器 (  $47pF$  或类似值 )。

建议为 DDR0\_CAL0 ( IO 焊盘校准电阻器，靠近处理器校准引脚 ) 和 ZQn ( 存储器件校准基准电阻器， $n = 0-1$ ，靠近内存 (DDR4) 器件 ) 连接推荐的 ( 遵循处理器特定数据表或 SK 原理图 ) 电阻器。

建议为 TEN 连接下拉电阻器（测试使能）。建议添加一个可选的下拉电阻器配置 DDR0\_CKE0 信号（DDR\_CKE 网络）并标记为 DNI（未组装）。建议靠近内存（DDR4）器件为 DDR0\_ALERT\_n（DDR\_ALERTn）添加上拉电阻器。有关实现和电阻器值，请参阅处理器特定 SK。

#### 7.3.1.1.4 电源轨的电容器

建议验证是否已为处理器 DDRSS 电源导轨和内存（DDR4）器件电源导轨提供了足够的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.3.1.1.5 数据位或字节交换

在定制电路板设计过程中，如果需要进行位交换，则允许在数据字节内进行位交换，以及在某些限制条件下进行跨字节交换。不支持地址位和控制位交换。请勿将 DM 和 DQS 位与任何其他信号交换。

如需更多信息，请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#) 的位交换一节。

建议根据位交换的变化（包括注释）更新原理图，以供今后参考或重复使用。

#### 7.3.1.1.6 DDR4 实现检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

#### 7.3.1.1.7 DDR4 VTT 端接实现原理图参考

使用 2（两）个存储器（DDR4）器件（2 个 8 位）时，每个器件将连接到 DDRSS 的各自的数据字节。地址信号或控制信号以飞越式拓扑连接，并 VTT 终端连接到远离处理器 DDRSS 的存器件储附近。

要实现 VTT 终端，请遵循 [TMDS64EVM \(AM64x Sitara 处理器评估模块\)](#)。

建议作为设计的一部分执行板级仿真。

#### 7.3.1.2 AM625SIP 处理器系列

不适用。

由于该处理器集成了 LPDDR4，DDRSS0 引脚已内部重新分配，并且处理器特定数据表（[AM625SIP — AM6254 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 Sitara 处理器](#)）的引脚属性和信号描述一节中提供了 DDRSS0 引脚的连接建议。

#### 7.3.1.1.3 AM62Ax 与 AM62D-Q1 处理器系列

当前不受支持。

#### 7.3.1.1.4 AM62Px 处理器系列

当前不受支持。

#### 7.3.1.2 LPDDR4 SDRAM（低功耗双倍数据速率 4 同步动态随机存取存储器）

##### 7.3.1.2.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1 处理器系列

有关实施指南和布线拓扑，请参阅 [AM62x/AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#)。

该控制器支持 DDR4 和 LPDDR4。LPDDR4 地址总线为 6 位宽，连接到处理器 DDR\_A 端口的前 6 位，其他信号未连接。使用 LPDDR4 时，不使用额外的地址信号（用于 DDR4），可以保持未连接状态。设计定制电路板的 DDR 部分时，请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#)。

##### 7.3.1.2.1.1 存储器接口配置

允许的存储器配置为 1（单）个 16 位。

##### 7.3.1.2.1.2 布线拓扑和内存终端连接

时钟（CK）、地址、控制（ADDR\_CTRL）和数据信号建议遵循点对点拓扑。

**VTT 终端不适用于 LPDDR4 内存类型。**地址和控制信号所需的内存端接由内部（片上）支持（处理）。

### 7.3.1.2.1.3 用于 DDRSS 控制和校准的电阻

建议为 DDR0\_RESET0\_n (LPDDR4\_RESET\_N) 连接下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) ( 靠近内存 (LPDDR4) 器件 )。可以选择在下拉电阻器上添加滤波电容器 ( 47pF 或类似值 )。

建议为 DDR0\_CAL0 ( IO 焊盘校准电阻 , 靠近处理器校准引脚 ) 、 ODT\_CA\_A ( SK 上使用的  $2.2\text{k}\Omega$  , 用于芯片选择的 DDRSS 片上终端 , 靠近存储器 (LPDDR4) 器件 ) 以及 ZQ ( 存储器件校准参考电阻 , 靠近存储器 (LPDDR4) 器件 ) 连接建议的 ( 遵循处理器特定数据表或 SK 原理图 ) 电阻。

### 7.3.1.2.1.4 电源轨的电容器

建议验证是否已为处理器 DDRSS 电源导轨和内存 (LPDDR4) 器件电源导轨提供了足够的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议 , 建议遵循处理器特定 SK 实现。

### 7.3.1.2.1.5 数据位或字节交换

在定制电路板设计过程中 , 如果需要进行位交换 , 则允许在数据字节内进行位交换 , 以及进行跨字节交换。不支持地址位和控制位交换。

有关更多信息 , 请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#) 的字节和位交换一节。

建议根据位交换的变化 ( 包括注释 ) 更新原理图 , 以供今后参考或重复使用。

### 7.3.1.2.1.6 DDRSS 信号引脚 ( 封装 ) 延迟信息

不需要引脚封装延迟注意事项。在训练过程中 , 每位校正可以补偿封装长度不匹配的情况。只要根据 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#) 应用手册中的偏移使板上的引脚对引脚匹配 , 训练就可以注意在字节通道和 ctrl/addr 信号上优化偏移。

DDRSS 信号的引脚延迟相关说明已载于 TI.com 上 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局布线指南 \(SPRAD06C - 2022 年 3 月 - 2025 年 3 月修订\)](#) 应用手册的 TI.com 上 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南 \(SPRAD06C - 2022 年 3 月 - 2025 年 3 月修订\)](#) 应用说明的封装延迟一节。

本附录中提供的引脚延迟是从处理器芯片焊盘到处理器封装引脚测量的。

请参阅以下常见问题解答 :

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM624SIP : AM6254 LPDDR4 长度/延迟匹配](#)

### 7.3.1.2.1.7 LPDDR4 实现检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

### 7.3.1.2.2 AM625SIP 处理器系列

AM625SIP 支持集成 LPDDR4 内存。DDRSS0 信号在内部重新分配 , 以提供所需的电源 , 并连接外部校准电阻 (DDR\_ZQ) 和外部 DDR\_RESETn 下拉电阻器 (DDR0\_RESET0\_N,  $10\text{k}\Omega$ )。

有关连接电源和校准电阻 ( 包括值、容差和电源 ) 的信息 , 请参阅处理器特定数据表 ( [AM625SIP — 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 AM6254 Sitara 处理器](#) ) 。

AM625SIP 是 ALW 封装 AM6254 器件的系统级封装 (SIP) 衍生器件 , 并添加了一个集成式 LPDDR4 SDRAM 。 [AM625SIP — 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 AM6254 Sitara 处理器](#) 文档仅说明了《 [AM62x Sitara 处理器数据表](#) 》 ( 版本 B 或更高版本 ) 中定义的 ALW 已封装 AM6254 器件的差异或例外情况。

### 7.3.1.2.2.1 AM625SIP LPDDR4 连接检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

### 7.3.1.2.3 AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列

有关实现指南和布线拓扑 , 请参阅 [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#) 。

### 7.3.1.2.3.1 存储器接口配置

允许的内存配置为 1 (单) 个 32 位或 1 (单) 个 16 位。

1 (单) 个 8 位内存配置不是允许的或有效的配置。

### 7.3.1.2.3.2 布线拓扑和内存终端连接

使用 32 位单列或双列 LPDDR4 时，建议地址、CKE 和 CK 信号布线遵循平衡 T 拓扑。

使用 16 位单列 LPDDR4 时，遵循点对点拓扑。建议根据 [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局指南](#) 建议，连接未使用的数据选通引脚 (DDR0\_DQS2-3 和 DQS2-3\_n)。

LPDDR4 的数据接口信号连接拓扑结构是点对点的，分为不同的字节通道。

VTT 终端不适用于 LPDDR4 内存类型。地址和控制信号所需的终端由内部 (片上) 支持 (处理)。

### 7.3.1.2.3.3 用于 DDRSS 控制和校准的电阻

建议为 DDR0\_RESET0\_n (LPDDR4\_RESET\_N) 连接下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) (靠近内存 (LPDDR4) 器件)。可以选择在下拉电阻器上添加滤波电容器 ( $47\text{pF}$  或类似值)。

建议为 DDR0\_CAL0 (IO 焊盘校准电阻器，靠近处理器校准引脚)、ODT\_CA\_A、ODT\_CA\_B (SK 上使用的  $2.2\text{k}\Omega$ 、片选 n ( $n=0-1$ ) 的 DDRSS 片上终端，靠近内存 (LPDDR4) 器件) 和 ZQn (存储器件校准基准电阻器， $n = 0-1$ ，靠近内存 (LPDDR4) 器件) 连接推荐的 (遵循处理器特定数据表或 SK 原理图) 电阻器。

### 7.3.1.2.3.4 电源轨的电容器

建议验证是否已为处理器 DDRSS 电源导轨和内存 (LPDDR4) 器件电源导轨提供了足够的大容量电容器和去耦电容器。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

### 7.3.1.2.3.5 数据位或字节交换

在定制电路板设计过程中，如果需要进行位交换，则允许在数据字节内进行位交换，以及在某些限制条件下进行跨字节交换。不支持地址位和控制位交换。

有关更多信息，请参阅 [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#) 的通道、字节和位交换一节。

建议根据位交换的变化 (包括注释) 更新原理图，以供今后参考或重复使用。

### 7.3.1.2.3.6 LPDDR4 实现检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 7.3.2 多媒体卡/安全数字 (MMCSD)

该处理器系列支持 3 (三) 个多媒体卡/安全数字卡 (MMC/SD/SDIO) ( $8\text{b} + 4\text{b} + 4\text{b}$ )。

### 7.3.2.1 MMC0 - eMMC (嵌入式多媒体卡) 接口

#### 7.3.2.1.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

该处理器系列支持 1 个可配置用于 eMMC/SD/SDIO 接口的外设实例 MMC0。由于 MMC0 已针对 eMMC 接口进行时序闭合，因此建议将 MMC0 用于 eMMC 接口。MMC0 支持 8 位 eMMC (嵌入式多媒体卡) 接口。如需了解支持的速度，请参阅处理器特定数据表的 [MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口](#)一节；如需了解实现方式，请参阅 SK。当不用于 eMMC 接口时，MMC0 信号可用于板载 SDIO 接口或用作 IO 或其他支持的多路复用功能。不建议为 SD 卡连接 MMC0 端口。

有关 eMMC 内存接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — eMMC 存储器接口](#)

## [常见问题解答] AM62A7 : MMC0 拉电阻器要求

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC0 - eMMC/SD/SDIO 接口** 一节。

### 7.3.2.1.1.1 IO 电源

用于 MMC0 (eMMC) 接口的处理器 IO 以 VDDSHV4 电源导轨 ( IO 组 4 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 ) 。

VDDSHV4 旨在支持加电、断电或不依赖于其他电源导轨的动态电压开关，让其工作电压从 3.3V 更改为 1.8V。

建议将所连接器件的 VDDSHV4 和 IO 电源轨连接到同一电源。

所连接器件的 VDD ( 内核电压 ) 可从 ( 由 ) 独立电源 ( 不同的电源 ) 供电。

### 7.3.2.1.1.2 eMMC 接口信号连接

建议进行以下连接：

- 建议在靠近处理器时钟输出引脚的位置为 MMC0\_CLK 信号添加一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) ( 建议使用串联电阻器来控制可能的信号反射，以免导致错误的时钟转换 ) 。建议最初使用  $0\Omega$ ，并进行调整以匹配 PCB 布线阻抗。
- 建议为靠近所连接器件时钟输入引脚的 MMC0\_CLK 添加一个外部下拉电阻器 ( $10k\Omega$ ) ( 靠近所连接 eMMC 器件时钟输入引脚 )，以将时钟保持在低电平状态 ( 在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态下停止或暂停，并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致 )，直到主机将信号配置为时钟。
- 建议为 MMC0\_DAT0 和 MMC0\_CMD 信号连接外部上拉电阻器 ( $47k\Omega$ ) ( 靠近 eMMC 器件 )，以防止所连接器件输入在主机软件驱动接口信号之前处于悬空状态。
  - 对于 MMC0\_DAT[7:1] 信号，上拉电阻器是可选的 ( 删减或 DNI )，因为所连接 eMMC 器件 ( 符合 eMMC JEDEC 标准 JESD84-B51 的 eMMC 器件 ) 需要 ( 应当 ) 为 MMC0\_DAT[7:1] 信号打开内部上拉电阻器，直到主机将总线宽度更改为 4 位或 8 位模式。主机应当使能内部上拉电阻器，在更改为 4 位模式时，eMMC 器件应当关闭 MMC0\_DAT[3:1] 上的内部上拉电阻器。主机应当使能内部上拉电阻器，在更改为 8 位模式时，eMMC 器件应当关闭 MMC0\_DAT[7:1] 上的内部上拉电阻器。
- 建议为 DS 信号连接一个带测试点 ( 可选 ) 的下拉电阻器 ( 靠近 eMMC 器件 )。

### 7.3.2.1.1.3 eMMC ( 连接器件 ) 复位

建议使用双输入 “ 与运算 ” 逻辑来实现所连接器件的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门，在 “ 与运算 ” 逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ ) ( 以支持引导 ) 并提供  $0\Omega$ ，以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz) 。

如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件 ( 不使用 “ 与运算 ” 逻辑 )，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，eMMC 复位输入的上升 / 下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

### 7.3.2.1.1.4 电源轨的电容器

建议确认已为 VDDSHV4 电源导轨和所连接器件 ( 内核和 IO 电源 ) 提供大容量电容器与去耦电容器 ( 若有建议则使用建议的电容，或遵循相关 SK 实现 ) 。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

### 7.3.2.1.1.5 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 的 MMC0 (eMMC) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

### 7.3.2.1.2 AM62Px 处理器系列

该处理器系列支持 1 个外设实例 MMC0 。 MMC0 支持 8 位 eMMC ( MMC0 接口符合 JEDEC eMMC 电气标准 v5.1 (JESD84-B51) ) 接口。处理器内部实现的 eMMC 接口是一个专用的硬宏 PHY 。处理器特定数据表的 [引脚属](#)

性 (AMH 封装) 表中的“MUX 模式”、DSIS 和“复位后的 MUX 模式”列为空白，因为引脚 ( 接口 ) 由硬宏 PHY 实现 ( 不支持引脚多路复用 )。

查阅 eMMC 相关器件勘误表 [AM62Px Sitara™ 处理器器件勘误表、器件修订版本 1.0、1.1](#)。建议提供配置，将 VDDA\_0P85\_DLL\_MMC0、VDD\_MMC0 和 VDDR\_CORE 连接到同一电源，以便支持未来的增强功能 ( 并保持当前使用的器件修订版本与下一个后续器件修订版本之间的兼容性 )。请参阅以上部分：[内核和外设电源的 AM62Px](#)。

有关 eMMC 存储器接口 HS400 支持的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 – 支持 HS400 的电源连接和电路板布局建议](#)

#### 备注

电源引脚 ROC 和命名规则发生变化，以支持 HS400。有关详细信息，请参阅处理器特定数据表。

有关 eMMC 内存接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 – eMMC 存储器接口](#)

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 – 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问](#)

如需更多信息，请参阅处理器特定数据表的 [MMC0 - eMMC 接口](#)一节。

#### 7.3.2.1.2.1 使用 MMC0 接口

##### 7.3.2.1.2.1.1 IO 电源

处理器的 MMC0 IO 接口以 VDDS\_MMC0 (1.8V) 电源为基准 ( 由其供电 )。

建议将所连接器件的 VDDS\_MMC0 和 IO 电源轨连接到同一电源。

所连接器件的 VDD ( 内核电压 ) 可从 ( 由 ) 独立电源 ( 不同的电源 ) 供电。

##### 7.3.2.1.2.1.2 eMMC 接口信号连接

建议进行以下连接：

- 建议为 MMC0\_CLK 信号添加一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) ( 靠近处理器时钟输出引脚以控制反射 )
- 建议在 MMC0\_CALPAD ( 靠近处理器 CALPAD 引脚 ) 与 VSS 之间连接一个电阻器。有关建议电阻值和容差，请参阅处理器特定数据表。

#### 备注

由于硬宏 eMMC PHY 在内部实现了所需的拉电阻器，因此建议不要为 MMC0 eMMC PHY 添加 ( 无需 ) 外部拉电阻器。

在复位期间和复位后、eMMC 硬宏 PHY 会在内部使能 DAT[7:0] 和 CMD 的上拉电阻器。在 SS 复位下拉电阻器后，为 DS 使能下拉电阻器，且时钟输出 (CLK) 驱动为低电平。

MMC0 引脚没有关联的 PADCONFIG 寄存器。与 MMC0 引脚关联的内部上拉电阻器由 MMC0 主机 ( 和 PHY ) 动态控制。

##### 7.3.2.1.2.1.3 eMMC ( 连接器件 ) 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门，在“与运算”逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ ) ( 以支持引导 ) 并提供  $0\Omega$ ，以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。

如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件 (不使用“与运算”逻辑)，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，eMMC 复位输入的上升/下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

#### 7.3.2.1.2.1.4 电源轨的电容器

建议确认已为 MMC0 电源导轨和所连接器件 (内核和 IO 电源) 提供大容量电容器与去耦电容器 (若有建议则使用建议的电容，或遵循相关 SK 实现)。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.3.2.1.2.2 不使用 MMC0 接口

MMC0 接口信号不支持备选功能。不使用 MMC0 时，接口信号和 MMC0 电源有特定的连接要求。

有关连接未使用的 MMC0 接口信号和未 MMC0 电源导轨的信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

#### 7.3.2.1.2.3 AM62Px 的 MMC0 (eMMC) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 7.3.2.1.3 有关 eMMC PHY 的额外信息

建议参阅处理器特定数据表的信号说明一节 MMC、MAIN 域小节中的注释。

---

#### 备注

不同处理器系列中使用的 eMMC 控制器和 eMMC PHY IP 的实现方式有所不同。建议遵循适用于 eMMC 接口的处理器特定建议，包括迁移到其他处理器系列时建议使用的端接。建议查看处理器特定数据表、TRM，并遵循针对处理器和连接器件的连接建议。

可以遵循处理器特定 SK 实现作为起始参考。

#### 7.3.2.1.4 MMC0 - SD (安全数字) 卡接口

已在 SK 原理图中的 MMC0 接口上实现了 eMMC 接口。MMC0 接口上不支持 CD (卡检测) 和 WP (写保护) 功能 (引脚) 来实现 SD 卡接口。

当不使用 eMMC 接口时，建议将 MMC0 端口配置用于 SDIO 嵌入式接口或支持的其他多路复用功能。建议在实现嵌入式 SDIO 接口之前始终确认提供的软件支持 (使用 E2E)。

不建议将 SD 卡连接至 MMC0 端口。建议为 SD 卡接口配置 MMC1 端口。

#### 7.3.2.2 MMC1/MMC2 - SD (安全数字) 卡接口

处理器系列支持 2 个可配置为 SD 卡接口的外设实例 MMC1、MMC2。MMC1、MMC2 接口支持 4 位 SD 卡接口，包括对 UHS-I SD 卡的支持。建议将 **MMC1 用于 SD 卡接口 (基于定制电路板设计要求)**。建议使用 MMC1 实现 SD 卡接口，因为 MMC1 支持 SD 卡引导模式，MMC1 IO 连接到支持 SD 卡功能的 IO 组的 IO 电源。当 MMC2 接口用于实现 SD 卡接口时，信号 (SDCD 和 SDWP) 需要多路复用到连接到 VDDSHV0 的 IO。

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC1/MMC2 - SD/SDIO 接口** 一节。

#### 7.3.2.2.1 IO 电源

MMC1 (CMD、CLK 和 Data) 接口 IO 以 VDDSHV5 电源导轨 (IO 组 5 的 IO 电源) 为基准 (由其供电)。VDDSHV5 旨在支持加电、掉电或不依赖于其他电源轨的动态电压开关，让其工作电压随着传输速度的增加从 3.3V 更改为 1.8V。

建议 VDDSHV5 电源从 3.3V 开始，并在软件应当 (需要) 更改 IO 电源电压 (以支持 UHS-I SD 卡) 时允许更改为 1.8V。

建议使用单独的电源（分立式 LDO 或 PMIC），当配置为 SD 卡接口时，这些电源可以为 VDDSHV5 电源轨独立切换。

MMC1 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号以 VDDSHV0 电源导轨 (IO 组 0 的 IO 电源) 为基准 (由其供电)。建议将 MMC1\_SD\_CD、MMC1\_SD\_WP 的上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ) 连接到与 VDDSHV0 (固定电源) 连接的同一电源轨。

MMC2 (CMD、CLK 和 Data) 接口 IO 以 VDDSHV6 电源导轨 (IO 组 6 的 IO 电源) 为基准 (由其供电)。VDDSHV6 旨在支持加电、掉电或不依赖于其他电源轨的动态电压开关，让其工作电压随着传输速度的增加从 3.3V 更改为 1.8V。

建议 VDDSHV6 电源从 3.3V 开始，并在软件应当 (需要) 更改 IO 电源电压 (以支持 UHS-I SD 卡) 时允许更改 1.8V。

建议使用单独的电源（分立式 LDO 或 PMIC），当配置为 SD 卡接口时，这些电源可以为 VDDSHV6 电源轨独立切换。

MMC2 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号以 VDDSHV6 (IO 组 6 的 IO 电源) 电源导轨或 VDDSHV0 电源导轨 (IO 组 0 的 IO 电源) 为基准 (由其供电)。以 IO 组 0 或 6 的 IO 电源为基准 (由其供电) 的 IO 选择取决于用例。建议为可连接到 VDDSHV6 或 VDDSHV0 电源导轨 (根据所选引脚 (IO)) 的 MMC2\_SD\_CD 和 MMC2\_SD\_WP (可选) 信号添加外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) (靠近所连接器件)。

### 7.3.2.2.2 信号连接

当使用 MMC1 和 MMC2 信号来实现 SD 卡接口时，建议进行以下连接：

#### 7.3.2.2.2.1 用于 SD 卡接口的 MMC1 信号 (建议)

- 建议为 MMC1\_CLK 添加一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) (靠近处理器时钟输出引脚以控制可能的信号反射)。建议为靠近所连接器件输入的 MMC1\_CLK 添加一个下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ )，以将时钟保持在低电平状态 (在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态下停止或暂停，并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致)，直到主机将信号配置为时钟。
- 建议为 SD 卡数据信号 (MMC1\_DAT[3:0]) 和 CMD 信号 (MMC1\_CMD) 添加外部上拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ )，以防止在主机软件驱动接口信号之前所连接器件输入处于悬空状态。建议将 SD 卡接口信号上拉电阻器连接到 IO 组双电压 IO 电源 (MMC1 = VDDSHV5) 电源导轨。
- 建议为连接到 VDDSHV0 电源导轨的 MMC1\_SD\_CD 和 MMC1\_SD\_WP 信号添加外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ) (靠近所连接器件 (SD 卡插槽))。
- 插入 SD 卡时，处理器的 SD 卡检测 (SD\_CD) 输入直接连接到接地端。建议使用一个 ( $100\Omega$ ) 串联电阻器限制电流，以防 IO 被意外编程为输出。

#### 7.3.2.2.2.2 用于 SD 卡接口的 MMC2 信号

- 建议为 MMC2\_CLK 添加一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) (靠近处理器时钟输出引脚以控制可能的信号反射)。建议为靠近连接器件输入的 MMC2\_CLK 添加一个下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ )，以将时钟保持在低电平状态 (在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态下停止或暂停，并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致)，直到主机将信号配置为时钟。
- 建议为 SD 卡数据信号 (MMC2\_DAT[3:0]) 和 CMD 信号 (MMC2\_CMD) 添加外部上拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ )，以防止连接器件输入悬空，直到主机软件驱动接口信号。建议将 SD 卡接口信号上拉电阻器连接到 IO 组 (MMC2 = VDDSHV6) 电源导轨的双电压 IO 电源。
- 要支持 SD 卡接口，建议将 MMC2\_SD\_CD 和 MMC2\_SD\_WP 信号基准 (电源) 连接到 VDDSHV0。建议为连接到同一个电源导轨的 MMC2\_SD\_CD 和 MMC2\_SD\_WP 信号添加外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ )，该电源导轨连接到 VDDSHV0 电源导轨 (靠近连接器件 (SD 卡插槽))。
- 插入 SD 卡时，处理器的 SD 卡检测 (SD\_CD) 输入直接连接到接地端。建议使用一个 ( $100\Omega$ ) 串联电阻器限制电流，以防 IO 被意外编程为输出。

#### 7.3.2.2.2.3 其他信息

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 - SD 卡接口

[常见问题解答] AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 : 为什么 MMC1 由 VDDSHV0 和 VDDSHV5 这两个不同的电压电源供电 ?

[常见问题解答] AM62A7-Q1 : 如果未使用 SD 卡 , 如何连接引脚网络 VDDSHV4、VDDSHV5 和 VDDSHV6

[常见问题解答] AM6442 : AM6442 MMC1

[常见问题解答] AM625 : MMC 接口

这是通用常见问题解答 , 也可用于 AM62x ( AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP ) AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 ) 、 AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

### 7.3.2.2.3 SD 卡电源开关 EN 复位逻辑

建议配置由软件使能 ( 控制 ) 的电源开关 ( 负载开关 ) 来为 SD 卡提供电源 (VDD)。一个固定的 3.3V 电源 ( 处理器 IO 电源 ) 作为电源开关的电源输入进行连接。

使用电源开关可以对 SD 卡电源进行下电加电 ( 因为复位电源开关是复位 SD 卡的唯一方法 ) , 并将 SD 卡复位为使用 UHS-I SD 卡时的默认状态。

建议使用 3 输入 “ 与运算 ” 逻辑来实现 SD 卡电源开关使能和复位逻辑。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门 , 在 “ 与运算 ” 逻辑与门附近提供上拉电阻器 ( 10k $\Omega$  或 47k $\Omega$  ) ( 以支持 SD 卡引导 ) 并提供 0 $\Omega$  , 以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另外两个输入是 MAIN 域 POR ( 冷复位 ) 状态输出 (PORz\_OUT) 或 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 。

建议将为 SD 卡电源供电的外部电源开关默认设为 ON ( 供电状态 ) 以支持 SD 卡引导。

有关实现的信息 , 请参阅处理器特定 SK 。

### 7.3.2.2.4 SD 卡接口信号的外部 ESD 保护

建议为 SD 卡接口信号 ( 数据、时钟和控制信号 ) 提供外部 ESD 保护。内部 ESD 保护不能满足板级或终端设备级 ESD 要求。

### 7.3.2.2.5 IO 组电源导轨的 IO 电源电容器

建议确认已为 VDDSHV0 、 VDDSHV5 、 VDDSHV6 电源导轨及所连接器件提供大容量电容与去耦电容 ( 若有推荐方案则使用推荐电容 , 或遵循相关 SK 实现 ) 。

如果没有可用的建议 , 建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 备注

建议遵循针对数据和控制信号的处理器特定连接建议。建议将时钟的串联电阻器放置在靠近处理器时钟输出引脚的位置 , 以控制可能存在的信号反射。

### 7.3.2.2.6 SD 卡接口 (MMC1) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

### 7.3.2.3 MMC1/MMC2 SDIO ( 嵌入式 ) 接口

该处理器系列支持可配置为 SDIO 接口的 2 个外设实例 MMC1 、 MMC2 。由于 MMC2 接口已在 SK 上针对 SDIO 接口进行了测试 , 因此建议将 MMC2 接口用于 Wi-Fi 或蓝牙收发器等板载固定电压嵌入式 SDIO 器件用例。

MMC1 可根据需要用于 SDIO 。由于尚未在 MMC1 上对 SDIO 接口进行测试 , 因此客户应检查软件支持的可用性 , 并对定制电路板设计执行所需的性能测试。

固定的 IO 电源用于嵌入式 SDIO 接口 , 并简化了电源架构。使用的信号包括数据、命令、时钟和复位信号。连接 SDCD 和 SDWP 信号是可选的 , 可能取决于用例。

没有关于为嵌入式 SDIO 实现拉电阻器（为连接的器件提供或不提供拉电阻器）的特定指南。实现嵌入式 SDIO 器件的定制电路板设计人员负责确定 SDIO 器件上支持的拉电阻器，并在定制电路板设计上应用适当的外部拉电阻器。处理器 IO 缓冲器（用于多个 IO）在复位期间和复位后处于关闭状态，在电路板引导并配置软件之前不会使能。为了防止输入悬空，建议对连接到可悬空的所连接器件输入端的信号使用外部拉电阻器。

有关更多信息，请参阅处理器特定数据表的 **MMC1/MMC2 - SD/SDIO 接口**一节。

另请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/ AM243x \(ALV\)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误—SDIO \( 嵌入式 \) 接口](#)

### 7.3.2.3.1 IO 电源

MMC1 ( CMD、CLK 和 Data ) 接口 IO 以 VDDSHV5 电源导轨 ( IO 组 5 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。

MMC1 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号 ( 可选 ) 以 VDDSHV0 电源导轨 ( IO 组 0 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。建议将 SDIO 接口的 MMC1\_SDCD、MMC1\_SDWP 的上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) 连接到同一电源导轨 VDDSHV0 。

MMC2 ( CMD、CLK 和 Data ) 接口 IO 以 VDDSHV6 电源导轨 ( IO 组 6 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。

MMC2 SD 卡检测 (CD) 和写保护 (WP) 信号 ( 可选 ) 以 VDDSHV6 ( IO 组 6 的 IO 电源 ) 电源导轨或 VDDSHV0 电源导轨 ( IO 组 0 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。SDIO 接口的 MMC2\_SDCD、MMC2\_SDWP 的上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) 可连接到 VDDSHV6 或 VDDSHV0 电源导轨。

### 7.3.2.3.2 信号连接

#### 备注

在没有建议的拉电阻器的情况下，建议遵循以下一般建议。定制电路板设计人员负责审查所连接器件支持的拉电阻器，并确保没有在外部添加反极性拉电阻器。

建议为 MMC1 接口进行以下连接：

- 建议为 MMC1\_CLK 连接一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) ( 靠近处理器时钟输出引脚，以控制可能的信号反射 )，为 MMC1\_CLK 连接外部下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件时钟输入引脚 )，以将所连接器件保持在低电平状态 ( 在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态停止或暂停，并且下拉选项与该逻辑状态一致 )。
- 建议为连接到相应 IO 组双电压 IO 电源 (MMC1 = VDDSHV5) 电源导轨的数据线路 (MMC1\_DAT[3:0]) 和 CMD 信号 (MMC1\_CMD) 添加外部上拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件 )。
- 建议为连接到 VDDSHV0 电源导轨的 MMC1\_SDCD 和 MMC1\_SDWP ( 可选 ) 信号添加外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件 )。

建议为 MMC2 接口进行以下连接：

- 建议为 MMC2\_CLK 连接一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ) ( 靠近处理器时钟输出引脚，以控制可能的信号反射 )，为 MMC2\_CLK 连接外部下拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件时钟输入引脚 )，以将所连接器件保持在低电平状态 ( 在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态停止或暂停，并且下拉选项与该逻辑状态一致 )。
- 建议为连接到相应 IO 组双电压 IO 电源 (MMC2 = VDDSHV6) 电源导轨的数据线路 (MMC2\_DAT[3:0]) 和 CMD 信号 (MMC2\_CMD) 添加外部上拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件 )。
- 建议为可连接到 VDDSHV6 或 VDDSHV0 电源导轨 ( 根据所选引脚 (IO) ) 的 MMC2\_SDCD 和 MMC2\_SDWP ( 可选 ) 信号添加外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$ ) ( 靠近所连接器件 )。

### 7.3.2.3.3 SDIO ( 建议 MMC2 , 嵌入式 ) 接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 7.3.2.4 其他信息

建议参阅处理器特定数据表的 [信号说明](#)、**MMC**、**MAIN** 域一节中的注释。

### 7.3.3 八路串行外设接口 (OSPI) 或四路串行外设接口 (QSPI)

#### 备注

请参阅有链接的部分，了解如何实现串联电阻器和并联拉电阻器：[处理器特定 SK 与数据表](#)。

处理器系列支持一个 (x1) 可配置为 OSPI0 或 QSPI0 接口的八路串行外设接口 (OSPI0) 实例。OSPI0 是一种串行外设接口 (SPI) 模块，允许对外部闪存器件进行单路、双路、四路或八路读取和写入访问。OSPI0 实例支持具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI 接口。OSPI0 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备。OSPI0 外设具有内存映射寄存器接口，可提供直接内存接口用于从外部闪存器件访问数据，从而简化软件要求。

OSPI0 外设用于以内存映射直接模式（例如处理器希望直接从外部闪存执行代码）传输数据或以间接模式传输数据，其中模块设置为静默执行某些请求的操作，通过中断或状态寄存器发出完成信号。

对于间接操作，数据通过内部 SRAM 在系统存储器和外部闪存之间传输，器件控制器以低延迟系统速度加载该内部 SRAM 以进行写入，卸载以进行读取。中断或状态寄存器用于识别应使用用户可编程配置寄存器访问该 SRAM 的特定时间。

有关详细信息，请参阅处理器特定数据表的 [OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局布线指南](#)一节。

有关 OSPI 或 QSPI 存储器接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — OSPI/QSPI 存储器接口](#)

[常见问题解答] [Sitara/Jacinto 器件的 OSPI 常见问题解答](#)

#### 7.3.3.1 IO 电源

用于 OSPI0 ( OSPI 或 QSPI ) 接口的处理器 IO 以 VDDSHV1 电源导轨 ( IO 组 1 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。

建议将所连接器件的 VDDSHV1 和 IO 电源轨连接到同一电源。

所连接器件的 VDD ( 内核电压 ) 可从 ( 由 ) 独立电源 ( 不同的电源 ) 供电。

#### 7.3.3.2 信号连接

建议进行以下连接：

- 建议为 OSPI0\_CLK 连接一个串联电阻器 (  $0\Omega$  ) ( 靠近处理器时钟输出引脚，以控制可能的信号反射 )，为 OSPI0\_CLK 连接外部下拉电阻器 (  $10k\Omega$  ) ( 靠近所连接器件时钟输入引脚 )，以将所连接器件保持在低电平状态 ( 在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态停止或暂停，并且下拉选项与该逻辑状态一致 )。
- 建议为 OSPI0\_LBCLKO ( 靠近处理器的时钟输出引脚，以便能够连接或断开 LBCLKO ) 提供串联电阻器 ( $0\Omega$ ) 配置。
- 建议在靠近所连接器件输入的 CS 信号添加外部上拉电阻器添加 ( $10k\Omega$ ) 配置。
- 建议在配置为中断输入的处理器 IO 输入附近为 INT# 输出添加外部上拉器 ( $10k\Omega$ ) 配置。
- 建议为连接到所连接器件输入 ( 信号 ) 的数据线 (DAT0:7) 提供外部上拉电阻器 (  $10k\Omega$  或  $47k\Omega$  ) 配置，以防止所连接器件输入在由主机驱动之前处于悬空状态。建议将上拉电阻器连接到用于为 VDDSHV1 电源导轨供电的同一电源。

#### 7.3.3.3 OSPI/QSPI 器件复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件 ( OSPI/QSPI 内存 ) 的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门，在“与运算”逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器 (  $10k\Omega$  或  $47k\Omega$  ) ( 以支持引导 ) 并提供  $0\Omega$ ，以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。

如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件 ( 不使用“与运算”逻辑 )，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，OSPI/QSPI 复位输入的上升和下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

除了数据、时钟和片选输入外，建议选择还支持外部复位输入引脚的存储器件。

#### 7.3.3.4 环回时钟

请参阅处理器特定数据表的 *OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局指南*一节。本节提供在连接 OSPI、QSPI 或 SPI 存储器件时建议遵守的 PCB 布线指南。

建议验证环回时钟配置。可以使用 OSPI0\_LBCLKO ( OSPI0 环回时钟输出 ) 和 OSPI0\_DQS ( OSPI0 数据选通或环回时钟输入 ) 信号进行不同的时钟环回配置。有关支持的环回配置的相关信息，请参阅处理器特定数据表 *OSPI/QSPI/SPI 电路板设计和布局指南*一节中的下图：

- 无环回、内部 PHY 环回和内部焊盘环回的 OSPI 连接原理图
- 外部板环回的 OSPI 连接原理图
- DQS 的 OSPI 连接原理图

#### 外部电路板级环回

处理器 DQS ( 或环回时钟输入 ) 与所连接存储器件的 DS 数据选通输出搭配使用

建议 ( 当所连接器件中有 DS ( 读取数据选通 ) 引脚时 ) 将所连接器件的 DS 引脚连接到处理器的 OSPI0\_DQS 引脚。建议在不使用 OSPI0\_LBCLKO 引脚时将其保持未连接状态。

如果所连接器件上没有 DS 引脚 ( 例如 : QSPI ) ，建议配置外部环回。

建议将处理器的 OSPI0\_LBCLKO 输出引脚连接到处理器的 OSPI0\_DQS 输入引脚 ( 请注意长度匹配要求 ) 。

当不使用外部环回时，建议将 OSPI0\_LBCLKO 和 OSPI0\_DQS 引脚保持未连接状态。

#### 备注

为支持传统 x1 命令，处理器 OSPI0 接口的 D0 和 D1 引脚建议连接到 OSPI/QSPI 存储器件的 D0 和 D1 引脚。不允许进行数据位交换。

#### 7.3.3.5 多个 ( 连接 ) 器件的接口

当前不支持将 OSPI0 外设 ( 存储器接口 ) 连接到多个存储器器件。建议将 OSPI0 接口 ( 处理器 ) 连接到 1 个存储器器件。如果 OSPI0 连接到多个存储器器件，该接口会创建一条拆分的数据总线，这可能会降低更高速条件下的信号完整性。为了使用 OSPI0 以更高速度访问存储器器件，建议使用 OSPI0 接口信号的点对点连接。

#### 7.3.3.6 电源轨的电容器

建议确认已为 VDDSHV1 电源导轨和所连接器件 ( 内核和 IO 电源 ) 提供大容量电容器与去耦电容器 ( 若有建议则使用建议的电容，或遵循相关 SK 实现 ) 。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.3.3.7 OSPI0 或 QSPI0 外设接口实现检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 7.3.4 通用存储器控制器 (GPMC)

处理器系列支持 1 个通用内存控制器 (GPMCO) 实例，可使用 8 位或 16 位 NAND 闪存接口信号将其连接到 NAND 闪存，或使用处理器特定数据表和器件比较表列出的支持并行内存接口 ( 同步或异步 ) 选项将其连接到 NOR 闪存。

通用存储器控制器是一个统一的存储器控制器，专用于与外部存储器器件连接，例如：

- 类似 SRAM 的异步存储器和应用特定集成电路 (ASIC) 器件
- 异步、同步和页面模式 ( 仅在非多路复用模式下可用 ) 突发 NOR 闪存器件
- NAND 闪存
- 伪 SRAM 器件

有关支持的 GPMC 功能、各种访问类型和 GPMC 接口可以通信的各种外部器件，请参阅处理器特定 TRM 的内存接口一章通用内存控制器 (GPMC)一节。有关支持的信号，请参阅处理器特定 TRM 的 **GPMC I/O 信号**一节，处理器特定数据表的信号说明、**GPMC MAIN 域 GPMCO 信号说明**一节。

#### 7.3.4.1 IO 电源

用于 GPMC 接口的处理器 IO 以 VDDSHV3 电源导轨 ( IO 组 3 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 ) 。

建议将所连接器件的 VDDSHV3 和 IO 电源轨连接到同一电源。

所连接器件的 VDD ( 内核电压 ) 可从 ( 由 ) 独立电源 ( 不同的电源 ) 供电。

#### 7.3.4.2 GPMC 接口

建议验证使用的内存接口配置和连接到 GPMC 接口的所连接器件数量。

建议在同步模式下配置时将 GPMC 接口连接到 1 ( 单 ) 个器件。使用多个所连接器件或 (CSn) 时需要拆分板载 GPMC 时钟 ( 和其他接口信号 ) ，这会导致信号完整性问题，影响性能。

在异步模式下连接多个器件时，建议进行详细的时序分析。在异步模式下连接多个器件时，必须将控制信号路由到多个器件。拆分路由和负载 ( 布线长度和器件数量 ) 定制电路板性能。

#### 7.3.4.3 信号连接

建议为 GPMCO\_CLK 连接一个串联电阻器 (  $0\Omega$  ) ( 靠近处理器时钟输出引脚，以控制可能的信号反射 ) ，为 GPMCO\_CLK 连接外部下拉电阻器 (  $10k\Omega$  ) ( 靠近所连接器件时钟输入引脚 ) ，以将所连接器件保持在低电平状态 ( 在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态停止或暂停，并且下拉选项与该逻辑状态一致 ) 。

建议在 GPMCO\_CSn0-3 ( 取决于配置 ) 上配置一个外部上拉电阻器 (  $10k\Omega$  ) ，以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态。

建议为 GPMC 地址和数据接口信号配置一个外部拉电阻器 (  $10k\Omega$  ) ，以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态。

#### 7.3.4.3.1 GPMC NAND

NAND 闪存的高电平有效就绪和低电平有效繁忙 (R/B#) 输出为漏极开路输出类型信号，并连接到 GPMCO\_WAIT0 和 GPMCO\_WAIT1 信号 ( 取决于配置 ) 。建议在靠近所连接器件处添加上拉电阻器 ( 通常使用  $10k\Omega$  值 ) 。

#### 7.3.4.4 存储器 ( 连接的器件 ) 复位

如果使用采用 GPMC 接口的 NAND 闪存或 NOR 闪存时，复位输入的可用性取决于所选的存储器件。

如果支持复位引脚，建议检查所需的复位配置并将相关外部复位输入信号连接到内存复位输入引脚，包括实现 2 输入“与运算”逻辑。在复位引脚上添加一个上拉电阻器可在电压斜坡期间使能内存，不建议这样做。

#### 7.3.4.5 电源轨的电容器

建议确认已为 VDDSHV3 电源导轨和所连接器件 ( 内核和 IO 电源 ) 提供大容量电容器与去耦电容器 ( 若有建议则使用建议的电容，或遵循相关 SK 实现 ) 。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.3.4.6 GPMC 接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 7.4 外部通信接口 ( 以太网 (CPSW3G0)、USB2.0、PRUSS、UART 和 MCAN )

#### 备注

请参阅有链接的部分，了解如何实现串联电阻器和并联拉电阻器：[处理器特定 SK 与数据表](#)。

### 7.4.1 以太网(MAC) 接口

处理器系列支持 2(两)个具有单独 MAC ID 的独立以太网接口(使用 CPSW3G0 外设)。每个 MAC 接口均支持 RGMII 或 RMII 接口。

有关以太网接口的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6442、AM6441、AM6422、AM6421、AM6412、AM6411 和 AM2434、AM2432、AM2431 (ALV、ALX) 定制电路板硬件设计 - 以太网

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP) AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 RGMII 接口和 RGMII TI EPHY 相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 RMII 接口和 RMII TI EPHY 相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：以太网 PHY RGMII 同步时钟

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

#### 7.4.1.1 通用平台 3 端口千兆位以太网交换机(CPSW3G0)

该处理器系列支持 1 个 CPSW3G0 以太网交换机实例(带 2 个外部端口)，它可以配置为 3 端口交换机(连接到 2 个外部以太网端口(端口 1 和 2))或具有各自 MAC 地址的双独立 MAC 接口。

CPSW3G0 支持每个外部以太网接口端口的 RGMII (10/100/1000) 或 RMII (10/100) 接口。在 RGMII 接口中，TD<sub>x</sub>(由处理器传输的数据)数据路径和 RD<sub>x</sub>(由处理器接收的数据)数据路径彼此完全独立，其中每个路径都有自己的可执行源同步数据传输的时钟和数据信号。

##### 7.4.1.1.1 IO 电源

处理器 MAC 接口(CPSW3G0)信号(IO，用于带 EPHY 的以太网接口)以 VDDSHV2 电源导轨(IO 组 2 的 IO 电源)为基准(由其供电)。建议将所连接器件(EPHY)的 VDDSHV2 和 IO 电源导轨连接到同一电源。

所连接器件(EPHY)的 VDD(内核电压)可从(由)独立电源(不同的电源)供电。

##### 7.4.1.1.2 MAC(数据、控制和时钟)接口信号连接

建议为处理器以太网 MAC 接口信号配置串联电阻(0Ω)(对于 TD<sub>x</sub> 信号，建议将其放置在处理器 MAC 接口引脚附近)。建议使用尽可能小的封装(0402 或更小)并将串联电阻器靠近源极放置。可以在测试期间调整电阻值。对于 RD<sub>x</sub> 信号，可以使用 EPHY 提供的内部阻抗控制(如果 EPHY 支持)选项。建议在空间不受限制或 EPHY 不支持内部阻抗控制的情况下，在 RD<sub>x</sub> 信号上提供外部串联电阻(0Ω)配置。

EPHY 的中断输出可以连接到处理器 EXTINT<sub>n</sub>(中断)引脚。建议为 EXTINT<sub>n</sub> 连接一个靠近处理器的上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)。

##### 7.4.1.1.3 EPHY 复位

可以使用 3 输入“与运算”逻辑来实现所连接器件(EPHY)复位。处理器 GPIO(用于本地复位 EPHY)连接到“与运算”逻辑与门输入，在输入端附近提供上拉电阻器(10kΩ 或 47kΩ)(以支持引导)和 0Ω 配置，以隔离 GPIO 用于测试或调试。与门的另外两个输入是 MAIN 域 POR(冷复位)状态输出(PORz\_OUT)或 MAIN 域热复位状态输出(RESETSTATz)。

如果双输入“与运算”逻辑被视为 PORz\_OUT(加电时的引脚搭接)或者 RESETSTATz 可作为其中一个输入连接，处理器 GPIO 输入作为另一个(第二个)输入连接。当使用超过(2 个)EPHY 时，建议提供单独复位 EPHY 的配置。

根据 EPHY 复位输入极性，可使用“与运算”逻辑输出处的上拉或下拉电阻器（ $10\text{k}\Omega$ ）。时钟有效后，EPHY 需要在一段指定的最短时间内保持复位状态。

如果处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 直接用于复位 EPHY ( 所连接设备 ) ，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与已连接器件相匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，EPHY 复位输入的上升和下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

#### 7.4.1.1.4 以太网 PHY ( 和 MAC ) 运行和媒体独立接口 (MII) 时钟

建议匹配 EPHY 和处理器的时钟规范。

##### 7.4.1.1.4.1 晶体用作处理器和 EPHY 的时钟源

当使用晶体作为 EPHY 的时钟源时，建议将晶体 ( 时钟 ) 规范与处理器时钟规范相匹配。

##### 7.4.1.1.4.2 用作时钟源的外部振荡器

外部 (LVCMS) 振荡器可用作处理器 ( 和 EPHY ) 的时钟源。可以使用 1 ( 单 ) 个振荡器或多个振荡器 ( 每个 EPHY 和处理器都有单独的振荡器 ) 。使用 1 ( 单 ) 个振荡器时，建议在连接到处理器和 EPHY 之前缓冲振荡器时钟输出 ( 对每个所连接器件时钟输入使用单独的缓冲器 ) 。

单通道 ( 具有单输入和单输出 ) 缓冲器或具有双路或多路输出缓冲器的单输入可用于将振荡器的时钟输出连接到处理器和 EPHY 。对于特定用例 ( 使用时间敏感网络 (TSN) 的某些工业应用的要求 ) ，建议将单输入和两个或更多输出 ( 根据所使用的 EPHY 数量 ) 缓冲器用于处理器和 EPHY 。

建议确认根据建议的指南连接 EPHY 的 XO 。

##### 7.4.1.1.4.3 处理器时钟输出 (CLKOUT0)

为了优化定制电路板设计，处理器时钟输出 (CLKOUT0) 可用作 EPHY 的时钟源 ( 输入 ) 。CLKOUT0 在内部进行缓冲，旨在连接在点对点时钟拓扑中。建议在连接到所连接器件 (EPHY) 的时钟输入之前 ( 单独 ) 对 CLKOUT0 进行缓冲。建议在 CLKOUT0 的源极端安装一个串联电阻器 ( $0\Omega$ ，测试后调整)，以控制可能的信号反射。

使用 RGMII 接口的 EPHY 需要一个与任何其他信号不同步的  $25\text{MHz}$  时钟输入。 $25\text{MHz}$  时钟不会有任何时序要求，但需要确保 EPHY 不在时钟输入端接收任何非单调转换。

当 EPHY 配置用于 RMII 接口时，时钟选项取决于 EPHY 配置。

EPHY 配置为控制器时，许多 RMII EPHY 使用一个与任何其他信号不同步的  $25\text{MHz}$  输入时钟， $25\text{MHz}$  时钟信号不会有任何时序要求，但务必要确保 EPHY 在其时钟输入端不接收任何非单调转换。

RMII EPHY 为 MAC 提供  $50\text{MHz}$  时钟输出。在 RMII 用例中，相对于 EPHY， $50\text{MHz}$  数据传输时钟会延迟 ( 硬件延迟 ) 传递至 MAC 。延迟会转换时钟数据时序关系，从而会减小时序裕量。如果延迟大，逐斜缩小的时序裕度可能会对某些设计造成问题。

EPHY 配置为器件时，MAC 和 EPHY 使用一个与发送和接收数据同步的  $50\text{MHz}$  公共时钟。 $50\text{MHz}$  时钟在 RMII 规范中定义为供 MAC 和 EPHY 使用的通用数据传输时钟信号，这种情况下，转换预计会同时到达 MAC 和 EPHY 器件引脚。通用时钟可以为发送和接收数据传输提供更好的时序裕量。需要确保 MAC 和 EPHY 不会在时钟输入端接收任何非单调转换。为了控制时钟信号完整性，建议通过单输入、双输出相位对齐缓冲器路由通用时钟信号。建议使用与  $\frac{1}{2}$  数据信号长度等长的信号布线来连接时钟缓冲器输出，其中一个时钟输出连接到 MAC，另一个连接到 EPHY 。

对于 RMII 接口，建议的配置 RMII 接口典型应用 ( 外部时钟源 ) 在处理器特定 TRM 中介绍。当使用 RMII 接口典型应用 ( 内部时钟源 ) 配置时，建议在板级别验证性能。建议提供配置用于连接外部时钟，以进行初始性能测试以及与内部时钟比较。

在处理器和 EPHY ( 用在 SK 板上 ) 上使用  $25\text{MHz}$  时钟频率验证了以太网性能 (RGMII) 。

可以使用 CLKOUT0 为处理器 (MAC) 和 EPHY 提供  $25\text{MHz}$  或  $50\text{MHz}$  时钟。在软件配置时钟输出后，CLKOUT0 输出可用。在需要支持以太网引导时，不建议使用 CLKOUT0 配置。只要更改配置，作为 EPHY 时钟输入连接的 CLKOUT0 就可能出现故障。

对于 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列，WKUP\_CLKOUT0 是 MCU\_OSC0\_XO 的缓冲输出，在处理器复位后提供。时钟输出在时钟开始切换后不会出现故障。但是，第一个高电平脉冲或低电平脉冲可能很短，因为复位是与 MCU\_OSC0 时钟异步释放的。

对于 AM62Px 系列处理器，需要配置 WKUP\_CLKOUT0 以提供处理器参考时钟 (MCU\_OSC0\_XO)。时钟输出在时钟开始切换后不会出现故障。但是，第一个高电平脉冲或低电平脉冲可能很短，因为复位是与 MCU\_OSC0 时钟异步释放的。

处理器特定数据表中未定义处理器时钟输出性能，因为时钟性能可能会受到每种定制电路板设计所特有的许多变量的影响。建议定制电路板设计人员使用实际 PCB 延迟、最小或最大输出延迟特性以及每个器件的最低建立和保持要求来验证所有外设的时序，以确认是否有足够的时序裕量。

#### 7.4.1.1.5 以太网 PHY 引脚配置 (strap)

部分 TI EPHY 在复位期间将输出配置为输入，并在释放 EPHY 复位时在将 EPHY 配置锁存（通过电阻器完成引脚绑定）。建议在硬件配置引脚输入 (IO) 上应用适当的上拉或下拉（根据 EPHY 的建议）（硬件配置引脚输入 (IO) 同样连接到处理器 IO）。处理器特定 SK 上使用的 TI EPHY 结合使用了上拉和下拉电阻，从而可以使用每个引脚来配置多种配置模式。在处理器复位期间，IO 缓冲器和内部上拉或下拉电阻处于禁用状态，并尽可能减少了 EPHY 向处理器输入缓冲器施加  $1/2 \text{ Vs}$  电压的问题。启用任何相关的处理器输入缓冲器之前，需要将 EPHY 从复位状态配置为正常状态，以驱动有效的逻辑状态。

#### 7.4.1.1.6 外部中断 (EXTINTn)

EXTINTn 是一种开漏输出类型失效防护 IO 缓冲器。当连接 PCB 布线并且外部输入未被主动驱动时，建议连接外部上拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ )。漏极开路输出类型 IO 缓冲器在上拉至  $3.3\text{V}$  时具有指定的转换率要求。建议使用 RC ( 延迟 ) 来限制输入转换率。建议将该电容器放置在靠近处理器引脚的位置。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62L/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 — EXTINTn 引脚上拉连接](#)

#### 7.4.1.1.6.1 外部中断 (EXTINTn) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 7.4.1.1.7 MAC ( 介质访问控制器 ) 到 MAC 接口

在 2 个处理器之间实现无 EPHY ( MAC 至 MAC ) 连接时，建议使用 RGMII 接口（请与 TI 联系以了解所选处理器系列上官方是否支持 MAC 至 MAC 接口），因为时钟可进行源同步。

当实现 2 个处理器之间的 MAC 至 MAC 接口时，建议验证失效防护运行情况、时钟规格匹配以及 IO 级兼容性。

#### 7.4.1.1.8 MDIO ( 管理数据输入/输出 ) 接口

用于 MDIO 接口的处理器 IO 以 VDDSHV2 电源导轨 ( IO 组 2 的 IO 电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。

建议为 MDIO0\_Mdio ( MDIO 数据 ) 信号连接外部上拉电阻器 ( $2.2\text{k}\Omega$  ( 遵循 EPHY 建议 ) 靠近 EPHY )。

对于 MDIO\_MDC，建议验证 EPHY 是否支持内部拉电阻器 ( 下拉电阻器 )。在配置 MDIO 接口之前，请参阅公告文章 [i2329 MDIO : AM62x 处理器系列器件勘误表的 MDIO 接口损坏 \(CPSW 和 PRU-ICSS\)](#)。

#### 7.4.1.1.9 包括磁性元件在内的以太网 MDI ( 介质相关接口 )

如果在处理器板上实现了包括磁性元件和 RJ45 连接器在内的 EPHY 和 MDI 接口 ( 铜或光纤 )，建议遵循 MDI 接口连接的 SK 实现方案、推荐的磁性元件 ( SK 或类似方案上推荐使用的磁性元件 ) 以及 RJ45 连接器屏蔽层连接至电路接地。建议提供外部 ESD 保护。

#### 7.4.1.1.10 电源轨的电容器

建议确认已为 VDDSHV2 电源导轨和所连接器件 ( 内核、模拟和 IO 电源 ) 提供大容量电容器与去耦电容器 ( 若有建议则使用建议的电容，或遵循相关 SK 实现 )。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.4.1.1.11 以太网接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 7.4.2 通用串行总线 (USB2.0)

该处理器系列支持 2 ( 两 ) 个 USB 2.0 接口端口实例。这些 USB 接口 ( USB0、USB1 端口 ) 可以配置为主机、器件或双角色器件 (DRD)。

建议按照处理器特定数据表的 *USB 设计指南*一节连接 **USBn\_VBUS** ( $n = 0-1$ )。处理器特定数据表的 *建议运行条件*一节中定义了 **USBn\_VBUS** 引脚的电源电压范围。当 **VBUS** 电源电压电平为 5V 时，施加的标称输入电压等于电阻分压器输出。

使用任何处理器 GPIO 都可实现 **USBn\_ID** 功能。

---

#### 备注

**USBn\_VBUS** 为失效防护输入。失效防护输入仅在 **VBUS** 电源通过建议的 *USB VBUS 检测分压器/钳位电路连接*时才有效。

---

#### 7.4.2.1 使用时 **USBn** ( $n = 0-1$ ) 接口

建议将 USB 电源 **VDDA\_CORE\_USB** ( USB0 和 USB1 内核电源 ) 、**VDDA\_1P8\_USB** ( USB0 和 USB1 1.8V 模拟电源 ) 和 **VDDA\_3P3\_USB** ( USB0 和 USB1 3.3V 模拟电源 ) 连接到处理器特定数据表中推荐的电源导轨。

建议直接连接 **USBn\_DM** ( $n=0-1$ ) 与 **USBn\_DP** ( $n=0-1$ ) 信号 ( 无需任何串联电阻器或滤波电容器 )。建议使用不包含任何残桩或测试点的布线对 **USBn** 信号进行布线。

在 **USBn\_RCALIB** ( $n = 0-1$ ) 引脚 ( 靠近处理器 **RCALIB** 引脚 ) 与 **VSS** 之间连接一个校准电阻器。有关建议电阻值和容差，请参阅处理器特定数据表。

##### 7.4.2.1.1 配置为主机的 USB 接口

建议实现 USB 电源开关来控制外部连接的 USB 器件的 **VBUS** 电源。电源开关可保护板载电源免于过载 ( 过多电流消耗 )。

电源开关输出连接到 USB Type-A 连接器。建议将电容器 ( 最小值  $> 120 \mu F$  ) 连接到靠近连接器的 **VBUS** 电源上。

**USBn\_DRVVBUS** ( $n = 0-1$ ) 信号 ( 复位期间和复位后内部下拉使能 ) 可用于使能 **VBUS** 电源开关。不建议在电源开关使能 (EN) 引脚附近使用外部上拉电阻器。外部下拉电阻器 ( $10k\Omega$ ) 是可选的。

建议使用具有 OC ( 过流 ) 指示的 USB 电源开关，添加上拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$  ) 并连接到处理器 IO ( 输入 ) 以检测 **VBUS** 过载。

**USBn\_VBUS** 的连接 ( **VBUS** 电源输入，包括分压器、钳位 ) 输入是可选的 ( 不是必需 )。

##### 7.4.2.1.2 配置为器件的 USB 接口

**VBUS** 电源从外部主机供电。USB 标准建议将  $< 10 \mu F$  的电容器连接到靠近 USB B 型连接器的 **VBUS**。

建议在连接到 **USBn\_VBUS** 引脚之前，按照处理器特定数据表的 *USB VBUS 设计指南*一节对 **USB VBUS** 电压进行分压 ( 使用电阻分压器和齐纳二极管保护的 USB 接口连接器附近的电源 )。

如果定制电路板设计人员完全确定电路板不会遇到  $> 5.5V$  ( 板载供电 ) 的 **VBUS** 电压，则可以将齐纳二极管保护 ( 建议 ) 视为可选。

不建议也不允许使用等效分压器连接不开关 ( 固定 ) 的板载电源，或连接 3.3V 永久电源，或将永久 1.65V 直接连到 **USBn\_VBUS**。建议使用可在会话结束时断开并在下一个会话开始时重新开启的开关电源。

##### 7.4.2.1.3 USB 接口配置为双角色器件

如果定制板使用 USB Micro-AB 连接器，建议将来自连接器的 **USBn\_ID** 信号路由到任意处理器引脚。该 GPIO 引脚可在电路板器件树文件中指定，包括 GPIO 引脚的引脚多路复用 (pinmux) 设置。

**备注**

不支持完全兼容的 USB On-The-Go (OTG) 特性。USB ID 引脚未进行外部键合。

**7.4.2.1.4 USB Type-C**

如果定制电路板设计使用 USB Type-C® 连接器，则不要求 USBn\_ID 信号连接。DRD 模式开关由 USB Type-C 配套器件控制。

DRP ( 双角色端口 ) 需要一个控制器，主要用于根据协商的角色切换电源。在器件不是由 USB Type-C 连接器供电的 USB Type-C 实现方案 ( 仅限器件模式、USB2.0 ) 中，无需 USB Type-C 控制器。

- 连接器上的 CC 引脚需要通过  $5.1\text{k}\Omega$  电阻独立接地。
- USB DP 和 USB DM 连接器引脚在 PCB 上短接 ( DM=B7:A7 , DP=B6:A6 ) 。无论电缆方向如何，短接都能实现 USB2.0 连接。建议将产生的桩线保持较短。

有关 USBn\_VBUS 输入调节建议的更多信息，请参阅处理器特定数据表的 *USB VBUS 设计指南*一节。

AM62x SK USB0 接口设计可用作实现 USB Type-C 接口的参考。

请参阅以下常见问题解答：

**[常见问题解答] SK-AM62A-LP : 没有 PD 控制器是否可以实现 USB OTG ?**

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x ( AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP ) AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

**7.4.2.2 不使用时的 USBn (n = 0-1) 接口**

当定制电路板设计中不使用 USB0 和 USB1 接口时，建议提供连接 USB0 接口上 USB 接口信号 ( 用于支持的 USB 引导配置 (USB0 - DFU) ) 的配置，并添加连接初始电路板构建所需处理器 USB 电源的配置。

当不使用 USB0 和/或 USB1 时，接口信号和电源有特定的连接要求。

如需连接 USB0 和 USB1、接口信号和电源引脚，请参阅处理器特定数据表的 *引脚连接要求*一节。

建议通过单独的  $0\Omega$  电阻将 USB 电源 ( VDDA\_CORE\_USB、VDDA\_1P8\_USB 和 VDDA\_3P3\_USB ) 连接到 VSS。

如果计划使用 USB0 或 USB1 进行未来扩展，建议按照 USB 接口路由指南将信号 ( USBn\_DM、USBn\_DP、USBn\_RCALIB 和 USBn\_VBUS ) 连接到 USB 连接器。建议提供连接所需的电源的配置。

**7.4.2.3 其他信息**

建议将 USBn\_DM 和 USBn\_DP 信号直接从处理器连接到 USB 集线器上游端口。然后，集线器将 USBn 信号分配到下行端口。由于每个集线器的实施要求不同，建议遵循集线器制造商的建议。

有关 USB2.0 接口更多信息，请参阅以下常见问题解答：

**[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP : 定制电路板硬件设计 - USB2.0 接口**

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

**[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问**

**7.4.2.4 USB 接口检查清单**

请参阅处理器系列特定用户指南的 *用户指南系列*一节。

**7.4.3 可编程实时单元子系统 (PRUSS)**

#### 7.4.3.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP

一些 OPN 支持 PRUSS 功能。有关 PRUSS 特性和支持的功能的可用性，请参阅处理器特定数据表的 器件比较一节。

凭借 PRU 内核的可编程特性以及对引脚、事件和所有处理器资源的访问权限，设计人员可以灵活地实现快速实时响应、专用数据处理操作以及定制外设接口，并灵活地减轻器件其他处理器内核的任务负载。

PRUSS 具有大量可用的 IO 信号。大多数 IO 在处理器级别与其他功能（信号）进行多路复用。PRUSS 引脚允许使用 PADCONFIGx 寄存器进行多路复用。

建议在定制电路板原理图设计过程中确认接口连接支持所需的功能。

要了解 PRUSS 支持的功能，请参阅处理器特定数据表和 TRM。

##### 7.4.3.1.1 PRU 子系统

PRU 子系统是一种运行速率高达 333MHz 的双核可编程实时单元子系统 (PRUSS)。

PRU 子系统用于驱动 GPIO 以实现周期精确的协议，例如：

- 通用输入/输出 (GPIO)
- 通用异步收发器 (UART)
- 内部集成电路 (I2C)
- 外部 ADC 接口

##### 7.4.3.1.2 PRUSS 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 7.4.3.2 AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px

不支持

#### 7.4.4 通用异步收发器 (UART)

##### 备注

处理器外设 (UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C) 实现了 IOSET。建议在定制电路板设计中验证和使用正确的 IOSET。该接口的时序闭合基于 IOSET。

该处理器系列支持 9 (九) 个 (7 个 MAIN 域、1 个 MCU 域、1 个 WKUP 域) UART 接口实例，支持的功能包括数据传输 (TXD、RXD)、调制解调器控制功能 (CTS、RTS) 和扩展调制解调器控制信号 (DCD、RI、DTR、DSR — 由 MAIN 域 UART1 支持)。

有关支持的 UART 实例数，请参阅处理器特定数据表。每个 UART 实例支持的功能，建议参阅处理器特定数据表的 [信号说明](#)一节。

建议验证 UART 接口 (外部通信接口或调试) 和功能 (配置，2 线或 4 线带流量控制) 的应用要求。

使用外部 RS232 收发器时，建议使外部接口信号 IO 电平与 IO 组工作电压电平的双电压 IO 电源匹配。建议利用同一电源为外部收发器的 IO 电源与 IO 组 VDDSHVx 的处理器 IO 电源供电。建议验证 UART 输入的失效防护运行情况以及连接到外部拉电阻器的电压电平。

建议在接口信号上靠近源极的位置配置串联电阻器 ( $0\Omega$ )，用于隔离 (调试) 或控制可能的信号反射。

在复位期间和复位之后，处理器 IO 缓冲器是 (TX (输出) 和 RX (输入) 和内部拉电阻器 (上拉和下拉电阻器)) 关闭。建议在处理器 UART 接收输入 (UARTn\_RXD [n = 0-6]、MCU\_UART0\_RXD 和 WKUP\_UART0\_RXD) 上使用上拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ )，以防处理器 IO 可能悬空 (以防止所连接器件输出在由主机驱动之前处于悬空状态)。建议验证外部接口信号上拉电阻器的可用性，并相应地安装拉电阻器。建议对处理器 UART 发送信号 (UARTn\_TXD [n = 0-6]、MCU\_UART0\_TXD 和 WKUP\_UART0\_TXD) 使用上拉电阻器 ( $47k\Omega$ )，以防处理器或所连接器件输出可能悬空。

使用 UART 接口时观察到的常见错误之一是 UART 接口信号极性相反。建议按如下方式连接信号：

- TX 到 RX
- RX 到 TX

建议在使用额外的 UART 接口流控制信号时验证连接、IO 电平和极性匹配。

当外部 UART 接口信号直接连接到处理器 UART 接口时，建议验证 IO 电平兼容性和失效防护运行。建议为外部 ESD 保护提供配置。

建议为早期电路板构建配置连接 UART 引导 (UART0)，以便进行电路板启动和调试。

#### 7.4.4.1 不使用时的 UART 接口

当未在定制电路板设计中实现 UART 接口时，建议提供连接外部 UART 接口信号的配置，以进行调试。建议在配置 UART 接口信号时遵循以下优先级：

- UART0
- MCU\_UART0
- WKUP\_UART0

建议在处理器板上添加 TP，用于连接外部输入。建议为可能悬空的 IO 提供并联拉电阻器 ( $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$ ) ( 以防止所连接器件输入在由主机驱动之前处于悬空状态 )。建议添加外部 ESD 保护，在使用 UART 接口时可以安装该保护功能。

UART 接口信号不具备失效防护。在处理器电源斜升之前，建议不施加任何外部输入 ( UART 接口信号 )。

#### 7.4.4.2 通用异步接收器/发送器 (UART) 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 7.4.5 模块化控制器局域网 (MCAN)，具有完整 CAN-FD 支持

#### 备注

处理器外设 ( UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C ) 实现了 IOSET。建议在定制电路板设计中验证和使用正确的 IOSET。该接口的时序闭合基于 IOSET。

AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列支持 3 ( 三 ) 个 ( 1 个主域、2 个 MCU 域 ) 实例，AM62Px 处理器系列支持具有完全 CAN-FD 支持的模块化控制器局域网 (MCAN) 的 4 ( 四 ) 个 ( 2 个主域、2 个 MCU 域 ) 实例。

MCAN 模块支持传统 CAN 和 CAN FD ( 具有灵活数据速率的 CAN ) 规范。

MCAN 接口，通过外部 MCAN 收发器连接到支持 MCAN 接口的所连接器件。

使用外部收发器时，建议使外部接口信号 IO 电平与 IO 组电压电平的双电压 IO 电源匹配。建议使用同一电源为收发器的 IO 电源和处理器 IO 电源轨供电。

建议在接口信号上靠近源极的位置配置串联电阻器 ( $0\Omega$ )，用于隔离 ( 调试 ) 或控制可能的信号反射。在复位期间和复位之后，处理器 IO 缓冲器是 ( TX ( 输出 ) 和 RX ( 输入 ) 和内部拉电阻器 ( 上拉和下拉电阻器 ) ) 关闭。如果处理器或所连接器件的输出可以悬空，建议对处理器 MCAN 发送 ( 接收 ) 信号使用上拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ )。

建议为 MCAN 收发器外部接口输入提供建议的端接。

#### 7.4.5.1 模块化控制器局域网检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 7.5 板载同步通信接口 ( MCSPI、MCASP 和 I2C )

## 7.5.1 多通道串行外设接口 (MCSPI) 和音频外设 - 多通道音频串行端口 (MCASP)

### 备注

处理器外设 (UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I2C) 实现了 IOSET。建议在定制电路板设计中验证和使用正确的 IOSET。该接口的时序闭合基于 IOSET。

#### 多通道串行外设接口 (MCSPI) :

该处理器系列支持 x5 (五个) (x3 主域、x2 MCU 域) MCSPI 实例。MCSPI 模块是多通道发送/接收同步串行总线，可以在控制器模式或外设模式下运行。在控制器模式下，处理器 SPI 接口向附加器件提供时钟信号。在外设模式下，附加器件需要为处理器提供 SPI 时钟源。

建议为 MCSPI 时钟输出信号使用串联一个  $22\Omega$  电阻器 (作为起点)。建议将该电阻放置在靠近处理器时钟输出引脚的位置 (用于重定时)。建议在所连接器件时钟输入引脚附近使用下拉电阻器 ( $10k\Omega$ )。对于靠近所连接器件的芯片选择 (CS) 引脚，建议使用上拉电阻器 ( $10k\Omega$ )。

MCSPI 外设不支持引导。OSPI0 接口支持 SPI 引导。

对于 MCSPI 接口，SPIx\_D0 和 SPIx\_D1 为数据线路。数据线支持将信号编程为发送数据 (发送、输出) 或接收数据 (接收、输入)。

在复位期间和复位之后，处理器 IO 缓冲器是 (TX (输出) 和 RX (输入) 和内部拉电阻器 (上拉和下拉电阻器)) 关闭。建议为处理器或所连接器件的数据线使用并联拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ )，它可能悬空 (以防止所连接器件输入在由主机驱动之前处于悬空状态)。

建议将 SPI 接口连接到 1 (单) 个存储器器件。连接到多个存储器件时，建议遵循高速设计实践并执行仿真，以确保当单个时钟源连接到多个连接 SPI 的器件时，布局不会产生非单调时钟转换。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] SK-AM64B : MCSPI 集成指南

[常见问题解答] AM6412 : AM64x SPI D0 和 D1 - MISO/MOSI

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP) AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

#### 音频外设 - 多通道音频串行端口 (MCASP) :

该处理器系列支持 3 (三) 个 (3 个 MAIN 域) 音频外设实例 - 多通道音频串行端口 (MCASP)。3 个 MCASP 支持多达 4/6/16 个串行数据引脚 (串行器) 并具有独立的 TX 和 RX 时钟。MCASP 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式。建议为 MCASP 时钟输出使用  $22\Omega$  串联电阻器 (作为起点)。建议将该电阻放置在靠近处理器时钟输出引脚的位置 (用于重定时)。建议在所连接器件时钟输入引脚附近使用下拉电阻器 ( $10k\Omega$ )。

在复位期间和复位之后，处理器 IO 缓冲器是 (TX (输出) 和 RX (输入) 和内部拉电阻器 (上拉和下拉电阻器)) 关闭。建议为处理器或所连接器件的数据线使用并联拉电阻器 ( $47k\Omega$ )，它可能悬空 (以防止所连接器件输入在由主机驱动之前处于悬空状态)。

MCASP 作为通用音频串行端口，的针对各种音频应用的要求进行了优化。MCASP 模块可以在发送和接收模式下运行。MCASP 对于时分多路复用 (TDM) 流、IC 间音频 (I2S) 协议接收和发送以及元件间数字音频接口传输 (DIT) 非常有用。MCASP 可以灵活地无缝连接到 Sony/Philips 数字接口 (S/PDIF) 传输物理层元件。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L 设计建议/定制电路板硬件设计 - 与 MCASP 相关的疑问

### 7.5.1.1 MCSPI 和 MCASP 接口信号的连接

对于 MCSPI 接口，建议靠近处理器时钟输出引脚（处理器 MCSPI 配置为控制器）为 SPI 时钟输出信号 SPI0..2\_CLK (MCSPI 0..2) 和 MCU\_SPI0..1\_CLK (MCU\_MCSPI 0..1) 提供串联电阻器 ( $22\Omega$ )，因为时钟输出用于重定时。

对于 MCASP 接口，建议靠近处理器时钟输出引脚（处理器 MCASP 配置为时钟源）为发送时钟（发送位时钟）输出信号 MCASP0..2\_ACLKX 和发送帧同步信号 MCASP0..2\_AFSX 提供串联电阻器 ( $22\Omega$ )，因为时钟输出用于重定时。

建议为针对 MCSPI 和 MCASP 接口配置的所有 IO 添加一个下拉电阻器 ( $10k\Omega$ )（靠近所连接器件时钟输入引脚），以将所连接器件保持在低电平状态（在某些情况下，时钟在低电平逻辑状态下停止或暂停，并且下拉电阻器选项与该逻辑状态一致）。

建议为接收器时钟（接收位时钟）输出信号 MCASP0..2\_ACLKR 与接收帧同步信号 MCASP0..2\_AFSR（靠近所连接器件）配置串联电阻器 ( $22\Omega$ )。

在复位期间和复位之后，对于许多处理器 IO ( LVC MOS 或 SDIO )，IO 缓冲器 TX ( 输出 ) 和 RX ( 输入 ) 被禁用，并且内部拉电阻器（上拉和下拉电阻器）被关闭。建议验证是否为 SPI 片选 SPI0..2\_CS0..3 (MCSPI 0..2) 和 MCU\_SPI0..1\_CS0..3 (MCU MCSPI 0..1) 提供了外部上拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ )（靠近所连接器件）。建议向处理器添加拉电阻器 ( $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ ) 和可悬空的所连接器件信号（数据接口 - 数据输入、数据输出）（以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态）。

允许将两 (2) 个或更多器件（通用的时钟连接、不同的数据信号连接，同时工作）连接到 MCASP 接口。

MCASP 可以配置为使发送和接收段与发送段时钟和发送帧同步信号同步工作。如果使用专用串行器，则所有目标器件的 BCLK 和帧同步需要相同，如果使用 TDM，则不是问题。在定制电路板设计期间，需要考虑信号质量/信号反射的电势（从单个 MCASP 时钟输出驱动多个输入导致的信号反射）。

### 7.5.1.2 MCSPI 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

### 7.5.1.3 MCASP 接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

## 7.5.2 内部集成电路 (I<sup>2</sup>C)

### 备注

处理器外设 ( UART、MCAN、MCSPI、MCASP、I<sup>2</sup>C ) 实现了 IOSET。建议在定制电路板设计中验证和使用正确的 IOSET。该接口的时序闭合基于 IOSET。

该处理器系列支持 6 ( 六 ) 个 ( 2 ( 两 ) 个符合 I<sup>2</sup>C 规范的失效防护开漏输出型 IO 缓冲器和 4 ( 四 ) 个 LVC MOS 缓冲器类型模拟开漏输出型 IO ) I<sup>2</sup>C 接口实例。支持的 I<sup>2</sup>C 接口包括 4 个 MAIN 域 ( LVC MOS IO 缓冲器用于模拟开漏输出型 IO )、1 个 MCU 域 ( 符合 I<sup>2</sup>C 规范的开漏输出型 IO 缓冲器 ) 和 1 个 WKUP 域 ( 符合 I<sup>2</sup>C 规范的开漏输出型 IO 缓冲器 ) I<sup>2</sup>C 接口。

MCU\_I2C0 和 WKUP\_I2C0 接口是真正的开漏输出型 IO 缓冲器，具有失效防护且完全符合 I<sup>2</sup>C 规范（有关时序详细信息，请参阅 Philips I<sup>2</sup>C 总线规范版本 2.1）。

该处理器系列包括多控制器集成电路间 (I<sup>2</sup>C) 控制器，每个控制器均在本地主机 ( LH、AM62x 或 AM62Ax 或 AM62D-Q1 或 AM62Px 处理器 ) 与通过 I<sup>2</sup>C 总线连接的任何 I<sup>2</sup>C 总线兼容器件之间提供接口。

每个 I<sup>2</sup>C 实例均可配置为与 I<sup>2</sup>C 兼容的目标或控制器器件。I<sup>2</sup>C 接口可以使用专用的 I<sup>2</sup>C 兼容开漏输出型 IO 缓冲器，或使用标准 LVC MOS IO 缓冲器来实现。与开漏 IO 缓冲器相关的 I<sup>2</sup>C 实例支持 HS 模式（当 IO 缓冲器在 1.8V 下工作时最高数据速率可达 3.4Mbps，当 IO 缓冲器在 3.3V 下工作时最高数据速率可达 400Kbps）。与 LVC MOS IO 缓冲器关联的 I<sup>2</sup>C 实例支持快速模式（数据速率高达 400Kbps）。

### 7.5.2.1 I<sub>2</sub>C 接口信号连接

#### 备注

对于具有开漏输出型 IO 缓冲器 (MCU\_I2C0 和 WKUP\_I2C0) 的 I<sub>2</sub>C 接口，无论使用何种 IO 配置，都建议添加上拉电阻器 (4.7kΩ)。即使 I<sub>2</sub>C 接口 (外设) 未用于替代功能且预计会保持未连接状态，也建议使用外部上拉电阻器。

请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。建议为 I<sub>2</sub>C 接口使用上拉电阻器 (4.7kΩ，测试后调整)。I<sub>2</sub>C 接口支持时钟延展。时钟输出频率 (相对于设定的频率) 取决于总线负载。当在设定频率与测得的时钟频率之间观察到差异时，调整上拉电阻器 (减少) 并测量时钟频率。

当开漏输出型 IO 缓冲器 I<sub>2</sub>C 接口被拉至 3.3V 电源时，其指定了转换率要求。建议使用 RC (放置在处理器 I<sub>2</sub>C 接口引脚附近的电容器) 来限制转换率。有关 RC 实现，请参阅 AM64x EVM 原理图并参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM62L 定制电路板硬件设计过程中的设计建议/常见错误-SK 原理图设计更新说明](#)

有关更多信息，请参阅[将电源导轨连接到外部上拉电阻器](#)一节。

在需要多个 I<sub>2</sub>C 接口的应用中，可以考虑使用 I<sub>2</sub>C0、I<sub>2</sub>C1、I<sub>2</sub>C2 和 I<sub>2</sub>C3 接口。

I<sub>2</sub>C0、I<sub>2</sub>C1、I<sub>2</sub>C2 和 I<sub>2</sub>C3 接口使用 LVCMOS 类型 IO 缓冲器来模拟开漏输出型 IO，并且不完全符合 I<sub>2</sub>C 规范，尤其是下降沿的速度很快 (< 2ns)。请参阅处理器特定数据表中的异常 (对于 I<sub>2</sub>C0、I<sub>2</sub>C1、I<sub>2</sub>C2 和 I<sub>2</sub>C3 接口)。建议将一个串联电阻器 (47Ω，测试调整后) 放置在处理器附近，以便接口信号控制下降时间。建议在测试期间最终确定串联电阻器值。

当为 I<sub>2</sub>C 功能配置 IO 时，建议为 LVCMOS IO 使用上拉电阻器 (4.7kΩ，测试后调整)。建议使用最短的残桩连接上拉电阻器。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] [AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 - I<sub>2</sub>C 接口](#)

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 - I<sub>2</sub>C 接口](#)

[常见问题解答] [AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - I<sub>2</sub>C 接口](#)

[常见问题解答] [AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 : MCU\\_I2C0 和 WKUP\\_I2C0 的内部拉电阻配置寄存器](#)

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP) 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 系列处理器。

当计划使用 TI 提供的软件时，请将推荐的处理器 I<sub>2</sub>C 接口连接到 PMIC，因为 I<sub>2</sub>C0 是用于 PMIC 控制的接口。

#### 备注

当使用 I<sub>2</sub>C3 接口时，请参阅处理器特定数据表时序和开关特性、外设、I<sub>2</sub>C 一节中的 I<sub>2</sub>C3 注释 (I<sub>2</sub>C2 也在 AM62Px 系列处理器中) (可以多路复用到多个引脚)。

#### 备注

建议进行定制电路板设计期间，请查阅处理器特定数据表中时序和开关特性 - I<sub>2</sub>C 一节的异常小节。请注意模拟开漏输出型 IO I<sub>2</sub>C 接口的异常。建议添加串联电阻来控制下降时间。

### 7.5.2.2 I<sub>2</sub>C (开漏输出类型 IO 缓冲器) 接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

### 7.5.2.3 I<sub>2</sub>C (仿真开漏输出类型 IO) 接口检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

## 7.6 用户接口 (CSI-RX0、DPI、OLDI0、DSI)、GPIO 和硬件诊断

### 7.6.1 摄像头串行接口 (CSI-RX、CSI-2、CSI-RX0)

#### 7.6.1.1 AM62x 处理器系列

该处理器系列支持单路摄像头串行接口 (CSI-RX、CSI-2、CSI-RX0)，使用 D-PHY (DPHY、DPHY\_RX) 时支持 4 通道，并符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准和 MIPI D-PHY 1.2 标准 (CSI-RX0)。CSI-RX0 支持多达 4 通道 (单通道/双通道/3 通道/4 通道) 数据通道与 D-PHY (DPHY\_RX) 连接。有关支持的最高数据速率，请参阅处理器特定数据表特性一章中的多媒体、摄像头串行接口 (CSI-Rx) (使用 DPHY 时支持 4 通道) 一节。

DPHY\_RX (CSI-RX) 支持 1 个 (单) 时钟通道，所有数据通道的时钟频率均相同。帧速率由帧起始和帧结束信令决定，并允许每通道以不同的帧速率处理输入源。

#### 7.6.1.2 AM62Ax 处理器系列

该处理器系列支持单路摄像头串行接口 (CSI-RX、CSI-2、CSI-RX0) 实例，使用 D-PHY (DPHY、DPHY\_RX) 时支持 4 通道，并符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准和 MIPI D-PHY 1.2 标准 (CSI-RX0)。CSI-RX0 支持多达 4 通道 (单通道/双通道/3 通道/4 通道) 数据通道与 D-PHY (DPHY\_RX) 连接。有关支持的最大数据速率，请参阅处理器特定数据表特性一章中的带通道 D-PHY 的多媒体摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器一节。

DPHY\_RX (CSI-RX) 支持 1 个 (单) 时钟通道，所有数据通道的时钟频率均相同。帧速率由帧起始和帧结束信令决定，并允许每通道以不同的帧速率处理输入源。

CSI\_RX\_IF 没有专用引脚。在器件层，视频输入来自 DPHY\_RX。

#### 7.6.1.3 AM62D-Q1 处理器系列

该处理器系列支持 1 个摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器和 4 通道 D-PHY，用于通过 CSI-2 和 MIPI D-PHY 实现高速外部处理器数据接收接口。

CSI-2 支持 1 (单) 个时钟通道，所有数据通道的时钟频率均相同。

#### 备注

建议在定制电路板设计 (原理图和布局) 期间遵循 AM62Ax 实现一节。

#### 7.6.1.4 AM62Px 处理器系列

该处理器系列支持单路摄像头串行接口 (CSI-RX、CSI-2、CSI-RX0)，使用 D-PHY (DPHY、DPHY\_RX) 时支持 4 通道，并符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准和 MIPI D-PHY 1.2 标准 (CSI-RX0)。CSI-RX0 支持多达 4 通道 (单通道/双通道/3 通道/4 通道) 数据通道与 D-PHY (DPHY\_RX) 连接。有关支持的最大数据速率，请参阅处理器特定数据表特性一章中的带通道 D-PHY 的多媒体摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器一节。

DPHY\_RX (CSI-RX) 支持 1 个 (单) 时钟通道，所有数据通道的时钟频率均相同。帧速率由帧起始和帧结束信令决定，并允许每通道以不同的帧速率处理输入源。

#### 7.6.1.5 使用 CSIRX0 外设时

处理器 CSIRX0 外设以 VDDA\_CORE\_CSIRX0 (CSIRX0 内核电源) (AM62Px 为 VDDA\_CORE\_CSI\_DSI 和 VDDA\_CORE\_DSI\_CLK (CSIRX0 和 DSITX0 内核电源)) 和 VDDA\_1P8\_CSIRX0 (CSIRX0 1.8V 模拟电源) (AM62Px 为 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI (CSIRX0 和 DSITX0 1.8V 模拟电源)) 为基准 (由其供电)。

建议在 CSIO\_RXRCALIB (靠近处理器 RXRCALIB 引脚) 和 VSS 之间连接一个并联电阻器。有关建议电阻值和容差，请参阅处理器特定数据表。

有关 CSIRX0 的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625SIP/AM625-Q1/AM62Ax/AM62Px 定制电路板硬件设计 - CSI-2 功能

常见问题解答包含允许的数据通道和时钟通道交换相关信息。

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问

### 7.6.1.6 不使用时的 CSIRX0 外设

不使用时，CSIRX0 外设对接口信号和电源有特定的连接要求。

有关连接接口信号、电源（内核和模拟）的信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

使用边界扫描功能时，建议将 CSIRX0 ( AM62Px 的 CSIRX0 和 DSITX0 ) 电源 ( VDDA\_CORE\_CSIRX0 ( AM62Px 的 DDA\_CORE\_CSI\_DSI、VDDA\_CORE\_DSI\_CLK ) 和 VDDA\_1P8\_CSIRX0 ( AM62Px 的 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI ) ) 连接到相关（各自）的电源。建议在电源引脚上使用去耦电容器。大容量电容器和铁氧体是可选项。

不使用边界扫描功能（并且 AM62Px 不使用 DSITX0 接口）时，建议通过单独的  $0\Omega$  电阻器将 CSIRX0 ( AM62Px 的 CSIRX0 和 DSITX0 ) 电源 ( AM62Px 的 VDDA\_CORE\_CSIRX0 ( DDA\_CORE\_CSI\_DSI、VDDA\_CORE\_DSI\_CLK ) 和 VDDA\_1P8\_CSIRX0 ( AM62Px 的 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI ) ) 连接到 VSS。可以删除或移除去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。

未使用 CSIRX0 接口时，CSI0\_RXRCALIB 电阻器可以是 DNI。

### 7.6.1.7 CSIRX0 外设检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

## 7.6.2 显示子系统 (DSS)

### 7.6.2.1 显示并行接口 (DPI)

#### 备注

有关支持的数据格式（包括 BT656）的信息，请参阅处理器特定数据表和 TRM。

#### 7.6.2.1.1 AM62x (AM625、AM623、AM625-Q1、AM625SIP)、AM62Ax 和 AM62Px 处理器系列

该处理器系列支持每像素 1 个 24 位、RGB/YUV422 模式、LVCMS 输出、DPI（并行）显示接口。

有关 DPI 的更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计 – 显示并行接口 (DPI) 24 位 RGB – 显示接口

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 ) 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 系列处理器。

#### 7.6.2.1.1.1 IO 电源

处理器 DPI 以 VDDSHV3 电源导轨（IO 组 3 的 IO 电源）为基准电源。

#### 7.6.2.1.1.2 连接

验证显示 (RGB) 连接。

DPI 显示接口支持包括 12、16、18 和 24 位 RGB 有源矩阵显示。将 16 位数据连接到 18 位面板 ( BGR565 到 BGR666 ) 时，建议将 D0-D4 连接到 LCD 模块输入的 B1-B5，将 D5-D10 连接到 LCD 模块输入的 G0-G5，将 D11-D15 连接到 LCD 模块输入连接器的 R1-R5。对于 LCD 模块输入侧的 18 位接口，建议将 B0 连接到 B5、R0 连接到 R5，并将 R0 连接到 R5。

#### 7.6.2.1.1.3 DPI (连接器件) 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件（LCD 模块）的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门，在“与运算”逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器或下拉电阻器（ $10k\Omega$  或  $47k\Omega$ ）（上拉电阻器已使能）并提供  $0\Omega$ ，以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATZ)。

如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件 (不使用“与运算”逻辑)，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，DPI 复位输入的上升和下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

#### 7.6.2.1.4 DPI 信号连接

建议为 VOUT0\_PCLK (像素时钟输出) 提供配置来连接串联电阻器 ( $0\Omega$ ) (靠近处理器时钟输出引脚以控制可能的信号反射)。如果空间不受限制，建议为靠近处理器引脚的所有其他控制和数据信号添加串联电阻器 ( $0\Omega$ )。

#### 7.6.2.1.5 电源轨的电容器

建议确认已为 VDDSHV3 (电源导轨以 DPI 接口信号为基准 (由其供电)) 电源导轨及所连接器件提供大容量电容与去耦电容 (若有推荐方案则使用推荐电容，或遵循相关 SK 实现)。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

#### 7.6.2.1.6 DPI (VOUT0) 外设检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#)一节。

#### 7.6.2.1.2 AM620-Q1 与 AM62D-Q1 处理器系列

不支持显示接口 (DPI)。

#### 7.6.2.2 开放式 LVDS 显示接口 (OLDI0)

##### 7.6.2.2.1 适用于 AM62x 和 AM62Px 处理器系列的 OLDI0

#### AM62x (AM625、AM623、AM625-Q1、AM625SIP) 处理器系列

该处理器系列支持 4 (四) 个数据通道和 1 (单) 个时钟通道、2 (双) 链路 LVDS OLDI 显示接口。OLDI0 接口可配置为双通道 OLDI-SL 单链路或单通道 OLDI-DL 双链路显示模式。

当 OLDI0 显示接口配置为双链路显示模式时，存在“奇数/偶数”像素分配要求。数据通道 A0、A1、A2、A3 对应奇数像素，数据通道 A4、A5、A6、A7 对应偶数像素。

配置为双通道单链路显示模式时，OLDI0 接口仅支持 (可以被配置) 镜像 (由于内部硬件支持/配置为重复) 模式。

有关支持的显示分辨率，请参阅处理器特定数据表。

#### AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列

该处理器系列支持为 2 个 OLDI-SL 单链路 (4 (四) 个数据通道和 1 (单) 个时钟通道) 或 1 个 OLDI-DL 双链路 (8 (八) 个) 数据通道和 2 (双) 个时钟通道) 显示模式配置 OLDI 显示接口。对于 OLDI-DL，双链路 A0 到 A3 对应奇数像素，A4 到 A7 对应偶数对。

当 OLDI0 接口配置为 2 个 OLDI-SL 单链路显示模式时，OLDI0 接口支持 (可配置) 独立显示流 (非重复模式、非镜像模式)。

有关支持的显示分辨率，请参阅处理器特定数据表。

#### 7.6.2.2.1.1 使用的 OLDI0 显示接口

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62P/AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 – OLDI (开放式 LVDS 显示接口) 功能

#### 7.6.2.2.1.1.1 OLDI0 接口兼容性

要验证 IO 电压电平兼容性，请参阅处理器特定数据表的 *OLDI LVDS (OLDI) 电气特性*一节。

### 7.6.2.2.1.1.2 IO 电源

处理器 OLDIO 接口以 VDDA\_1P8\_OLDI0 ( OLDIO 1.8V 模拟电源导轨 ) 为基准 ( 由其供电 )。

### 7.6.2.2.1.1.3 OLDIO ( 所连接器件 ) 复位

建议使用双输入“与运算”逻辑来实现所连接器件 ( OLDI 模块 ) 的复位。处理器 GPIO 作为其中一个输入连接到与门，在“与运算”逻辑与门输入端附近提供上拉电阻器或下拉电阻器 (  $10\text{k}\Omega$  或  $47\text{k}\Omega$  ) ( 上拉电阻器已使能 ) 并提供  $0\Omega$ ，以隔离 GPIO 输出用于测试或调试。与门的另一个输入是主域热复位状态输出 (RESETSTATz)。

如果直接使用处理器 MAIN 域热复位状态输出 (RESETSTATz) 来复位所连接器件 ( 不使用“与运算”逻辑 )，建议将 RESETSTATz 的 IO 电压电平与所连接器件匹配。建议使用电平转换器来匹配 IO 电平。如果选择了电阻分压器的理想值，则也可以使用电阻分压器进行电平转换。如果过高，OLDIO 复位输入的上升和下降时间可能会很慢，从而引入过大延迟。使用过低值电阻作为分压器会导致处理器在正常运行期间提供过多的稳态电流。

### 7.6.2.2.1.1.4 电源导轨的电容器

建议确认已为 VDDA\_1P8\_OLDI0 电源导轨及所连接器件提供大容量电容与去耦电容 ( 若有推荐方案则使用推荐电容，或遵循相关 SK 实现 )。

如果没有可用的建议，建议遵循处理器特定 SK 实现。

### 7.6.2.2.1.2 不使用 OLDIO 外设

不使用时，OLDIO 外设有特定的连接要求。关于连接 OLDIO 外设，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

建议将 OLDIO 1.8V 模拟电源导轨 (VDDA\_1P8\_OLDI0) 连接到有效的 1.8V 电源 ( 由其供电 )。铁氧体和大容量电容器是可选项。

### 7.6.2.2.1.3 其他信息

建议将 OLDIO 数据和时钟信号作为从处理器到连接器 ( 显示 ) 的点对点进行连接。无残桩产生。

任何电路板级实施都必须符合 IEEE1596.3 标准和 ANSI/TIA/EIA644-A 标准 ( 低电压差分信号 (LVDS) 接口电路的电气特性 ) 的物理层定义。

### 7.6.2.2.1.4 OLDIO 外设检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

### 7.6.2.2 AM620-Q1、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

不支持显示接口 (OLDI)。

### 7.6.2.3 显示串行接口 (DSI)

#### 7.6.2.3.1 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列

不支持显示接口 (DSI)。

#### 7.6.2.3.2 AM62P 和 AM62P-Q1 处理器系列

该处理器系列支持具有 x4 ( 四个 ) 数据通道和 x1 ( 单个 ) 时钟通道的显示接口。

有关支持的显示分辨率，请参阅处理器特定数据表。

#### 7.6.2.3.2.1 使用的 DSITX0 外设

处理器 DSITX0 接口以 VDDA\_CORE\_CSI\_DSI 和 VDDA\_CORE\_DSI\_CLK ( CSIRX0 和 DSITX0 核心电源 ) 以及 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI ( CSIRX0 和 DSITX0 1.8V 模拟电源 ) 为基准 ( 由其供电 )。

建议在 DSI0\_TXRCALIB ( 靠近处理器 ) 和 VSS 之间连接一个并联电阻器。有关建议电阻值和容差，请参阅处理器特定数据表。

如果需要复位所连接器件，建议遵循 OLDIO 或 DPI0 所连接器件的复位实现。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问

#### 7.6.2.3.2.1.1 DSITX0 外设检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 7.6.2.3.2.2 不使用 DSITX0 外设

不使用时，DSITX0 外设对接口信号和电源有特定的连接要求。

有关连接 DSITX0 外设信号、电源（内核和模拟）的信息，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

使用边界扫描功能时，CSIRX0 和 DSITX0 电源（VDDA\_CORE\_CSI\_DSI、VDDA\_CORE\_DSI\_CLK 和 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI）建议连接到推荐的电源导轨。建议在电源引脚上使用去耦电容器。大容量电容器和铁氧体是可选项。

当不使用边界扫描功能和不使用 CSIRX0 接口时，建议通过单独的  $0\Omega$  电阻将 CSIRX0 和 DSITX0 电源（VDDA\_CORE\_CSI\_DSI、VDDA\_CORE\_DSI\_CLK 和 VDDA\_1P8\_CSI\_DSI）连接到 VSS。不建议组装去耦电容器、大容量电容器和铁氧体。

未使用 DSITX0 接口时，DSI0\_TXRCALIB 电阻器可以是 DNI。

### 7.6.3 通用输入/输出 (GPIO)

#### 备注

有关连接处理器 IO，请参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节结尾的注释。

该处理器系列支持 MAIN 域中的 2 个 GPIO 模块实例 (GPIO0 和 GPIO1) 和 MCU 域中的 1 个 GPIO 模块实例 MCU\_GPIO0。通用输入/输出 (GPIO) 外设支持可以配置为输入或输出的信号（引脚）。当配置为输出时，软件可以对内部寄存器进行写入来控制输出引脚上驱动的状态。当配置为输入时，软件可以通过读取内部寄存器的来读取输入的状态。此外，GPIO 外设可以在不同的中断/事件生成模式下生成主机 CPU 中断和 DMA 同步事件。处理器特定数据表的引脚属性和信号说明两节提供了有关处理器引脚的信息，这些引脚可配置为支持 LVC MOS 和 SDIO 缓冲器类型的 GPIO（推挽型）。引脚属性一节还介绍了处理器支持的其他类型 IO。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62Px/AM62D-Q1/AM62L/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与 GPIO 相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计的设计建议/常见错误 — LVC MOS 输入磁滞相关的疑问

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 数据表引脚属性及引脚连接相关问题

#### 7.6.3.1 处理器 GPIO 上 CLKOUT 的可用性

MCU\_OSC0\_XO 的缓冲输出在 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列的 WKUP\_CLKOUT0 上复位后可用。对于 AM62Px 处理器系列，MCU\_OSC0\_XO 可配置为 WKUP\_CLKOUT0 输出。

#### 7.6.3.2 GPIO 连接和添加外部缓冲器

建议添加一个串联电阻器（其值取决于用例并按照处理器特定数据表限制电流）。当消耗（需要）更高电流的负载（高于处理器特定数据表值）连接到处理器 GPIO 时，建议在连接到负载之前缓冲处理器 IO。

通用处理器 LVC MOS IO 接口指南：

- 很多处理器 IO 都没有失效防护功能。建议在处理器电源斜升之前不施加外部输入。

2. 处理器 LVC MOS IO 指定了转换率要求 ( LVC MOS 输入转换率 <1000ns ) , 不建议施加慢速斜升输入或在输入端直接连接电容器。
3. 不建议在输出端连接一个  $> 22\text{pF}$  的电容器负载。DNI 电容器或 ( 根据用例 ) 执行仿真。
4. 在复位期间和复位之后 , 处理器 IO 缓冲器是 ( TX ( 输出 ) 和 RX ( 输入 ) 和内部拉电阻器 ( 上拉和下拉电阻器 ) ) 关闭。建议在可悬空的处理器 IO 驱动的所连接器件附近添加一个拉电阻器 ( 以防止所连接器件输入在被主机驱动前处于悬空状态 ) 。
5. 对于连接了布线但未被主动驱动的任何处理器 IO 焊盘 , 建议使用并联拉电阻器 ( $47\text{k}\Omega$ )。当添加并联拉电阻器不可行时 , 请布线远离噪声信号。
6. 建议验证处理器 IO 与所连接器件之间的 IO 级兼容性以及失效防护操作。

#### 7.6.3.3 其他信息

除非另有说明 , 否则未使用的 IO 上的引脚 ( 或焊盘 ) 可以保留为无连接状态。许多 IO 都有一个焊盘配置寄存器可用于控制 IO 的功能 ( 每个 `conf_<module>_<pin>` 寄存器中的 RXENABLE 字段 ) 的配置。更多信息 , 请参阅处理器特定 TRM 的控制模块一章。在早期初始化期间 , 软件可禁用设计中未使用的 IO 接收缓冲器 ( 即 `RXENABLE=0` ) 。当相关引脚悬空时 , 建议软件不要意外使能 IO 接收器 ( 通过设置 RXENABLE 位 ) 。

---

#### 备注

如需了解配置某些未使用的引脚 ( 或外设 ) 的指导信息 , 建议参阅处理器特定数据表的引脚连接要求一节。

---

---

#### 备注

#### **PADCONFIG 寄存器位配置 — ST\_EN :**

如果 PADCONFIG 寄存器被软件修改 , 建议保持 ST\_EN 位使能。每个电气特性表中定义的最小输入转换率参数与长期可靠性相关联。这些参数不受 ST\_EN 位的影响。通过滤除不超过磁滞的噪声脉冲 , 输入缓冲器中实现的施密特触发功能只会更改输入缓冲器的输出结果。当应用向 IO 输入施加慢于处理器特定数据表中定义的转换率时 , 施密特触发功能不会改变输入缓冲器的工作方式。

---

---

#### 备注

如需了解有关配置 IO 的指导信息 , 请参阅处理器特定 TRM 的焊盘配置寄存器一节。

---

---

#### 备注

特定外设和 GPIO 支持去抖功能。建议在处理器特定数据表的信号说明一节中查找与外设或 GPIO 的去抖功能相关的注释。

---

有关未使用处理器外设和 IO 连接的更多信息 , 请参阅以下常见问题解答 :

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62D-Q1/AM62P 定制电路板硬件设计过程中的设计建议/常见错误 - 不使用时的 SOC 外设和 IO 连接

有关连接 ( 已使用/未使用 ) 处理器引脚和外设的信息 , 请参阅以下常见问题解答 :

[常见问题解答] AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62L、AM62Px、AM64x、AM243x 定制电路板硬件设计 — 如何处理已使用/未使用的引脚/外设以及添加上拉或下拉电阻 ? ( 例如 GPIO、SERDES、USB、CSI、MMC ( eMMC、SD 卡 ) 、CSI、OLDI、DSI、CAP\_VDDRx…… )

使用处理器 GPIO 时 , 请参阅处理器特定数据表连接要求一节末尾的注释。

#### 7.6.3.4 GPIO 检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的 [用户指南系列](#) 一节。

## 7.6.4 板载硬件诊断

### 7.6.4.1 使用处理器电压监测器来监测板载电源电压

处理器电源电压监测器可用于监测使用基于 PMIC 或替代电源架构生成的板载电源，以及从外部连接器或载板连接的定制电路板的输入电源。为了使电压监测器 VMON\_VSYS 检测有效，使用电阻分压器（监控输入为 0.45V）对 5V 或更高（12V 或 24V）的直流电压进行分压，并连接至 VMON\_VSYS 监控输入。建议在监测到较高的直流电压时提供过压保护配置（并联电阻器或齐纳二极管）。

板载 1.8V 或 3.3V 电源可以直接连接到 VMON\_1P8\_SOC 和 VMON\_3P3\_SOC。

#### 7.6.4.1.1 使用时电压监控输入连接

对于电压监控引脚 VMON\_VSYS，无论软件实现如何，建议始终配置外部电阻（分压器）以早期检测（指示）电源故障。建议连接 5V 或更高电压的电压以使检测生效。如需通过外部电阻分压器连接板载电压（主电源电压，如 5V 或 12V 或 24V），请参阅处理器特定数据表的系统电源监测设计指南一节。建议在连接到 VMON\_VSYS 输入的电阻器输出端（跨接）实施噪声滤波器（电容器），因为 VMON\_VSYS 具有极小的迟滞和对瞬态的高带宽响应。

建议将 VMON\_1P8\_SOC 和 VMON\_3P3\_SOC 引脚直接连接到各自的电源（无需添加任何外部滤波电容器）。有关允许的电源电压范围，请参阅处理器特定数据表的建议运行条件部分。

---

#### 备注

对于 VMON\_VSYS，当遵循处理器特定数据表的系统电源监测设计指南一节中的建议时，失效防护条件有效。

对于 VMON\_1P8\_SOC 和 VMON\_3P3\_SOC 引脚，当连接的电源电压在处理器特定数据表的建议工作条件范围内时，失效防护条件有效。

---

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV) 设计建议/定制电路板硬件设计 — POK VMON 电压监控器

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 电源正常 (POK) 监控的模块电压和连接建议

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 与无源元件参数值、容差和额定电压相关的疑问

#### 7.6.4.1.1.1 电压监视器检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 7.6.4.1.2 不使用时的电压监控输入连接

建议始终连接（使用）电压监控器 VMON\_VSYS 来进行早期输入电源故障检测（指示）。当不使用 VMON\_VSYS 时，建议通过  $0\Omega$  电阻器将 VMON\_VSYS 引脚连接至 VSS，并添加一个用于未来扩展的测试点（遵循引脚连接要求）。

如需在不使用时连接电压监控输入 VMON\_3P3\_SOC 和 VMON\_1P8\_SOC，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM64x/AM243x (ALV、ALX) 设计建议/定制电路板硬件设计 — 电源正常 (POK) 监控的模块电压和连接建议

## 7.6.4.2 内部温度监测

处理器上的电压和热管理器 (VTM) 模块通过提供对片上温度传感器的控制来支持处理器的电压和热管理。

独立的温度传感器位于处理器上指定的热点。建议在 Linux 中读取片上温度传感器并执行热管理。请参阅 [E2E 主题](#)。

该处理器支持 WKUP 域中的一个 VTM 模块，即 VTM0。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px/AM62L/AM64x/AM243x (ALV, ALX) 定制电路板硬件设计 — 电压热管理器 (VTM)

#### 7.6.4.2.1 内部温度监测检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

#### 7.6.4.3 错误信号输出 (MCU\_ERRORn) 的连接

建议根据处理器特定数据表的[引脚连接要求](#)一节连接 MCU\_ERRORn 信号以进行测试，或将该信号用于其他板级功能。

#### 7.6.4.4 高频振荡器 (MCU\_OSC0) 时钟丢失检测

该处理器系列支持通过 HFOSC0 时钟丢失检测电路来检测 HFOSC0\_CLK 故障（停止）情况。专用硬件逻辑使用 CLK\_12M\_RC 时钟来监测 HFOSC0 时钟。当 HFOSC0\_CLK 停止切换的时长达到 9 个 CLK\_12M\_RC 时钟周期时，会检测到 HFOSC0 时钟停止丢失情况。如果设置了 CTRLMMR\_MCU\_PLL\_CLKSEL [8] CLKLOSS\_SWTCH\_EN，则参考时钟将从 HFOSC0\_CLKOUT 切换到 CLK\_12M\_RC，允许该处理器以较慢的时钟运行。

在时钟丢失情况下，该处理器通过 MCU\_ERRORn 引脚（将该引脚驱动为低电平）向外部器件报告错误。恢复机制取决于外部器件（例如由 PMIC 执行操作）。

例如，对整个电路板进行下电上电以使电路板恢复。如果电路板未恢复，则该处理器必须指示定制电路板设计人员采取替代措施或执行板级测试，例如检查板级系统时钟、外部晶体或电源轨。

请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM6422：了如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP) AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

#### 7.6.4.4.1 晶体或外部振荡器故障

在冷复位（加电复位）期间，如果晶体或外部振荡器不产生时钟，则处理器可能无法启动。

### 7.7 SK 特定电路实现（重复使用）

如果重复使用了下面列出的某些 SK 实现：

- DPI 转 HDMI
- 音频编解码器
- FT4232 UART 转 USB 桥接器
- XDS110 调试程序
- CPSW3G RGMII 1 – PHY
- M.2 接口 – SDIO
- 电流监控器件
- USB Type-C PD 控制器和电源

建议遵循以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 设计建议/定制电路板硬件设计 — 在定制电路板设计上重复使用下面列出的 SK 特定实现的指南

### 7.8 在定制电路板启动期间执行电路板级测试

### 7.8.1 使用 **PinMux** 工具的处理器引脚配置

建议使用 TI [SysConfig-PinMux](#) 工具验证所有处理器外设和 IO 配置，以确保配置了有效的 IOSET。

有关更多信息，请参阅 [SysConfig-PinMux](#) 工具提供的 PinmuxConfigSummary.csv 文件。

### 7.8.2 原理图配置

建议验证为替代功能或测试提供的电路选项在定制电路板设计中标记为 DNI 并且在为电路板供电之前未安装在电路板上，这些选项在电路板正常运行期间必须为 DNI ( 安装元件可能会影响定制电路板的性能 ) 。

### 7.8.3 将电源导轨连接到外部上拉电阻器

将处理器 IO 上拉电阻器连接到不同的 IO 电源导轨/工作电压 ( 与 IO 组参考的 IO 组的 IO 电源电压电平不匹配 ) 可能导致 IO 导轨上漏电压并影响定制电路板性能或处理器可靠性。每个信号的 IO 组都有一个相关的 IO 电源 ( 例如 : VDDSHVx [ 对于 AM62x、AM62Ax 和 AM62D-Q1 , x = 0-6 ; 对于 AM62Px , x = 0-3、5-6 ] ) 。有关更多信息，请参阅处理器特定数据表中的引脚属性表。

例如，要在 GPIO 多路复用模式 ( GPIO1\_17 ) 中上拉 SPI0\_CLK 信号，请将所连接的电源导轨外部上拉电阻器连接至 IO 组的 IO 电源 VDDSHV0 。

### 7.8.4 外设 ( 子系统 ) 时钟输出

对于任何包括时钟输出的处理器外设，建议配置相应 CTRLMMR\_MCU\_PADCONFIGx、  
CTRLMMR\_PADCONFIGy 寄存器的 RXACTIVE 位。该位配置是时钟输出正常工作的必需条件。

### 7.8.5 通用板启动和调试

启动电路板之前的电路板启动提示，包括验证以下内容：

- 组装的处理器、所连接器件和其他元件与设计匹配 ( 定制电路板原理图和定制电路板设计要求 )
- 已根据 BOM 检查装配电路板的元件安装情况 ( 包括 DNI，请勿安装元件 ) 。已检查装配电路板的组装 ( 元件焊接和焊接工艺 )
- 在施加定制电路板电源和处理器电源斜升之前，没有外部输入连接到处理器输入

请参阅以下常见问题解答：

[[常见问题解答](#)] Sitara 器件 ( AM64x、AM243x、AM62x、AM62L、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px ) 的电路板启动提示

#### 7.8.5.1 电路板启动、测试或调试的时钟输出

处理器上提供以下时钟输出，仅用于测试和调试：

##### **MCU\_SYSCLKOUT0**

MCU\_PLL0\_HSDIV0\_CLKOUT (MCU\_SYSCLKOUT0) 4 分频，然后连接到名为 MCU\_SYSCLKOUT0 的特定引脚。该时钟输出仅用于测试或调试目的。

##### **SYSCLKOUT0**

MAIN\_PLL0\_HSDIV0\_CLKOUT (SYSCLKOUT0) 4 分频，然后连接到名为 SYSCLKOUT0 的特定引脚。该时钟输出仅用于测试或调试目的。

##### **OBSCLK0 ( 在 AM62x 的两个引脚上提供 ) 、OBSCLKn [n = 0-1] ( 在 AM62Ax 和 AM62Px 中 ) 与 MCU\_OBSCLK0**

建议仅将观察时钟 ( OBSCLK0、OBSCLK1 与 MCU\_OBSCLK0 ) 输出仅用于测试或调试目的。观察时钟可用于选择多个内部时钟之一作为输出。观察时钟不应该用作任何外部器件的时钟源。如处理器特定数据表所述，OBSCLK0、OBSCLK1 和 MCU\_OBSCLK0 信号仅用于测试或调试目的。

建议在可行时为名称为 MCU\_SYSCLKOUT0、SYSCLKOUT0、OBSCLK0、OBSCLK1 和 MCU\_OBSCLK0 的处理器引脚提供 TP 和并联拉电阻器 ( 10k $\Omega$  或 47k $\Omega$  ) 。

如果时钟输出引脚配置为备选功能，建议在布线上插入 TP，并提供将信号所连接器件进行隔离的配置，从而进行测试或调试。

#### 7.8.5.2 其他信息

建议为 MCU\_RESETSTAT<sub>z</sub>、RESETSTAT<sub>z</sub> 和 POR<sub>z</sub>\_OUT 提供测试点，以便在不使用时进行测试或调试。

对于具有警报输出、过流指示输出或 PG（电源良好）输出的板载已连接器件（分立直流/直流或 LDO 或温度传感器或电压监控器），建议提供上拉电阻器（10kΩ）和测试点，用于测试或后续增强（不使用时）。

#### 7.8.5.3 通用板启动和调试检查清单

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

## 8 定制电路板原理图设计的自我审查

### 备注

在定制电路板设计（基于所使用的处理器系列）期间，建议遵循下面列出的处理器系列用户指南：

[处理器系列用户指南（定制电路板设计硬件设计注意事项）](#)

[处理器系列用户指南（原理图设计指南与原理图审查检查清单）](#)

完成所需的原理图更新后，定制电路板设计的下一个阶段（遵循用户指南，参考 SK 原理图实现、硬件设计注意事项用户指南和 TI.com 上的其他配套资料）是按照原理图设计指南各节末尾提供的审查检查清单进行自我审查。也可以使用 Excel 格式的原理图审查检查清单进行审查，并且可以使用 Excel 格式的原理图审查检查清单来跟踪原理图审查一节的完成情况。

自我审查原理图审查检查清单章节示例：

- [处理器内核和外设内核电源检查清单](#)
- [通用板启动和调试检查清单](#)

以下常见问题解答列出了对定制电路板原理图进行自我审查时定制电路板设计人员可以遵循的可用配套资料和步骤：

#### AM62x 处理器系列：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP：设计建议/定制电路板硬件设计 - 定制电路板原理图自我审查](#)

#### AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列：

[\[常见问题解答\] AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 设计建议/定制电路板硬件设计 - 定制电路板原理图自检](#)

#### AM62Px 处理器系列：

[\[常见问题解答\] AM62P/AM62P-Q1 设计建议/定制电路板硬件设计 — 定制电路板原理图自检](#)

以下常见问题解答列出了观察到的常见错误（基于对多个客户原理图的审查并参考多个配套资料）。建议阅读错误列表并对定制电路板原理图进行所需的更新：

[\[常见问题解答\] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM62A/AM62P/AM62D-Q1/AM64x/AM243x 设计建议/定制电路板硬件设计 — 在客户原理图审查期间观察到的错误列表](#)

## 9 定制电路板布局注释（在原理图部分附近添加）和通用指南

建议考虑为处理器、所连接器件和其他板载器件添加所需或适用的设计注释，以减少定制电路板设计期间的错误。建议为处理器内存添加必要的设计注释（例如：USB2.0 接口、以太网接口、摄像头接口、显示接口（OLDIO（AM625、AM623、AM625-Q1、AM625SIP 和 AM62P、AM62P-Q1）和 DSITX0（AM62P、AM62P-Q1），包括 eMMC、OSPI、SD 卡、SDIO 和其他使用的处理器外设，包括 USB、MCSPI、MCASP）。建议包含注释，以包括定制电路板引导模式配置、串联和并联电阻的放置、去耦和大容量电容器的放置。

建议标记所有差分信号、可能影响性能的关键信号并指定目标阻抗（根据需要）。请参见以下示例：

- USB2.0 数据线的差分阻抗应在  $90\Omega$  标称值的额定容差范围内。
- CSIRX0、DSITX0 和 OLDIO 端口信号的差分阻抗应当在  $100\Omega$  标称值的额定容差范围内。

### 备注

有关 LPDDR4 时钟、地址和控制信号的建议目标阻抗，请参阅 [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#)。

请参阅以下常见问题解答，其中包含要遵循的电路板布局指南：

[常见问题解答] AM625：针对特定外设的 PCB 模式建议

[常见问题解答] AM625：MMC0 PCB 连接要求

AM6442：MMCSD0 (eMMC) 和 MMCSD1 (SD 卡) 的 PCB 布局指南

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP) AM62Ax (AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 处理器系列。

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM62L/AM64x/AM243x (ALV)/AM62Ax/AM62D-Q1/AM62Px 电路板布局 — 通用高速布局指南文档链接

## 9.1 布局布线注意事项

请参阅处理器系列特定用户指南的[用户指南系列](#)一节。

## 10 定制电路板设计仿真

所连接内存 (DDR4 或 LPDDR4) 的基线驱动阻抗和 ODT 设置源自对 SK 执行的信号完整性 (SI) 仿真。

建议对定制电路板设计进行仿真，以最终确定这些值，因为配置值可能与 SK 原理图实现不同。

执行仿真时，可以参考以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP/AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1/AM62L/AM62P/AM62P-Q1/AM64x/AM243x 定制电路板硬件设计 — IO 缓冲器的 S 参数和 IBIS 模型

[常见问题解答] 将 DDR IBIS 模型用于 AM64x、AM243x (ALV)、AM62x、AM62L、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px

要简要了解高速 LPDDR4 接口的电路板提取、电路板仿真和分析方法，请参阅 [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#) 或 [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局指南](#) 应用手册的 LPDDR4 电路板设计仿真一章。

使用 SysConfig 上的 [DDR 寄存器配置工具](#) 可调节驱动强度。

有关配置 DDRSS 寄存器更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 — 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1) 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 系列处理器。

有关 PDN Power SI 仿真的相关问题，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] AM62A3-Q1：AM62A3-Q1 PDN Power SI 仿真问题

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x (AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1)、AM62D-Q1 和 AM62Px (AM62P、AM62P-Q1) 系列处理器。

## 10.1 DDR-MARGIN-FW

利用 DDR 裕度固件和支持脚本，可以在板载 DDR 接口中实现定制电路板裕度的可视化和测量。这些工具能够对关键数据信号进行无探头测量，以了解定制电路板设计是否遵循接口的建议设计指南。

**AM62x 处理器系列：**

[DDR-MARGIN-FW — 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本](#)

**AM62Ax 处理器系列：**

[DDR-MARGIN-FW — 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本](#)

**AM62D-Q1 处理器系列：**

查找 *DDR-MARGIN-FW - 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本*

**AM62Px 处理器系列：**

*DDR-MARGIN-FW — 用于测量系统 DDR 裕度的固件和脚本*

有关更多信息，请参阅以下常见问题解答：

[常见问题解答] **PROCESSOR-SDK-AM62X**：有关 AM625/AM623/AM620-Q1/AM625-Q1/AM625SIP DDR 裕度测试工具的问题

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

## 11 其他参考内容

其他参考资料包含针对特定处理器的常见问题解答和定制电路板设计硬件设计注意事项用户指南。连接器件（包括 PMIC 和 EPHY）的原理图。

### 11.1 涵盖 AM64x、AM243x、AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62Lx 处理器系列的常见问题解答

以下常见问题解答汇总了在定制电路板原理图设计和定制电路板原理图审阅期间可以参考的主要配套资料。

[常见问题解答] **AM64x、AM243x (ALV、ALX)、AM62x、AM62Ax、AM62Px、AM62D-Q1、AM62L 定制电路板硬件设计 — 原理图设计和原理图审阅期间用于参考的配套资料**

---

#### 备注

使用 SK PDF 原理图以及 D-Note 和 R-Note 进行定制电路板原理图审查时，建议查看原理图中添加的常见问题解答链接，以获取更多信息。

---

### 11.2 常见问题解答 - 处理器产品系列和 Sitara 处理器系列

根据 TI sitara 处理器应用和系统团队与多位定制电路板设计人员的互动交流、来自定制电路板设计人员的提问以及从这些提问中获得的经验，结合内部资料查阅，我们整理了一系列常见问题解答（关于（详细说明和添加的示例说明）处理器运行、处理器功率和 IO 连接、处理器外设和接口、处理器评估 SK、定制电路板设计审查期间观察到的常见错误、数据表和引脚属性，以及常见 E2E 提问），以便在定制电路板设计阶段为设计人员提供支持。请参阅下面的常见问题解答列表。建议客户可在定制电路板设计期间使用该列表以及 [TI.com](#) 上的其他可用设计配套资料（包括定制电路板设计硬件设计注意事项和原理图设计指南和原理图审查检查清单）：

**AM62x 处理器系列：**

[常见问题解答] **AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答**

**AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列：**

[常见问题解答] **AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关处理器配套资料、正常运行、外设、接口和入门套件的常见问题解答**

**AM62Px 处理器系列：**

[常见问题解答] **AM62P、AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答**

**AM62Lx 处理器系列：**

[常见问题解答] **AM62L ( AM62L32、AM62L31 ) 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和 EVM 相关的常见问题解答**

## Sitara 处理器系列：

[常见问题解答] 定制电路板硬件设计 — 所有 Sitara 处理器 (AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM243x、AM335x) 系列的主要 (完整) 常见问题解答列表

请参阅下面的常见问题解答，其中提供了所有可用的常见问题解答，包括与软件或 sitara 系列处理器相关的常见问题解答：

[常见问题解答] AM6x：有关 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM243x、AM335x、AM4x Sitara 器件的最新常见问题解答

---

### 备注

常见问题解答会经常更新。建议定期查看感兴趣的常见问题解答和常见问题解答主列表以获取最新信息。

---

## 11.3 原理图审查 ( 内部自检 ) 与原理图审查需求 ( 供应商 )

根据定制电路板设计周期，建议执行自我审查和团队审查，并根据需要与供应商进行外部审查。

如果需要向 TI 提交原理图审查申请，建议遵循以下常见问题解答：

[常见问题解答] Sitara MPU 硬件应用支持 — 原理图审查申请

这是通用常见问题解答，也可用于 AM62x ( AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP ) AM62Ax ( AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 )、AM62D-Q1 和 AM62Px ( AM62P、AM62P-Q1 ) 处理器系列。

## 11.4 处理器连接器件检查清单

[以太网 PHY PCB 设计布局检查清单](#)

[TPS65219 原理图、布局检查清单](#)

[TPS65931211-Q1 适用于 AM62A 的 PMIC 用户指南](#)

---

### 备注

建议验证 [TI.com](#) 上所连接器件的器件特定原理图审查检查清单的可用性，并使用可用检查清单验证定制电路板原理图实现。

---

## 12 用户指南内容和使用情况摘要

本用户指南包括原理图设计指南和原理图审查检查清单，可供定制电路板设计人员在定制电路板原理图设计和定制电路板原理图审查期间使用。本使用指南中提供的建议有助于定制电路板设计人员优化定制电路板设计、减少原理图设计错误、缩短定制电路板启动时间、缩短定制电路板调试时间，以及更大程度地减少日后重新设计电路板的工作。

## 13 参考资料

### 13.1 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP

- 德州仪器 (TI)，[AM62x Sitara 处理器](#)，数据表
- 德州仪器 (TI)，[AM625SIP — 具有集成 LPDDR4 SDRAM 的 AM6254 Sitara 处理器](#)，数据表
- 德州仪器 (TI)，[AM62x Sitara 处理器](#)，技术参考手册
- 德州仪器 (TI)，[AM62x 器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI)，[使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项](#)，用户指南
- 德州仪器 (TI)，[AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列原理图设计指南和审阅检查清单](#)，应用手册

- 德州仪器 (TI) , [入门套件 SK-AM62B-P1](#) , 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [分立式电源解决方案入门套件 SK-AM62B](#) , 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [入门套件 SK-AM62-LP](#) , 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [入门套件 SK-AM62-SIP](#) , 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [AM62x 功耗](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x 最大电流额定值](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x 功耗估算工具](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [利用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [利用 TPS65219 PMIC 为 AM625SIP 供电](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x 的分立式电源解决方案](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62 PCB 设计迂回布线](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x \(AMC\) PCB 设计迂回布线](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x SiP 设计迂回布线](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [PRU-ICSS 特性比较](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM625SIP 处理器如何通过集成 LPDDR4 加快开发](#) , 应用简报
- 德州仪器 (TI) , [AM625SIP : 系统级封装释疑](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [SK-AM62B-P1 设计包内容概述](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [SK-AM62-LP 设计包内容概述](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [SK-AM62-SIP 设计包文件夹和文件列表](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [SK-AM62B 设计包文件夹和文件列表](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [Sitara AM62x 基准测试](#) , 应用手册

### 13.2 AM62A7、AM62A3、AM62A7-Q1、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1

- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax Sitara 处理器](#) , 数据表
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax Sitara 处理器](#) , 技术参考手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax 器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI) , [入门套件 SK-AM62A-LP](#) , 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [使用 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项](#) , 用户指南
- 德州仪器 (TI) , [AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列原理图设计指南和原理图审查检查清单](#) , 用户指南
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax 最大电流额定值](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax 功耗估算工具](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [适用于 AM62Ax 的 PMIC 解决方案](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [为 AM62Px 器件供电的 PMIC](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax/AM62Dx PCB 设计迂回布线](#) , 用户指南
- 德州仪器 (TI) , [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [SK-AM62A-LP 设计包文件夹和文件列表](#) , 产品概述
- 德州仪器 (TI) , [Sitara AM62Ax 基准测试](#) , 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [使用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 PMIC 的 Sitara AM62A/P/D\(-Q1\) 电源设计](#) , 应用简介

### 13.3 AM62D-Q1

- 德州仪器 (TI) , [AM62Dx Sitara 处理器](#) , 数据表
- 德州仪器 (TI) , [AM62Dx Sitara 处理器](#) , 技术参考手册
- 德州仪器 (TI) , [AM62Dx Sitara 处理器器件勘误表 , 器件版本 1.0](#)
- 德州仪器 (TI) , [AUDIO-AM62D-EVM](#) 产品页面
- 德州仪器 (TI) , [使用 AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列的定制电路板设计硬件设计注意事项](#) , 用户指南
- 德州仪器 (TI) , [AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1-Q1 和 AM62D-Q1 处理器系列原理图设计指南和原理图审查检查清单](#) , 用户指南

- 德州仪器 (TI), [适用于 AM62Ax 的 PMIC 解决方案](#), 产品概述
- 德州仪器 (TI), [为 AM62Px 器件供电的 PMIC](#), 产品概述
- 德州仪器 (TI), [AM62Ax/AM62Dx PCB 设计迂回布线](#), 用户指南
- 德州仪器 (TI), [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [Sitara AM62Dx 基准测试](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [使用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 PMIC 的 Sitara AM62A/P/D\(-Q1\) 电源设计](#), 应用简介

## 13.4 AM62P、AM62P-Q1

- 德州仪器 (TI), [AM62Px Sitara 处理器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI), [AM62Px Sitara 处理器](#), 技术参考手册
- 德州仪器 (TI), [AM62Px 器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI), [入门套件 SK-AM62P-LP](#), 产品页面
- 德州仪器 (TI), [使用处理器的 AM62P、AM62P-Q1 系列的定制电路板硬件设计注意事项](#), 用户指南
- 德州仪器 (TI), [AM62P 功耗估算工具](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [用于为 AM62Px 器件供电的 PMIC](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [AM62Px PCB 设计迂回布线](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [AM62Ax、AM62Px、AM62Dx LPDDR4 电路板设计和布局布线指南](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [SK-AM62P-LP 设计包文件夹和文件列表](#), 产品概述
- 德州仪器 (TI), [Sitara AM62P 基准测试](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI), [使用 TPS6522430-Q1 和 TPS6522230-Q1 PMIC 的 Sitara AM62A/P/D\(-Q1\) 电源设计](#), 应用简介

## 13.5 AM62L

- 德州仪器 (TI) : [AM62Lx Sitara 处理器](#), 数据表
- 德州仪器 (TI) : [AM62L Sitara 处理器](#), 技术参考手册
- 德州仪器 (TI) : [AM62Lx Sitara 处理器器件勘误表](#)
- 德州仪器 (TI) : [EVM TMDS62LEVM](#), 产品选择页面
- 德州仪器 (TI) : [使用 AM62L \(AM62L32、AM62L31\) 处理器系列的定制电路板设计的硬件设计注意事项](#), 用户指南
- 德州仪器 (TI) : [AM62x、AM62Lx DDR 电路板设计和布局指南](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [AM62Lx PCB 设计迂回布线](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [AM62L 最大额定电流](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [AM62L 电源实现](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [AM62L 产品概述](#), 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [Sitara AM62Lx 基准测试](#), 应用手册

## 13.6 所有处理器系列通用

- 德州仪器 (TI), [AM623、AM625、AM625SIP、AM620-Q1、AM625-Q1、AM62A3、AM62A7、AM62A7-Q1、AM62D-Q1、AM62P-Q1 原理图设计指南和审阅检查清单](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [Sitara 处理器配电网路：实现与分析](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [高速接口布局指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [高速布局指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [Jacinto7 AM6x、TDA4x 和 DRA8x 高速接口设计指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [DSP 和 Arm 应用处理器热设计指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [仿真和跟踪接头技术参考手册](#) 用户指南
- 德州仪器 (TI), [XDS 目标连接指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [TIA/EIA-644 \(LVDS\) 的接口电路](#) 设计注意事项
- 德州仪器 (TI), [通用硬件设计/BGA PCB 设计/BGA 去耦](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [MSL 等级和回流焊曲线](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI), [湿敏等级搜索](#) 封装搜索
- 德州仪器 (TI), [KeyStone 器件时钟设计指南](#) 应用手册

- 德州仪器 (TI) , [KeyStone II 器件硬件设计指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [TIDA-01413 - ADAS 8 通道传感器融合集线器参考设计](#) 设计指南
- 德州仪器 (TI) , [Jacinto 7 DDRSS 寄存器配置工具](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [使用 IBIS 模型进行时序分析](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI) : [显示接口 : Sitara MPU 可视化设计综合指南](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [McASP 设计指南 — 提示、技巧和实用示例](#) 应用手册
- 德州仪器 (TI) , [使用单个 LVC MOS 振荡器驱动多个负载](#) 应用手册

### 13.7 可用常见问题解答主列表 - 按处理器系列

提供了完整的常见问题解答列表，建议用于快速查看所选处理器或处理器系列的可用常见问题解答列表。

[常见问题解答] AM62A7/AM62A7-Q1/AM62A3/AM62A3-Q1/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 - 有关处理器配套资料、正常运行、外设、接口和入门套件的常见问题解答

[常见问题解答] AM62L ( AM62L32、AM62L31 ) 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和 EVM 相关的常见问题解答

[常见问题解答] AM62P、AM62P-Q1 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答

[常见问题解答] AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 定制电路板硬件设计 - 与处理器配套资料、功能、外设、接口和入门套件相关的常见问题解答

### 13.8 可用常见问题解答主列表 - Sitara 处理器系列

[常见问题解答] 定制电路板硬件设计 — 所有 Sitara 处理器 (AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM243x、AM335x) 系列的主要 (完整) 常见问题解答列表

### 13.9 常见问题解答，包括相关软件

[常见问题解答] AM6x : 有关 AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1、AM62Px、AM62L、AM64x、AM24x、AM3x、AM4x Sitara 器件的最新常见问题解答

### 13.10 有关连接器件的常见问题解答

[常见问题解答] DP83869-EP : 以太网合规性测试失败

[常见问题解答] TPS65219 : 为 Sitara AM62x MPU 供电的 PMIC 与分立式解决方案的优势

[常见问题解答] TPS6594-Q1、TPS6593-Q1、LP8764-Q1 PMIC 的常见问题解答列表

## 14 术语

<b>BOM</b>	物料清单
<b>CAN</b>	控制器局域网
<b>CPPI</b>	通信端口编程接口
<b>CPSW3G</b>	通用平台 3 端口千兆位以太网交换机
<b>CSIRX</b>	摄像头流媒体接口接收器
<b>DDR0_CAL0</b>	IO 焊盘校准电阻
<b>DFU</b>	器件固件升级
<b>DNI</b>	请勿安装
<b>DPI</b>	显示并行接口
<b>DRD</b>	双角色设备
<b>DSI</b>	显示串行接口
<b>E2E</b>	工程师对工程师
<b>ECC</b>	错误校正码

<b>EMC</b>	电磁兼容性
<b>EMI</b>	电磁干扰
<b>eMMC</b>	嵌入式多媒体卡
<b>EMU</b>	仿真控制
<b>EOS</b>	电过应力
<b>ESD</b>	静电放电
<b>ESL</b>	有效串联电感
<b>ESR</b>	有效串联电阻
<b>常见问题解答</b>	常见问题解答
<b>FET</b>	场效应晶体管
<b>GPIO</b>	通用输入/输出
<b>GPMC</b>	通用存储器控制器
<b>I2C</b>	内部集成电路
<b>IBIS</b>	输入/输出缓冲器信息规范
<b>IEP</b>	工业以太网外设
<b>JTAG</b>	联合测试行动组
<b>LDO</b>	低压降
<b>LVCMOS</b>	低压互补金属氧化物半导体
<b>LVDS</b>	低电压差分信号
<b>MAC</b>	介质访问控制器
<b>MCASP</b>	多通道音频串行端口
<b>MCSPI</b>	多通道串行外设接口
<b>MCU</b>	微控制器单元
<b>MDI</b>	媒体相关接口
<b>MDIO</b>	管理数据输入/输出
<b>MMC</b>	多媒体卡
<b>MMCSD</b>	多媒体卡/安全数字
<b>ODT</b>	片上端接
<b>OLDI</b>	开放式 LVDS 显示接口
<b>OPN</b>	可订购器件型号
<b>OSPI</b>	八线串行外设接口
<b>PCB</b>	印刷电路板
<b>PDN</b>	配电网络
<b>PET</b>	功耗估算工具
<b>PMIC</b>	电源管理集成电路
<b>POR</b>	上电复位
<b>PRUSS</b>	可编程实时单元子系统
<b>QSPI</b>	四线串行外设接口
<b>RGMII</b>	简化千兆位媒体独立接口
<b>RMII</b>	简化媒体独立接口
<b>ROC</b>	处理器特定数据表 建议运行条件
<b>SD</b>	安全数字

<b>SDIO</b>	安全数字输入输出
<b>SPI</b>	串行外设接口
<b>TCK</b>	测试时钟输入
<b>TDI</b>	测试数据输入
<b>TDO</b>	测试数据输出
<b>TEN</b>	测试使能
<b>TMS</b>	测试模式选择输入
<b>TRC_DATA<sub>n</sub></b>	跟踪数据 n
<b>TRM</b>	技术参考手册
<b>TRST<sub>n</sub></b>	测试复位
<b>UART</b>	通用异步收发器
<b>WKUP</b>	唤醒
<b>XDS</b>	扩展开发系统
<b>ZQ</b>	存储器件校准基准电阻器

## 15 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

<b>Changes from Revision H (January 2025) to Revision I (September 2025)</b>	<b>Page</b>
• ( 用户指南使用指南 ) : 添加了所有处理器系列 GPN.....	3
• 添加了“定制电路板原理图设计实现检查清单小节说明”一节.....	3
• ( 处理器的处理器系列列表 ) : GPN 均指代对应封装规格.....	4
• 添加“原理图设计指南和原理图审查检查清单更新”一节.....	5
• ( AM62Px 处理器系列 ) : 添加了注释.....	6
• 添加了“处理器系列用户指南 ( 原理图设计指南与原理图审查检查清单 ) ”一节.....	6
• ( 处理器特定信息 ) : 添加的注释.....	6
• ( 选择处理器 OPN ( 可订购器件型号 ) ) : 向所有处理器系列 GPN 添加了封装.....	7
• ( 处理器特定数据表用例和用户指南编辑所引用的版本 ) : 添加了有关数据表的更多信息，包括并更新了数据表修订版 ( 在 TI.com 上提供 ) .....	7
• ( 订购和质量信息 ) : 添加了 AM62A1-Q1.....	8
• ( 处理器电源架构 ) : 添加的注释.....	9
• ( 基于分立式电源器件 ( DC/DC、LDO ) 的电源架构 ) : 添加了与分立式电源架构常见问题解答相关的问题，并添加了有关 MCU_PORz 输入的更多信息.....	10
• 添加“TPS65224x 基于 PMIC 的电源架构检查清单”一节.....	11
• ( 基于分立式电源器件 ( DC/DC、LDO ) 的电源架构 ) : 添加了与分立式电源架构常见问题解答相关的问题，AM62A1-Q1 GPN 并添加了有关 MCU_PORz 输入的更多信息.....	11
• ( 基于分立式电源器件 ( DC/DC、LDO ) 的电源架构 ) : 添加了与分立式电源架构常见问题解答相关的问题，并添加了有关 MCU_PORz 输入的更多信息.....	13
• ( 一般建议 ) : 添加的注释.....	14
• ( 有关元件选择的注意事项 ) : 添加的注释.....	14
• ( 并联拉电阻器 ) : 添加的注释.....	15
• ( 外设时钟输出串联电阻器 ) : 添加了更多信息.....	16
• 添加了“外设时钟输出下拉电阻器”一节.....	16
• 添加了“AM62D-Q1 处理器系列”一节.....	16
• 添加了“原理图设计页面排序和 SK 电路板布局”一节.....	17
• 添加了“处理器特定 SDK”一节.....	17
• ( 器件比较、IOSET 和电压冲突 ) : 添加了有关电压冲突的信息.....	19
• ( PADCONFIG 寄存器注意事项 ) : 添加了有关 PADCONFIG 位和 PADCONFIG 寄存器默认值汇总常见问题解答的信息.....	19
• ( 定制电路板高速接口设计指南 ) : 添加了通用高速布局指南常见问题解答文档链接.....	20
• ( 将慢速斜升信号 ( 输入 ) 或电容器负载 ( 输出 ) 连接到处理器 IO ) : 添加了更多信息.....	20
• ( 针对电源、时钟、复位、引导和调试的处理器特定建议 ) : 添加的注释.....	21
• ( 电源 ) : 添加的注释.....	21
• ( 内核和外设电源 ) : 添加的注释.....	22
• ( AM62Px 处理器系列 ) : 添加了有关支持 HS400 的 SR1.2 和电源连接以及电路板布局建议常见问题解答的信息.....	23
• ( IO 组的 IO 电源 ) : 添加的注释.....	24
• 添加了“部分 IO 模式功能”一节.....	26
• ( MCU_OSC0 ( 高频率 ) 时钟 ( 内部振荡器 ) 或 LVCMOS 数字时钟 ( 外部振荡器 ) ) : 添加了有关 MCU_OSC0 (WKUP_OSC) 或 WKUP_LFOSC0 (LFOSC0) 的 LVCMOS 数字时钟源常见问题解答的问题以及有关时钟输入的更多信息.....	27
• ( WKUP_LFOSC0 ( 低频率 ) 时钟 ( 内部振荡器 ) 或 LVCMOS 数字时钟 ( 外部振荡器 ) ) : 添加了有关 MCU_OSC0 (WKUP_OSC) 或 WKUP_LFOSC0 (LFOSC0) 的 LVCMOS 数字时钟源常见问题解答的问题.....	28
• ( 处理器复位 ) : 添加了处理器复位输入、复位状态输出和连接建议常见问题解答.....	29
• ( 外部复位输入 ) : 添加了处理器复位输入、复位状态输出和连接建议常见问题解答.....	29

• ( 引导模式的配置 ( 针对处理器 ) ) : 添加了受支持的引导模式配置常见问题解答.....	31
• ( 处理器外设电源、接口和连接 ) : 添加了注释.....	33
• 添加了“支持的处理器内核和 MCU 内核”一节.....	33
• ( DDR 子系统 (DDRSS) ) : 增加了 DDR4/LPDDR4 性能差异以及无源元件值、容差和额定电压相关疑问的常见问题解答。添加了有关 DDRSS 的更多信息.....	34
• 添加了“DDRSS 信号引脚 ( 封装 ) 延迟信息”部分.....	37
• ( AM62x 、 AM62Ax 和 AM62D-Q1 处理器系列 ) : 添加了有关无源元件值、容差、额定电压的问题的常见问题解答以及有关 MMC0 接口的更多信息.....	38
• ( AM62Px 处理器系列 ) : 添加了有关 MMC0 接口的更多信息.....	39
• ( MMC1/MMC2 - SD ( 安全数字 ) 卡接口 ) : 添加了更多有关 MMC1/MMC2 - SD 接口的信息.....	41
• 添加了“用于 SD 卡接口的 MMC1 信号 ( 建议 ) ”一节.....	42
• 添加了“用于 SD 卡接口的 MMC2 信号”一节.....	42
• 添加了“其他信息”一节.....	42
• ( MMC1/MMC2 SDIO ( 嵌入式 ) 接口 ) : 添加了更多有关 MMC1/MMC2 SDIO 接口的信息.....	43
• ( 八路串行外设接口 (OSPI) 或四路串行外设接口 (QSPI) ) : 添加了有关 OSPI 或 QSPI 接口的注释和更多信息.....	45
• ( 通用内存控制器 (GPMC) ) : 添加了有关 GPMC 接口的更多信息.....	46
• ( 外部通信接口 ( 以太网 (CPSW3G0) 、 USB2.0 、 PRUSS 、 UART 和 MCAN) ) : 添加的注释.....	47
• 添加了“以太网 (MAC) 接口”一节.....	48
• ( 通用平台 3 端口千兆位以太网交换机 (CPSW3G0) ) : 添加了有关 CPSW3G0 接口的更多信息.....	48
• ( USB Type-C ) : 添加了“没有 PD 控制器是否可以实现 USB OTG ? ”常见问题解答.....	52
• ( 其他信息 ) : 添加了有关无源元件值、容差和额定电压的问题的常见问题解答.....	52
• ( 通用异步接收器/发送器 (UART) ) : 添加了有关 UART 接口的注释和更多信息.....	53
• 添加了“不使用时的 UART 接口”一节.....	54
• ( 模块化控制器局域网 (MCAN) , 具有完整 CAN-FD 支持 ) : 添加了有关 MCAN 接口的注释和更多信息.....	54
• ( 多通道串行外设接口 (MCSPI) 和音频外设 — 多通道音频串行端口 (MCASP) ) : 添加了有关 MCSPI 和 MCASP 接口的更多信息和参考的所需常见问题解答注释.....	55
• 添加了“MCSPI 和 MCASP 接口信号的连接”一节.....	56
• ( 内部集成电路 (I2C) ) : 添加了有关 I2C 接口的注释和更多信息.....	56
• 添加了“ I2C 接口信号连接”一节.....	57
• 添加了“ AM62x 处理器系列”一节.....	58
• 添加了“ AM62Ax 处理器系列”一节.....	58
• 添加了“ AM62D-Q1 处理器系列”一节.....	58
• 添加了“ AM62Px 处理器系列”一节.....	58
• ( 使用 CSIRX0 外设时 ) : 添加了有关无源元件值、容差和额定电压的问题的常见问题解答.....	58
• ( 显示并行接口 (DPI) ) : 更新了“注释” .....	59
• ( AM62x ( AM625 、 AM623 、 AM625-Q1 、 AM625SIP ) 、 AM62Ax 和 AM62Px 处理器系列 ) : 添加了有关 DPI 接口的更多信息.....	59
• ( 适用于 AM62x 和 AM62Px 处理器系列的 OLDI0 ) : 添加了有关 OLDI0 接口的更多信息.....	60
• ( 使用 DSITX0 外设 ) : 添加了有关无源元件值、容差和额定电压的问题的常见问题解答.....	61
• ( 通用输入/输出 (GPIO) ) : 添加了注释、有关处理器 IO 的更多信息、与 GPIO 相关的问题以及与 LVCMOS 输入磁滞相关的问题常见问题解答.....	62
• ( 其他信息 ) : 添加了注释 ( 与 PADCONFIG 寄存器位配置 — ST_EN 和去抖功能相关 ) .....	63
• ( 使用时电压监控输入连接 ) : 添加了电源正常 (POK) 监控模块电压以及连接建议和无源器件值、容差和额定电压常见问题解答相关问题.....	64
• ( 不使用时的电压监控输入连接 ) : 添加了电源正常 (POK) 模块电压监测和连接建议的常见问题解答.....	64
• ( 高频振荡器 (MCU_OSC0) 时钟丢失检测 ) : 添加了如何在时钟丢失检测后切换回外部时钟的常见问题解答 .....	65
• 添加了“晶体或外部振荡器故障”一节.....	65
• 添加了“ SK 特定电路实现 ( 重复使用 ) ”一节.....	65
• ( 定制电路板原理图设计的自我审查 ) : 添加的注释.....	68

---

• ( 定制电路板布局注释 ( 在原理图部分附近添加 ) 和通用指南 ) : 添加了通用高速布局指南常见问题解答的注释和文档链接.....	68
• 添加了 DDR-MARGIN-FW 部分.....	69
• ( 常见问题解答 - 处理器产品系列和 Sitara 处理器系列 ) : 添加了 AM62Lx 处理器系列的主列表常见问题解答 .....	70
• 添加了 “ 原理图审查 ( 内部自检 ) 与原理图审查需求 ( 供应商 ) ” 一节.....	71
• ( 参考文献 ) : 更新了对所有章节的引用，并添加了 AM62L 参考章节.....	71

---

## 重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#))、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025 , 德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期 : 2025 年 10 月